

现货 FBAR 滤波器

名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMF1100B000AK	1100MHz	1100MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	1
滤波器	WLMF1215B030AK	1185MHz	1245MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	2
滤波器	WLMF1240B030AK	1210MHz	1270MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	3
滤波器	WLMF1265B030AK	1235MHz	1295MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	4
滤波器	WLMF1400B000AK	1400MHz	1400MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	5
滤波器	WLMF1400B009AK	1391MHz	1409MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	6
滤波器	WLMF1400B050AK	1350MHz	1450MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	7
滤波器	WLMF1500B000AK	1500MHz	1500MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	8
滤波器	WLMF1550B020AK	1530MHz	1570MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	9
滤波器	WLMF1600B000BK	1600MHz	1600MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	10
滤波器	WLMF1618B022AK	1596MHz	1640MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	11
滤波器	WLMF1700B000AK	1700MHz	1700MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	12
滤波器	WLMF1750B000AK	1750MHz	1750MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	13
滤波器	WLMF1750B060AK	1690MHz	1810MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	14
滤波器	WLMF1800B000AK	1800MHz	1800MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	15
滤波器	WLMF1800P040AK	1760MHz	1840MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	16
滤波器	WLMF1821P020AK	1801MHz	1841MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	17
滤波器	WLMF1900B000AK	1900MHz	1900MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	18
滤波器	WLMF1909P020AK	1889MHz	1929MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	19
滤波器	WLMF1973P020BK	1953MHz	1993MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	20
滤波器	WLMF1995B030BK	1965MHz	2025MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	21
滤波器	WLMF1997P020BK	1977MHz	2017MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	22
滤波器	WLMF2050B000AK	2050MHz	2050MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	23
滤波器	WLMF2100B000AK	2100MHz	2100MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	24
滤波器	WLMF2100B000BK	2100MHz	2100MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	25



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMF2102B120AK	1982MHz	2222MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	26
滤波器	WLMF2149P020AK	2129MHz	2169MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	27
滤波器	WLMF2150B000AK	2150MHz	2150MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	28
滤波器	WLMF2185B030BK	2155MHz	2215MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	29
滤波器	WLMF2200B000CK	2200MHz	2200MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	30
滤波器	WLMF2250B000AK	2250MHz	2250MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	31
滤波器	WLMF2300B000CK	2300MHz	2300MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	32
滤波器	WLMF2300B010AK	2290MHz	2310MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	33
滤波器	WLMF2350B000AK	2350MHz	2350MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	34
滤波器	WLMF2400B000AK	2400MHz	2400MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	35
滤波器	WLMF2450B000AK	2450MHz	2450MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	36
滤波器	WLMF2460B020AK	2440MHz	2480MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	37
滤波器	WLMF2483B020CK	2463MHz	2503MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	38
滤波器	WLMF2500B000BK	2500MHz	2500MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	39
滤波器	WLMF2600B000BK	2600MHz	2600MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	40
滤波器	WLMF2700B000AK	2700MHz	2700MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	41
滤波器	WLMF2800B000AK	2800MHz	2800MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	42
滤波器	WLMF2900B000BK	2900MHz	2900MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	43
滤波器	WLMF2900B080BK	2820MHz	2980MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	44
滤波器	WLMF3000B000CK	3000MHz	3000MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	45
滤波器	WLMF3060B080BK	2980MHz	3140MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	46
滤波器	WLMF3100B000AK	3100MHz	3100MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	47
滤波器	WLMF3200B000AK	3200MHz	3200MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	48
滤波器	WLMF3300B000AK	3300MHz	3300MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	49
滤波器	WLMF3400B000AK	3400MHz	3400MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	50
滤波器	WLMF3500B000AK	3500MHz	3500MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	51
滤波器	WLMF3600B040AK	3560MHz	3640MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	52
滤波器	WLMF3650B020AK	3630MHz	3670MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	53
滤波器	WLMF3670B019AK	3651MHz	3689MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	54



名称	型号	最小频率	最大频率	特性	结构	类别	页码
滤波器	WLMF3670B060AK	3610MHz	3730MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	55
滤波器	WLMF3780B080AK	3700MHz	3860MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	56
滤波器	WLMF3800B006AK	3774MHz	3806MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	57
滤波器	WLMF3900B025AK	3875MHz	3925MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	58
滤波器	WLMF3900B220AK	3680MHz	4120MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	59
滤波器	WLMF4100P000AK	4100MHz	4100MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	60
滤波器	WLMF4200P000AK	4200MHz	4200MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	61
滤波器	WLMF4400B000AK	4400MHz	4400MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	62
滤波器	WLMF4500B000AK	4500MHz	4500MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	63
滤波器	WLMF5190B140AK	5050MHz	5330MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	64
滤波器	WLMF5375B000AK	5375MHz	5375MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	65
滤波器	WLMF5575P350AK	5225MHz	5925MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	66
滤波器	WLMF5840P180AK	5660MHz	6020MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	67
滤波器	WLMF6490B140AK	6350MHz	6630MHz	带通	芯片滤波器	FBAR	68



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,
小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

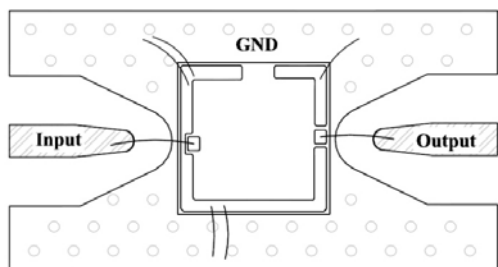
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1100		MHz
中心损耗	/	/		2	2.5	dB
带外抑制	DC-1	GHz≥	45	50		dB
带外抑制	1.2-3	GHz≥	45	50		dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
功率容量	20dBm设计保证
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

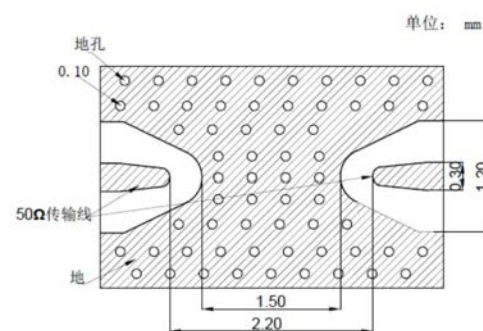
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

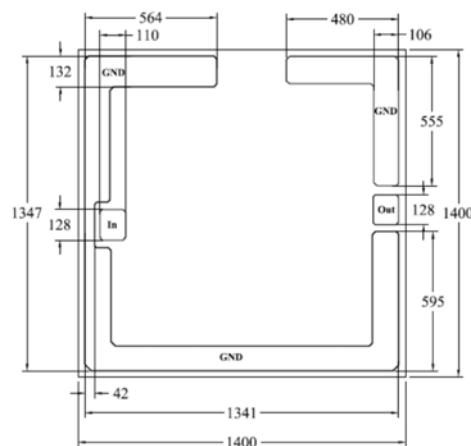
建议PCB布局图



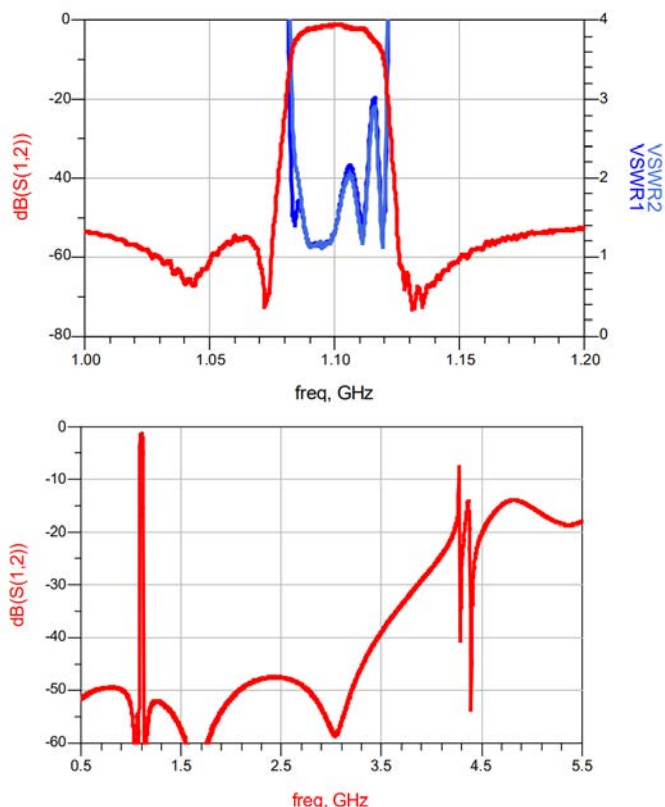
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

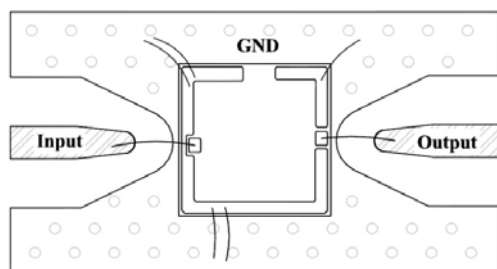
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1215		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1.115	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	1.315	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.5	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
功率容量	20dBm设计保证
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

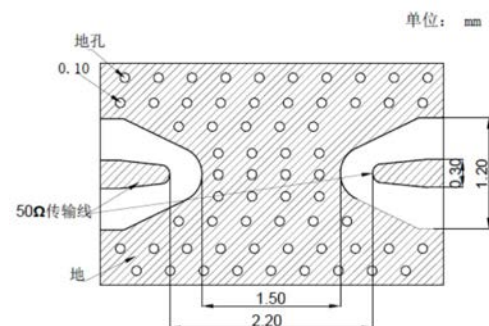
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

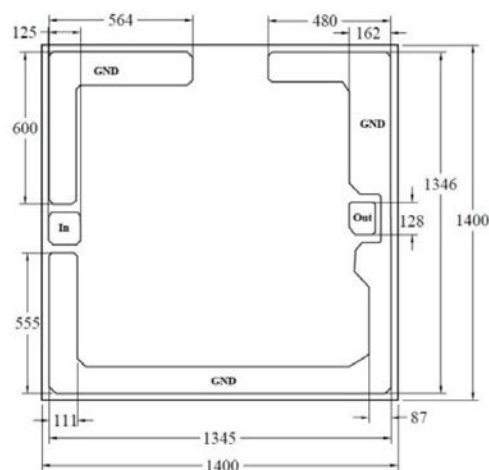
建议PCB布局图



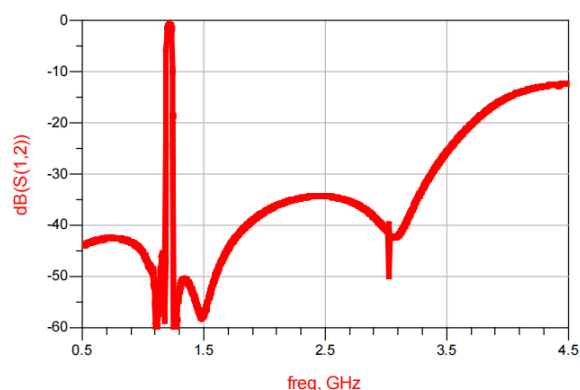
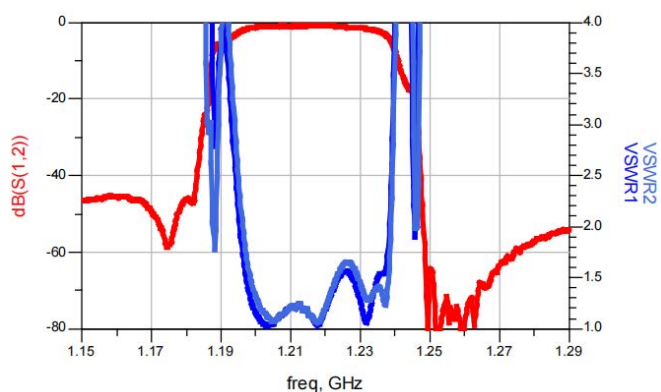
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

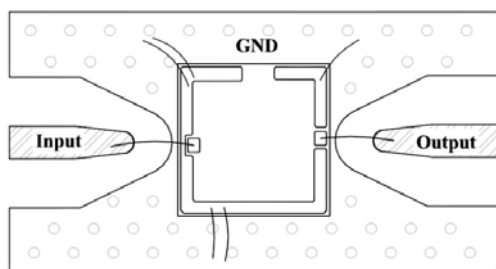
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1240		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	25	30		MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1.114	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	1.340	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.5	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 35 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

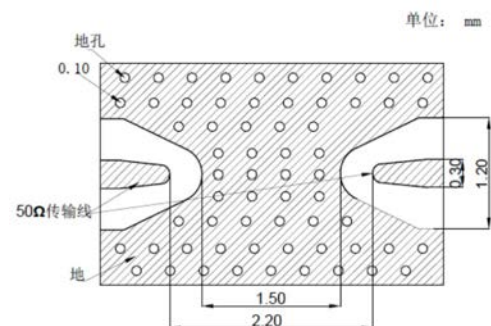
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

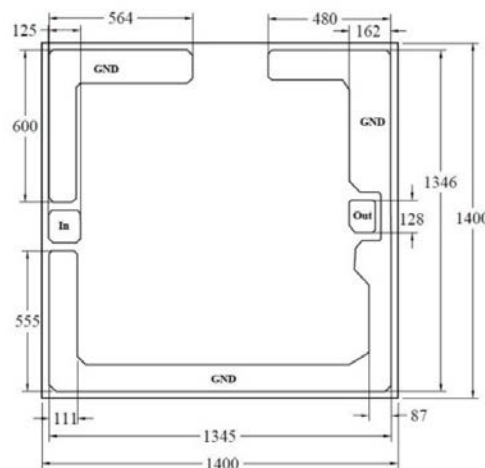
建议PCB布局图



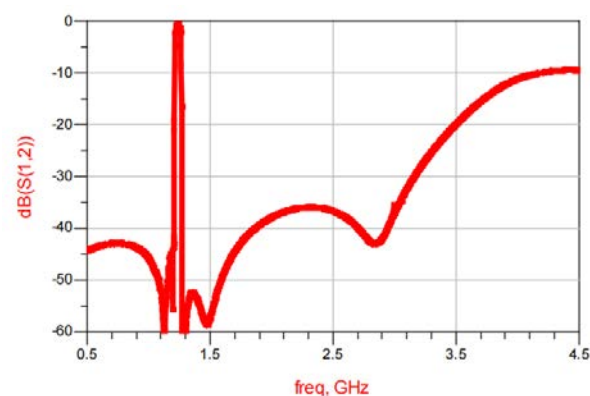
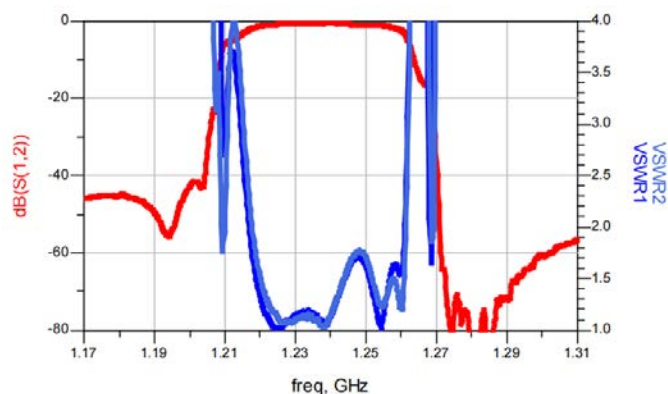
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

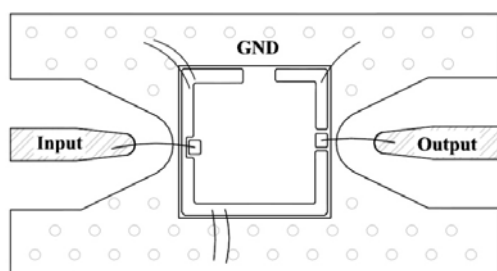
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1265		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	30			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1.165	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	1.365	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	1.5	GHz $\geq$	50			dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 40 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

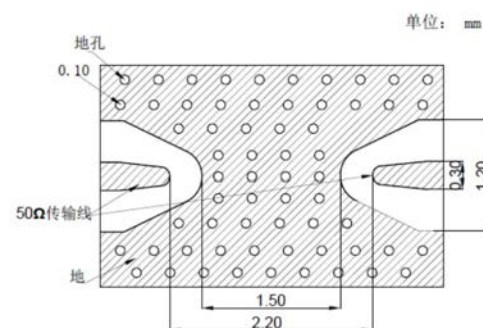
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

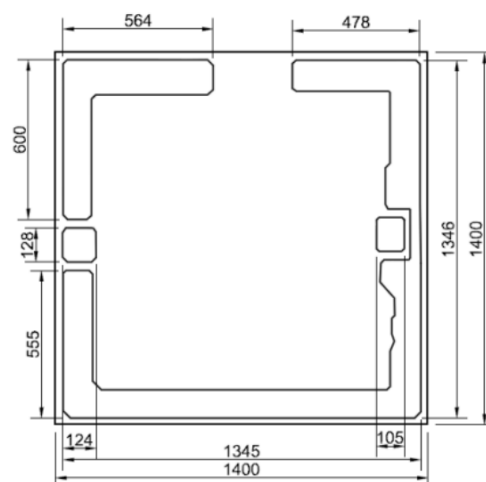
建议PCB布局图



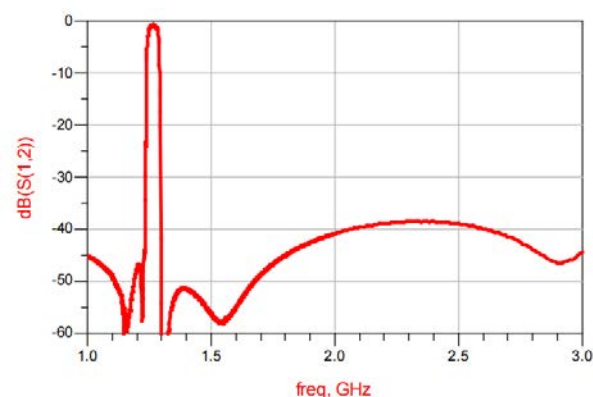
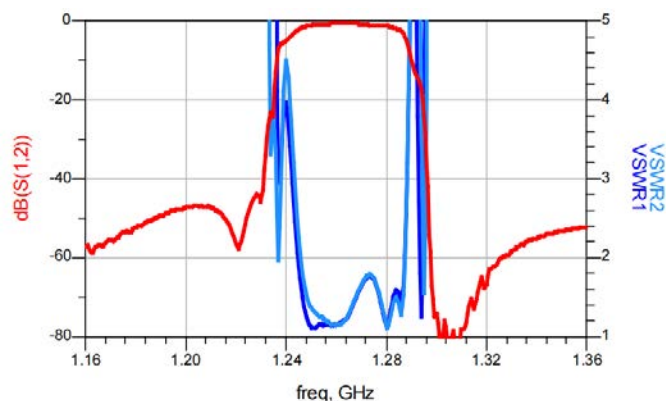
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

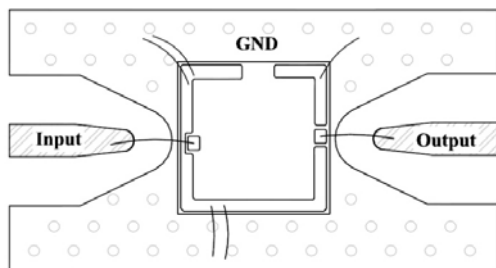
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1400		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.3	GHz $\geq$	40	50		dB
带外抑制	1.5	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

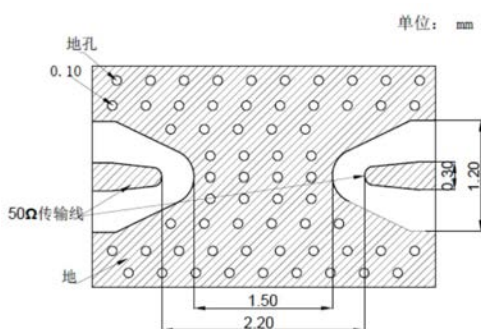
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

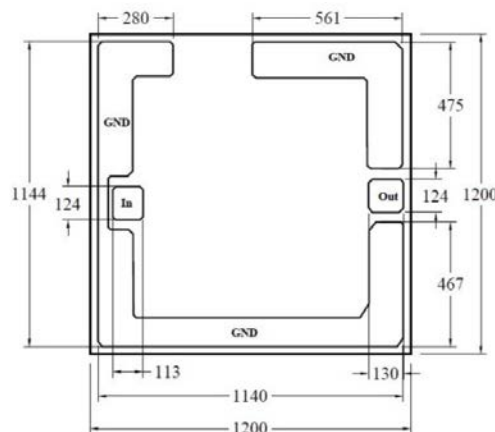
建议PCB布局图



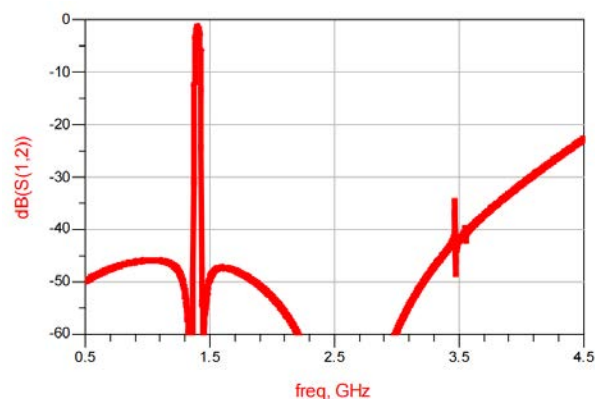
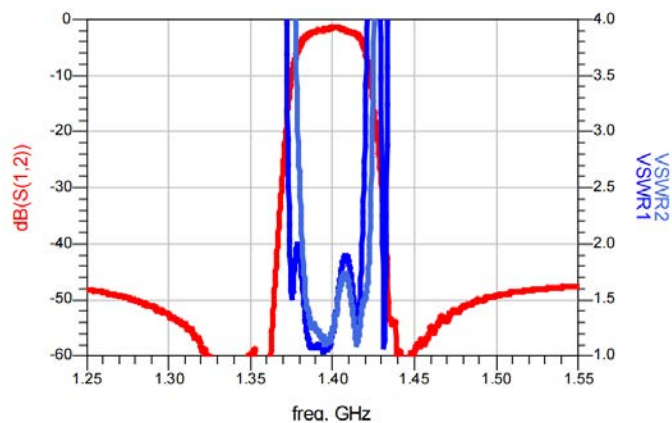
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

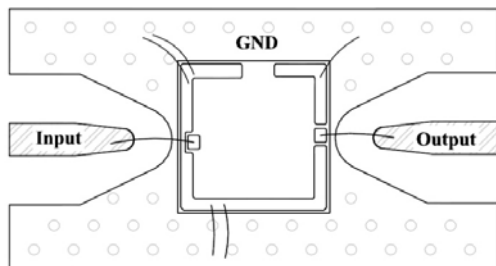
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1400		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	9			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	1.373	GHz $\geq$	20	25		dB
带外抑制	1.427	GHz $\geq$	20	25		dB
通带驻波	/	/		2.0	2.2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 25 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

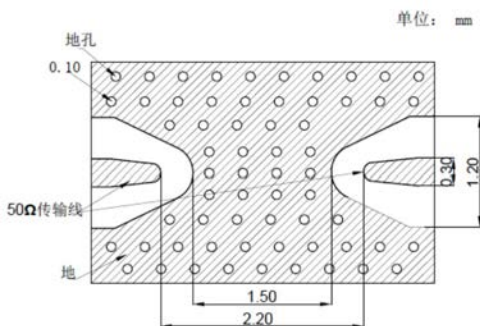
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

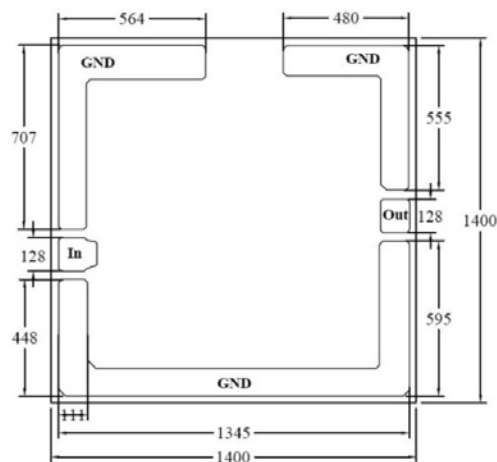
建议PCB布局图



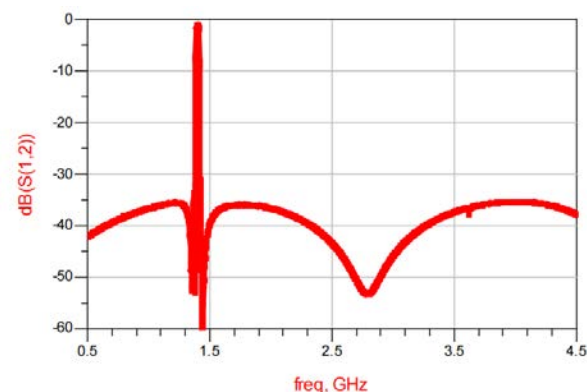
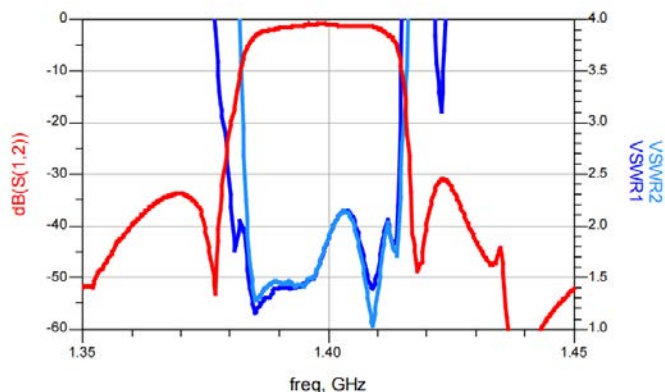
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

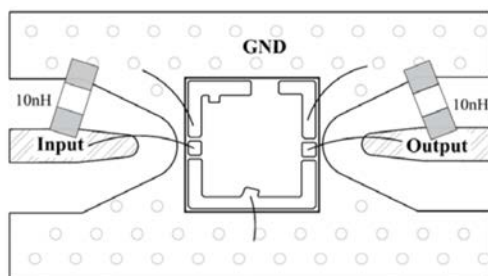
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1400		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	40	50		MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1.3	GHz $\geq$	25	28		dB
带外抑制	1.5	GHz $\geq$	25	28		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

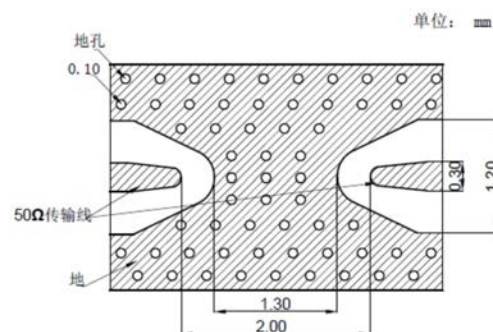
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

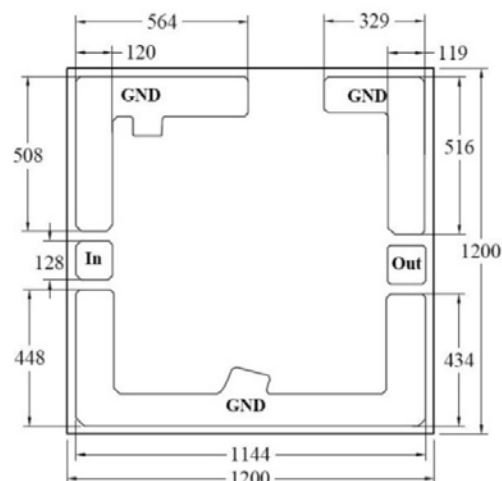
建议PCB布局图



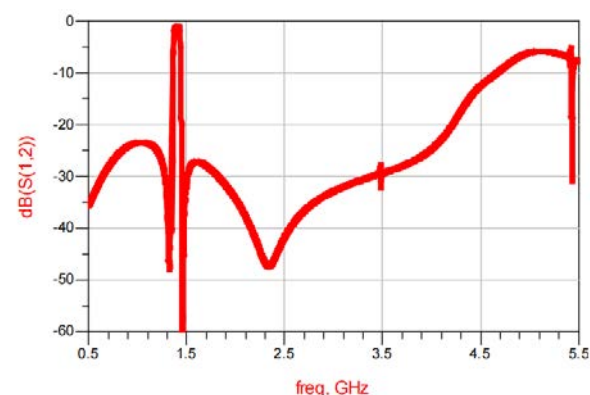
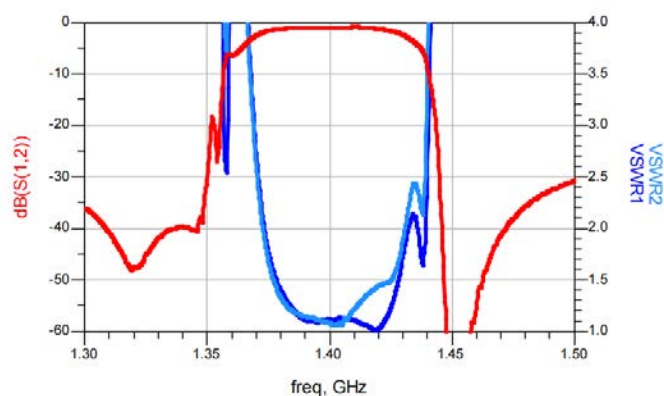
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

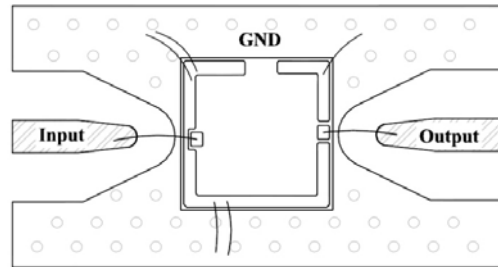
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1500		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.4	GHz≥	40	50		dB
带外抑制	1.6	GHz≥	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

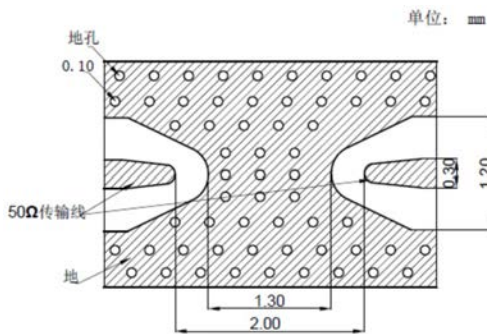
装配示意图



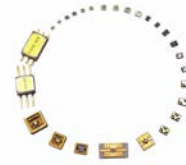
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

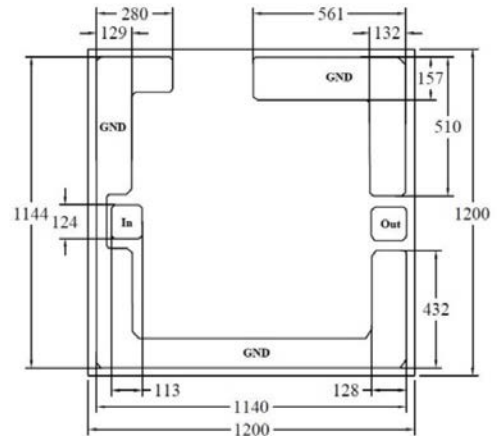
建议PCB布局图



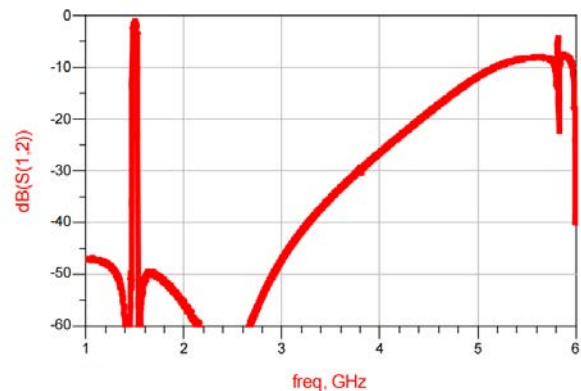
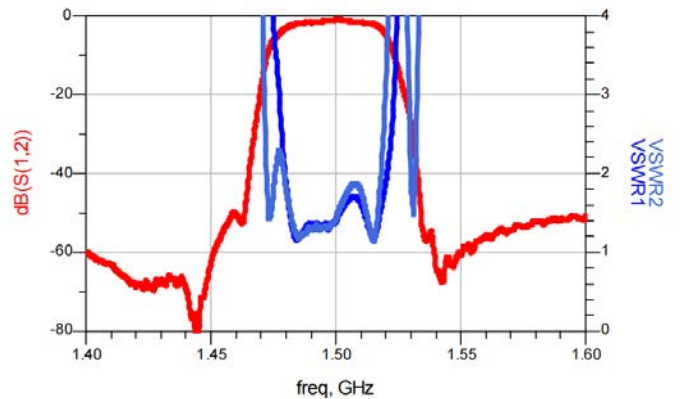
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

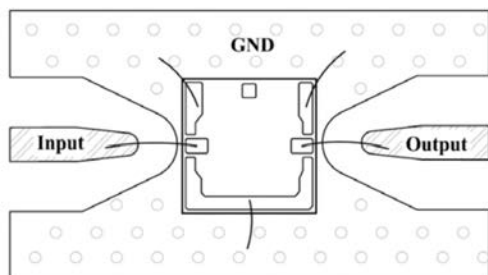
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1550		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	
-1.0dB 带宽	/	/	20			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1.5	GHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	1.6-3	GHz $\geq$	35	50		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 25 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

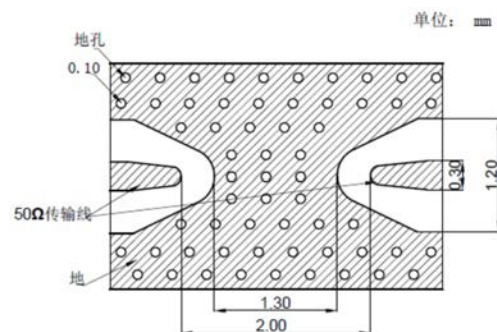
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
2. 芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
3. 芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
4. 芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

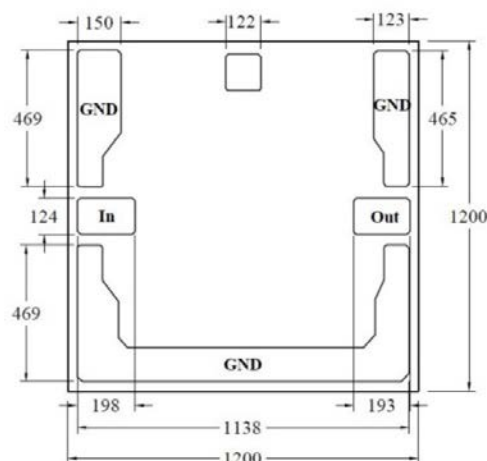
建议PCB布局图



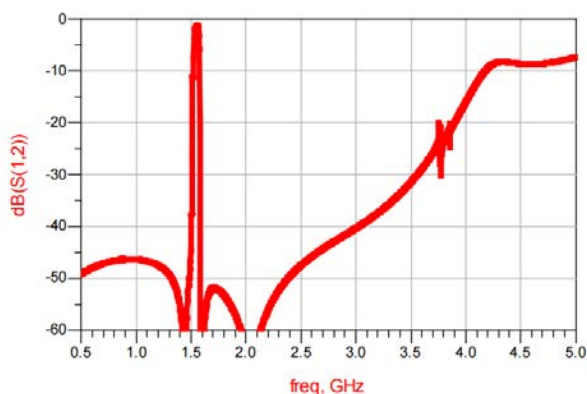
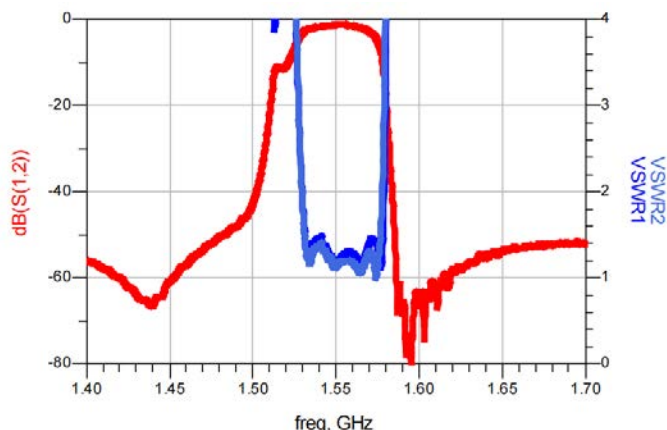
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

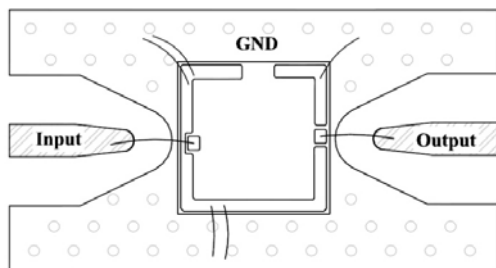
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1600		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.5	GHz≥	40	50		dB
带外抑制	1.7	GHz≥	40	50		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

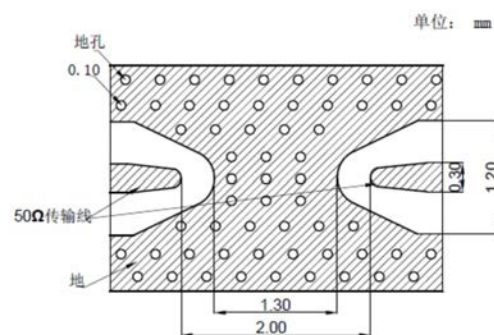
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

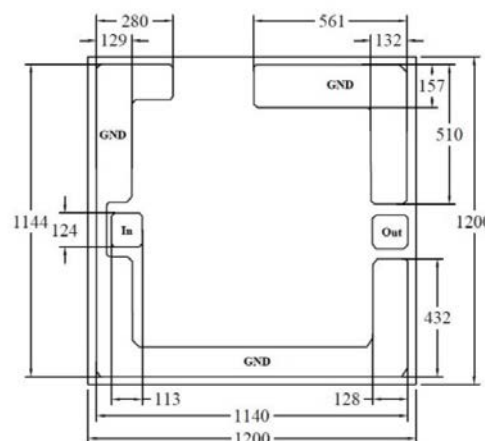
建议PCB布局图



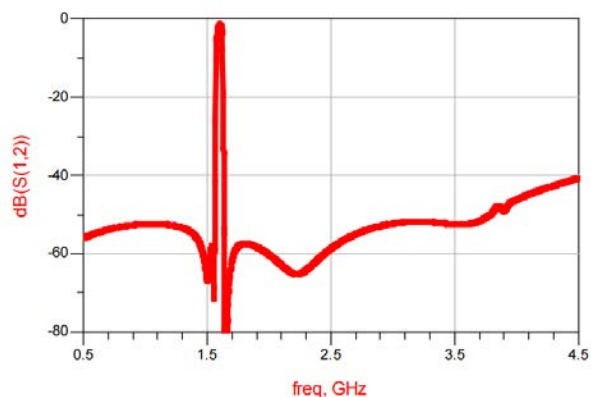
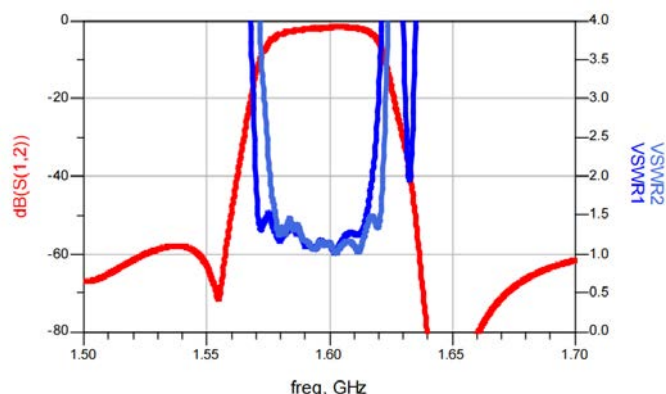
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

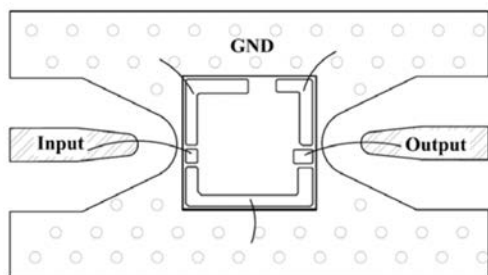
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1618		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	22			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-1.55	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	1.55-1.575	GHz≥	30	35		dB
带外抑制	1.755-2.7	GHz≥	38	40		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤16ns
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

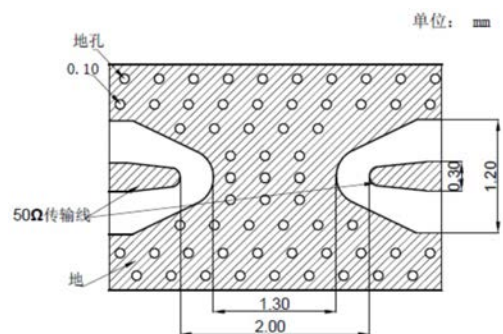
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

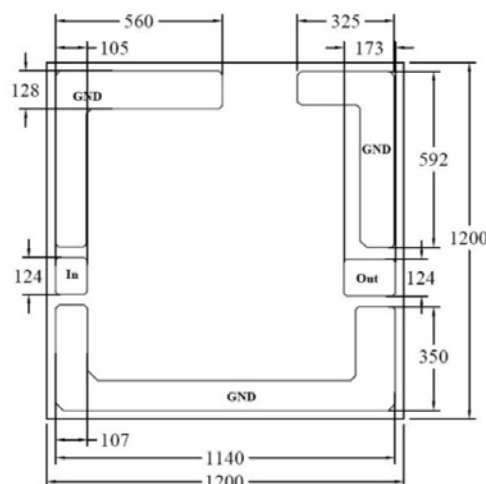
建议PCB布局图



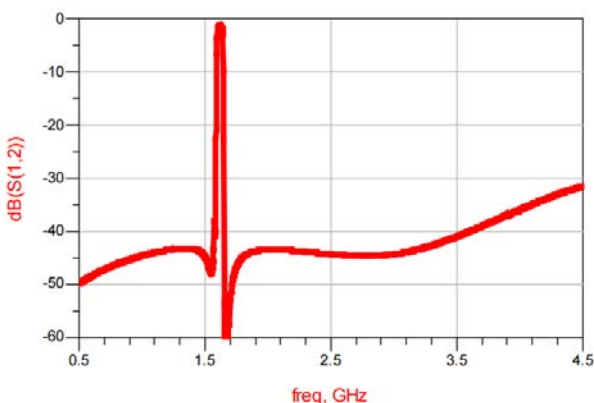
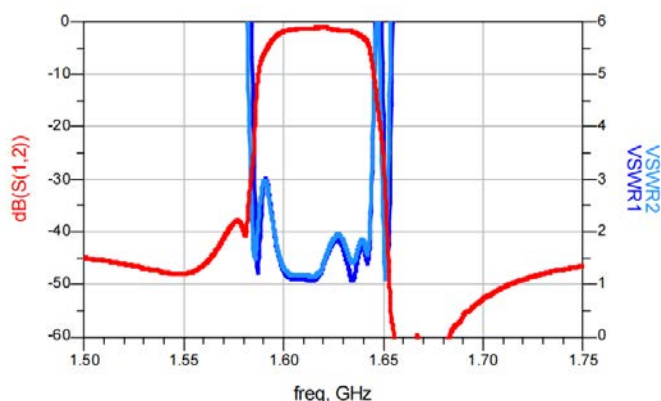
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

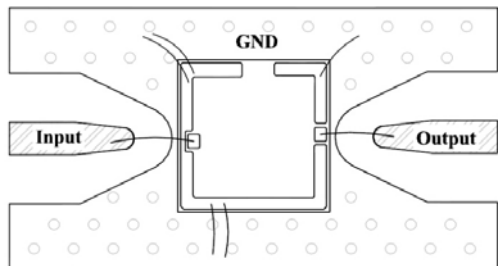
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1700		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.6	GHz $\geq$	40	50		dB
带外抑制	1.8	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

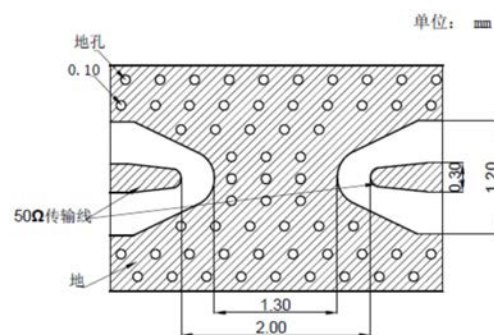
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

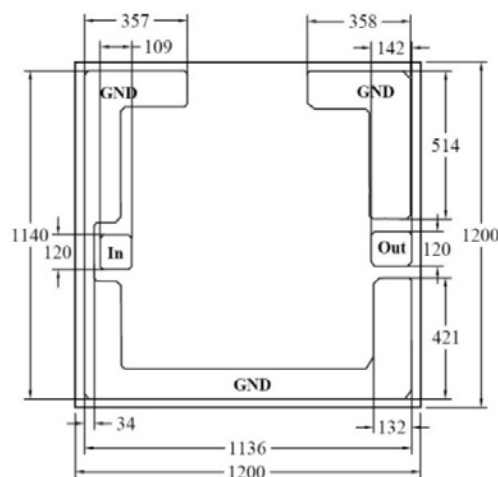
建议PCB布局图



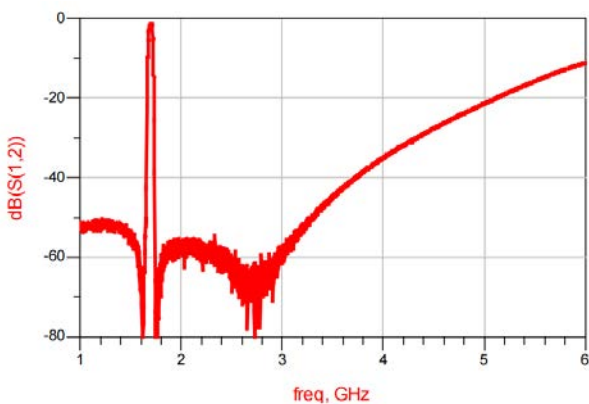
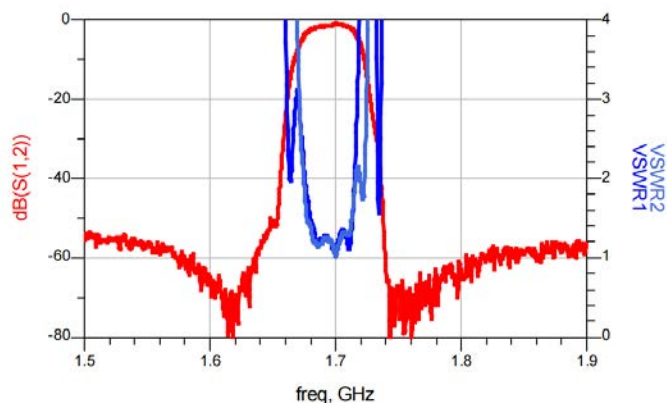
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

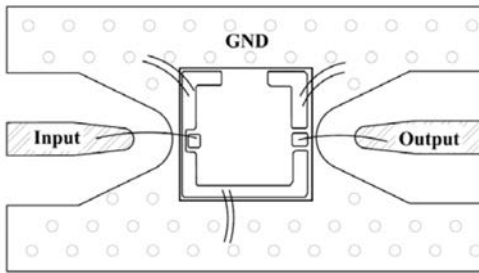
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1750		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	20		MHz
带外抑制	1.7	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.8	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

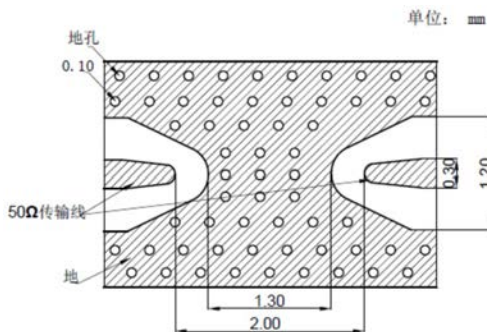
装配示意图



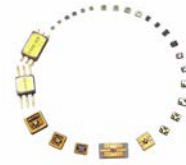
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

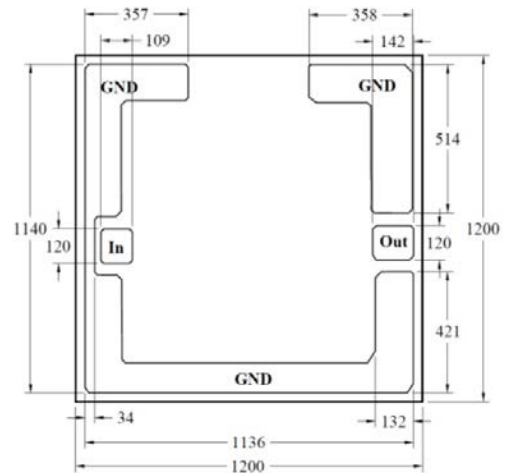
建议PCB布局图



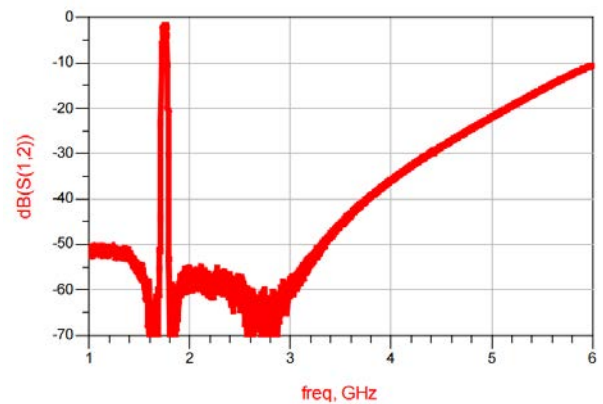
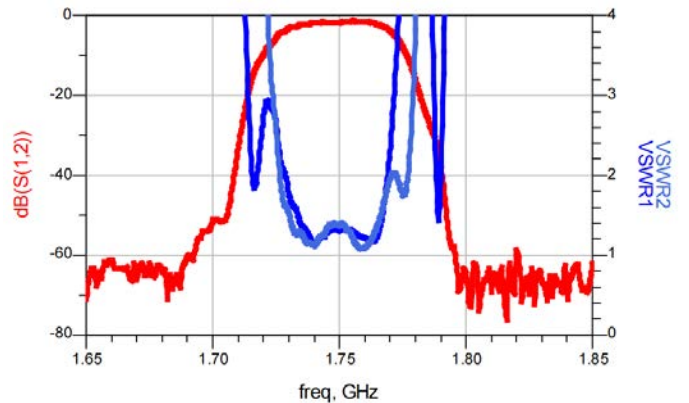
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

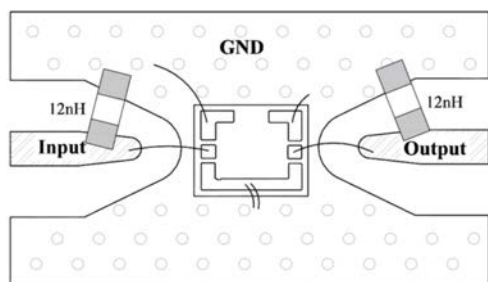
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1750		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	60	70		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	1.6-1.69	GHz $\geq$	20			dB
带外抑制	1.832-3.2	GHz $\geq$	20			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

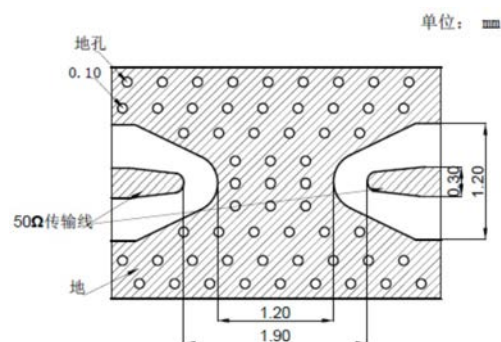
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

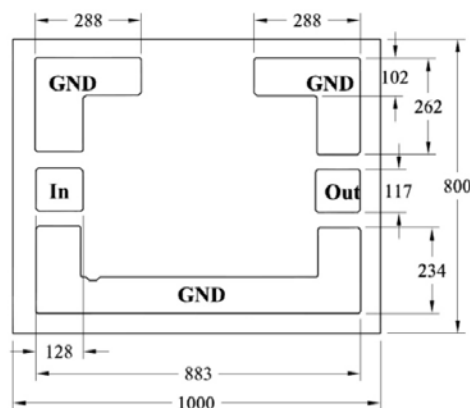
建议PCB布局图



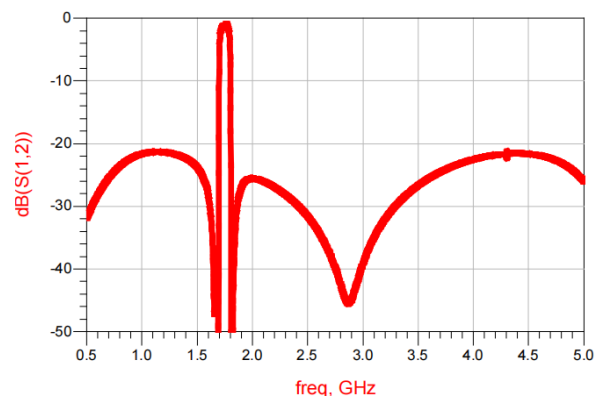
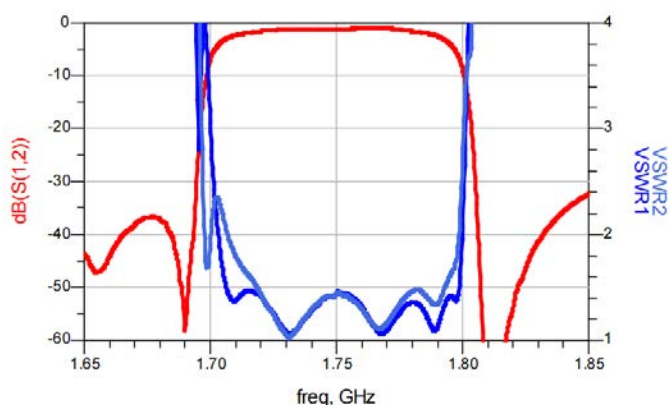
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

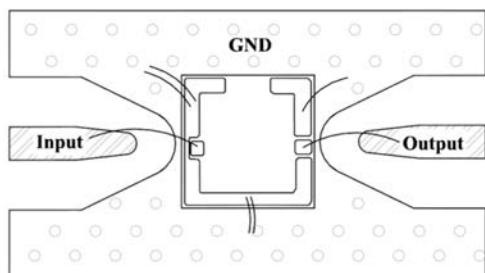
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1800		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.7	GHz $\geq$	40	55		dB
带外抑制	1.9	GHz $\geq$	40	55		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

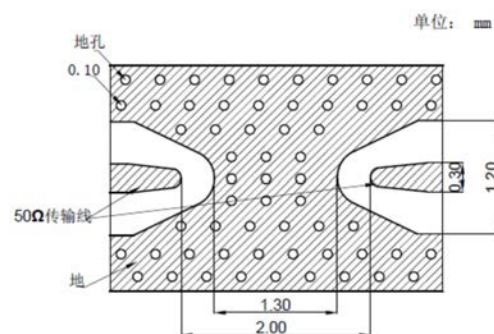
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

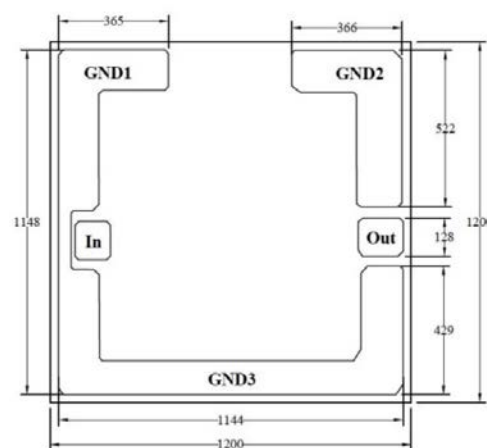
建议PCB布局图



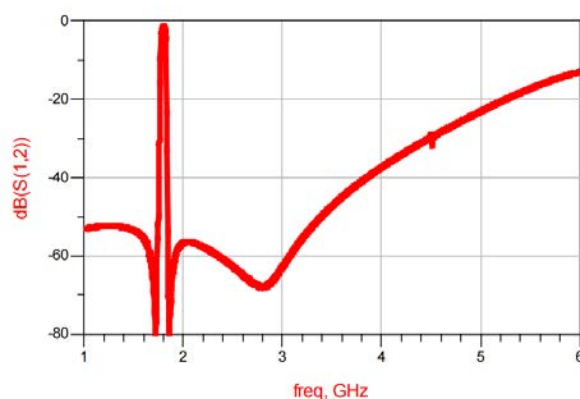
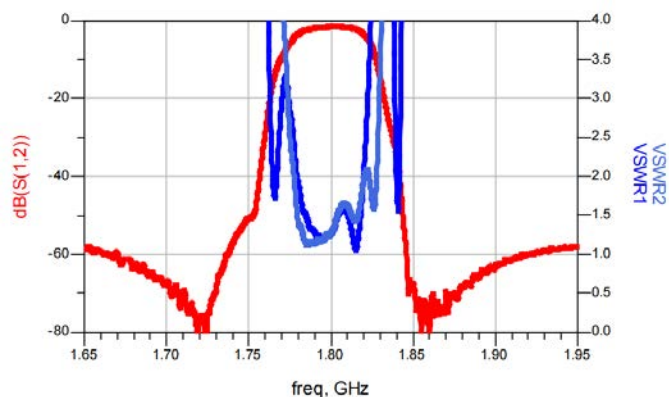
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

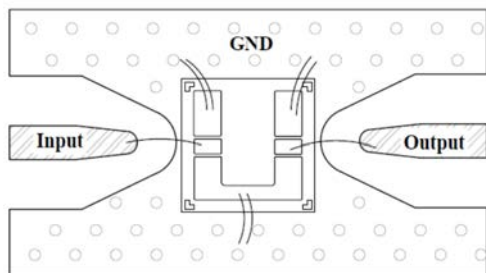
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1800		MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	40			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1.74	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	1.86	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	1.7&1.9	GHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 25 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

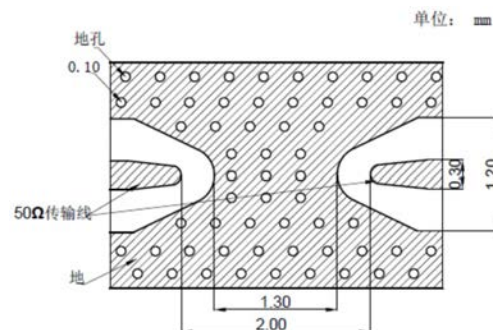
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

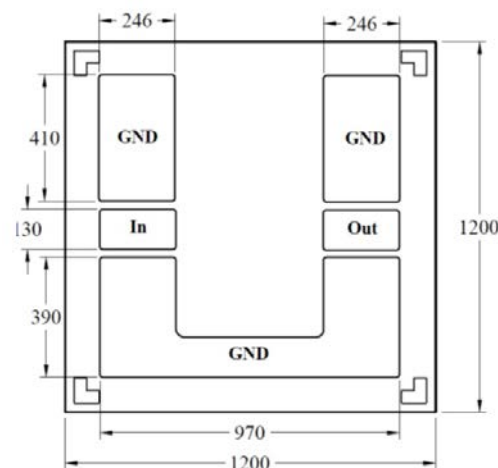
建议PCB布局图



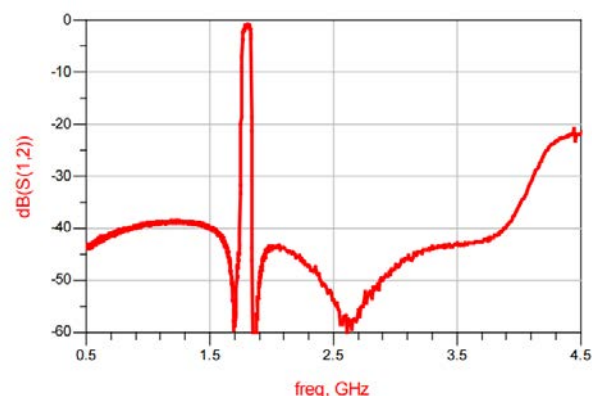
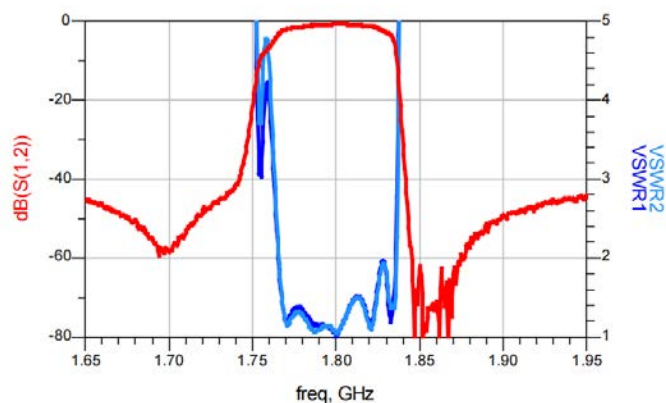
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

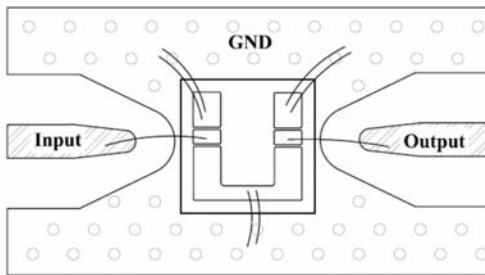
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1821		MHz
中心损耗	/	/			2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		0.6	1.0	dB
带外抑制	0.116-0.487	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.909&1.997	GHz $\geq$	45	50		dB
带外抑制	1.51-1.54	GHz $\geq$	30	40		dB
带外抑制	1.65-1.705	GHz $\geq$	30	40		dB
带外抑制	3.331-3.702	GHz $\geq$	30	40		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

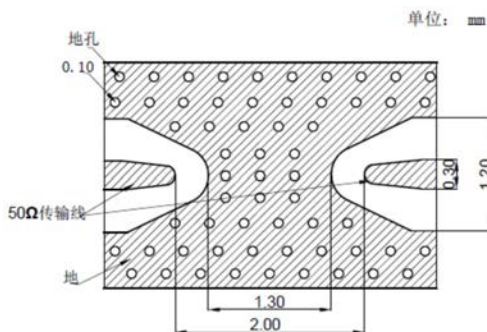
装配示意图



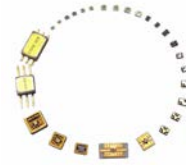
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

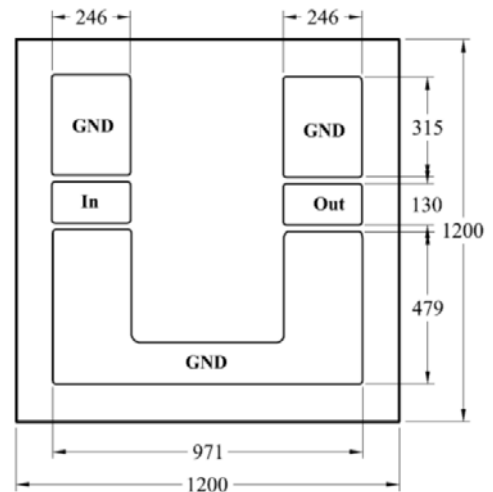
建议PCB布局图



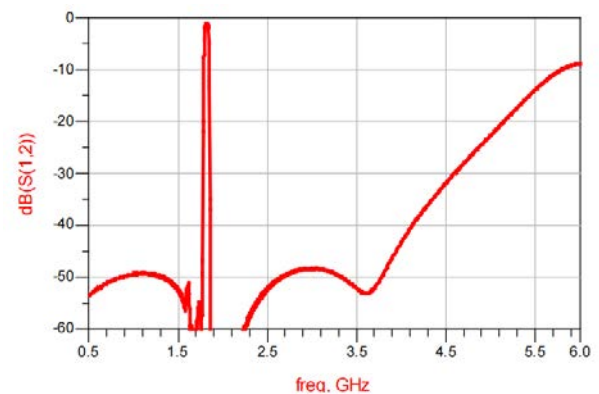
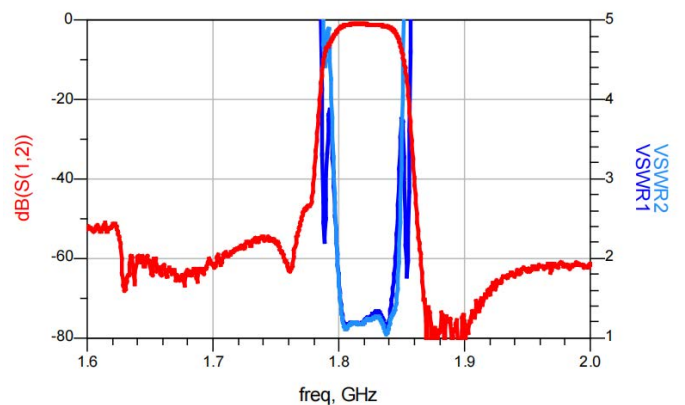
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

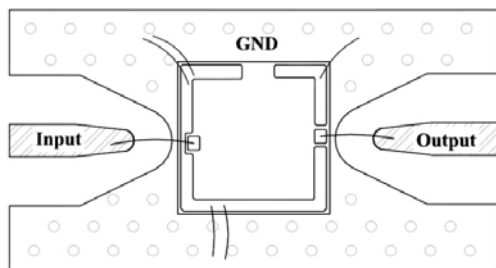
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1900		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	20		MHz
带外抑制	1.8	GHz≥	40	55		dB
带外抑制	2	GHz≥	40	55		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

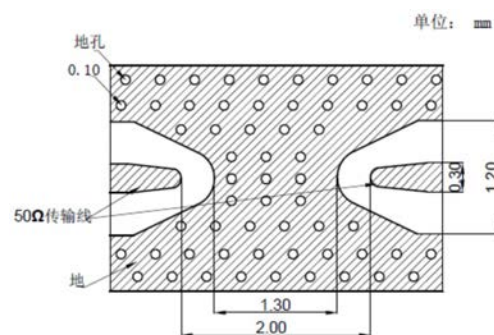
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

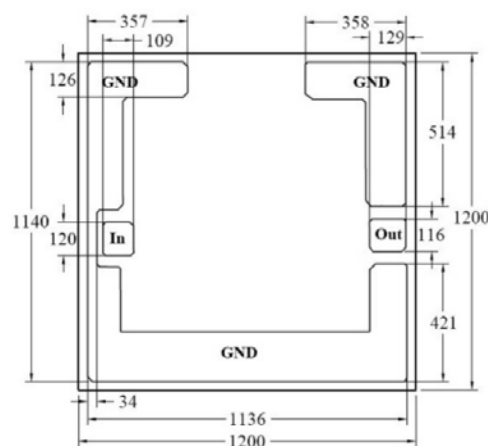
建议PCB布局图



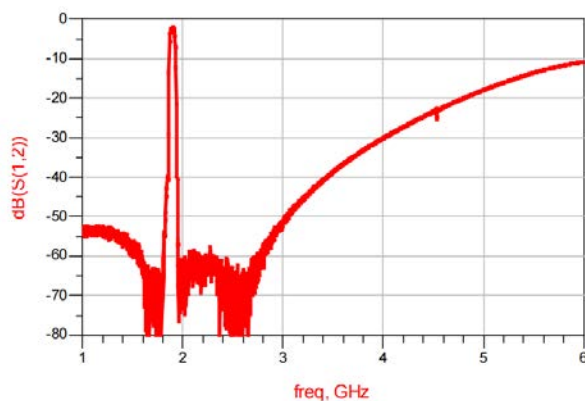
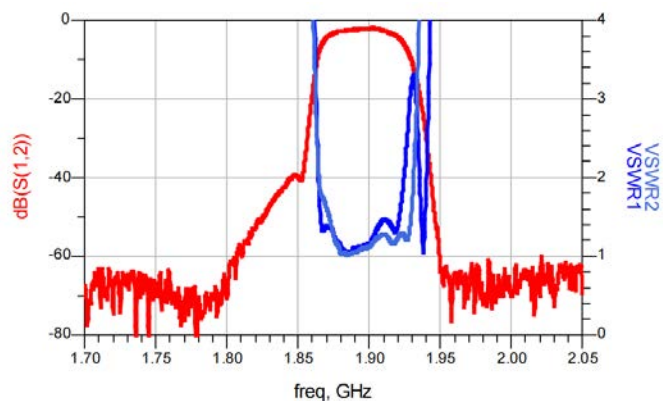
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

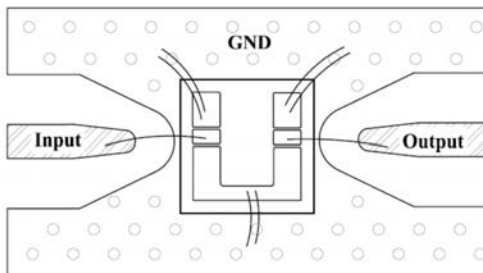
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1909		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		0.6	1.0	dB
带外抑制	0.116-0.487	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.821-1.997	GHz $\geq$	45	50		dB
带外抑制	1.51-1.54	GHz $\geq$	30	40		dB
带外抑制	1.65-1.705	GHz $\geq$	30	40		dB
带外抑制	3.331-3.702	GHz $\geq$	30	40		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

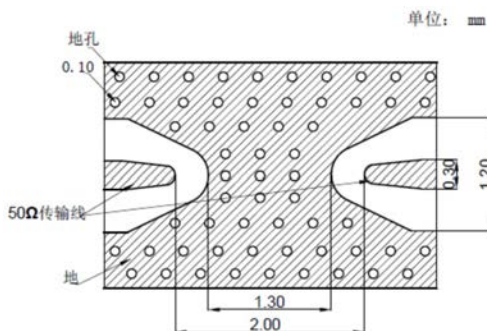
装配示意图



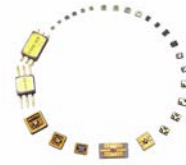
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

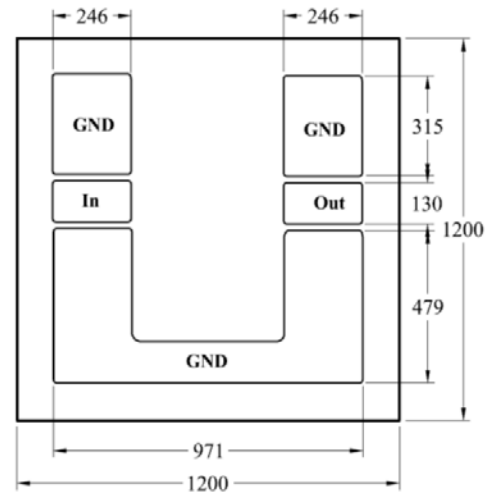
建议PCB布局图



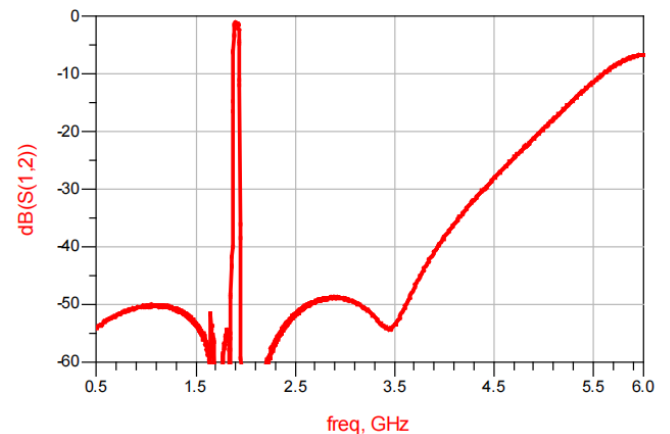
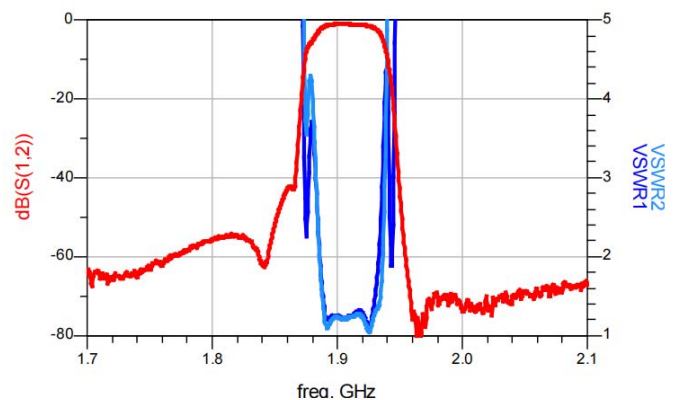
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

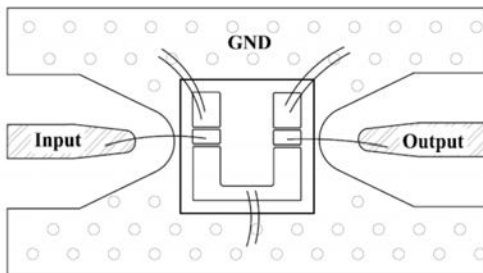
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1973		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	DC-0.76	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.061&2.1495	GHz $\geq$	45	50		dB
带外抑制	1.218-1.873	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.074-2.729	GHz $\geq$	40	42		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 10 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

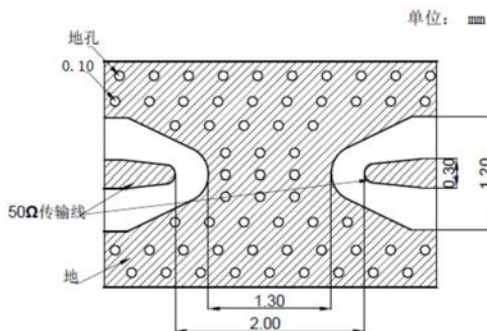
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

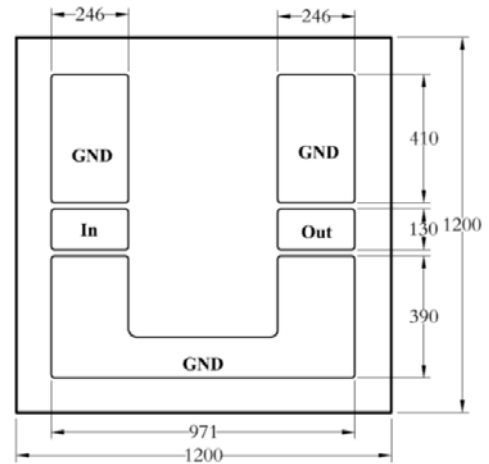
建议PCB布局图



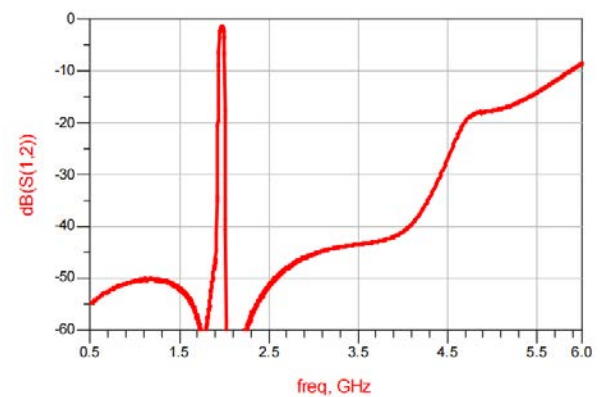
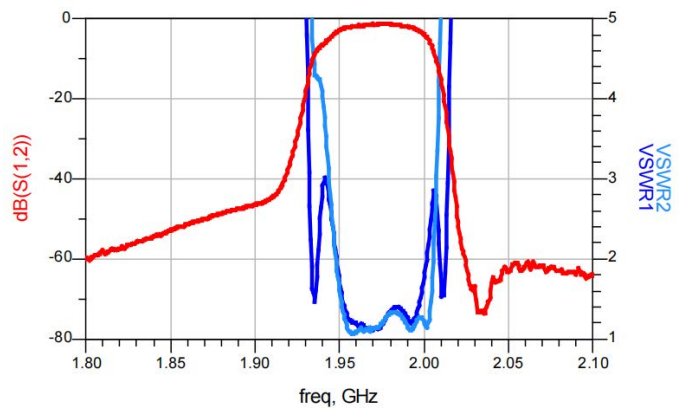
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

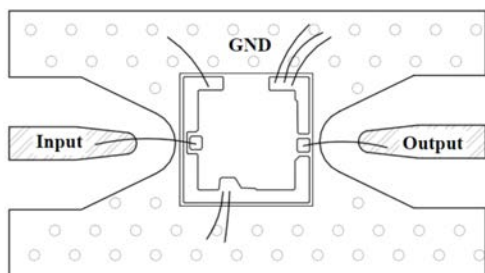
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1995		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	30			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2.17-2.2	GHz ≥	45	55		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤15ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

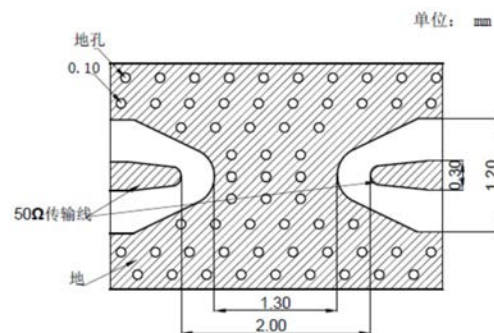
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

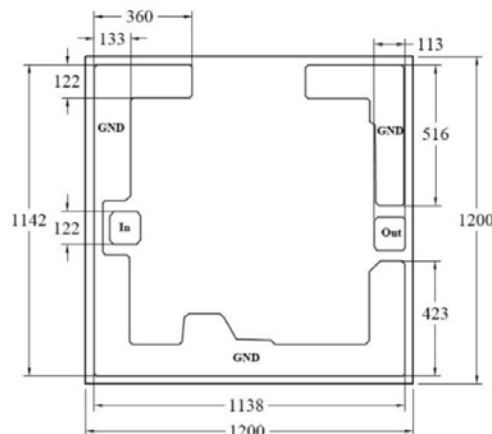
建议PCB布局图



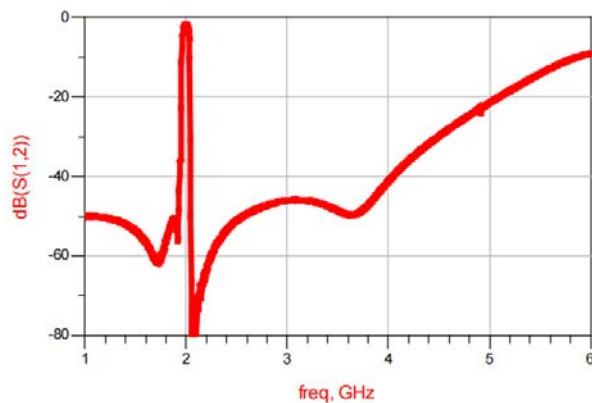
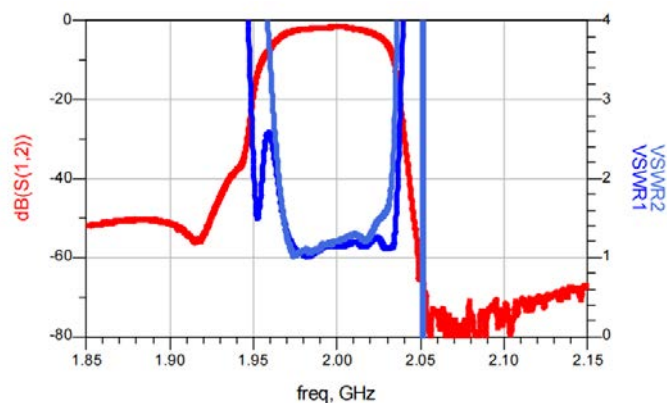
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

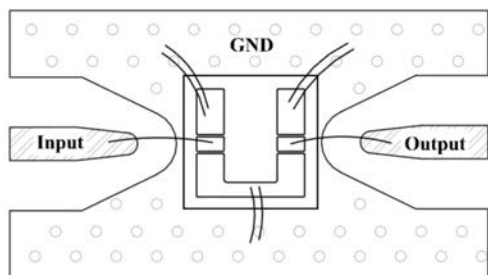
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		1997		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	0.116-0.487	GHz $\geq$	40			dB
带外抑制	1.821-1.909	GHz $\geq$	45			dB
带外抑制	1.51-1.54	GHz $\geq$	30	35		dB
带外抑制	1.65-1.705	GHz $\geq$	30	35		dB
带外抑制	3.331-3.702	GHz $\geq$	30	35		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

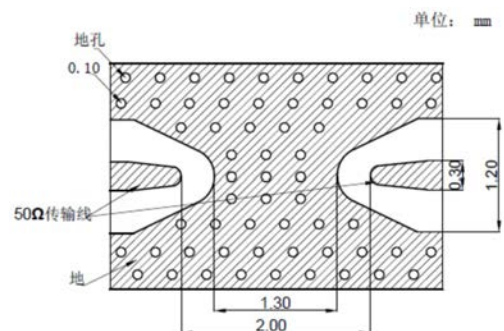
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

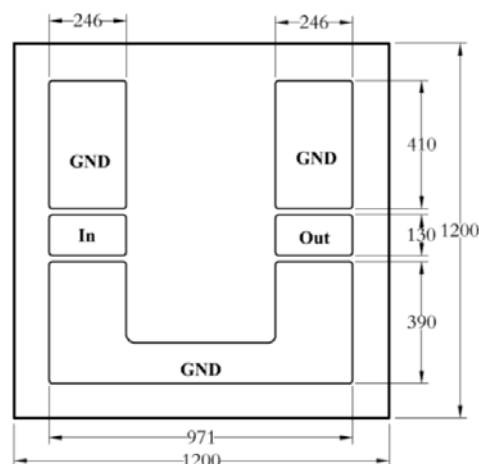
建议PCB布局图



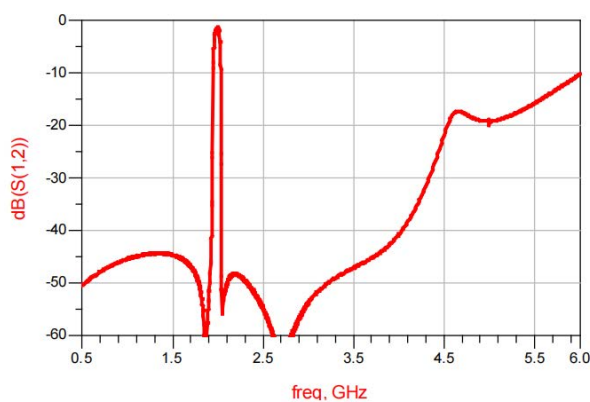
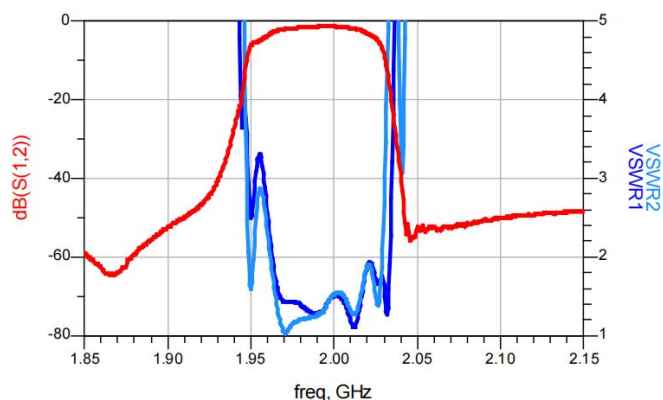
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

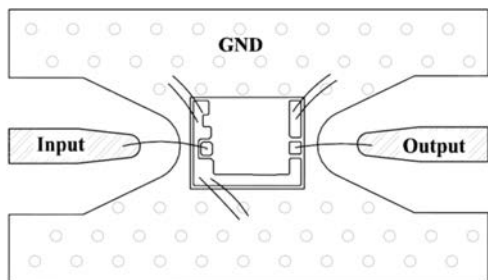
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2050		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1.95	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.15	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

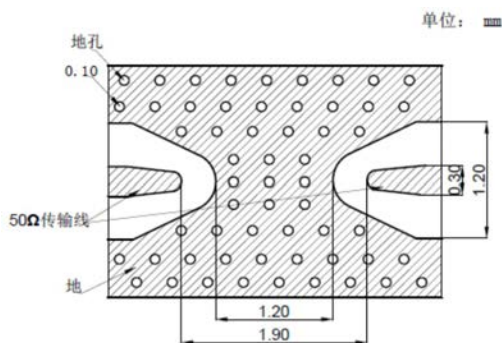
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

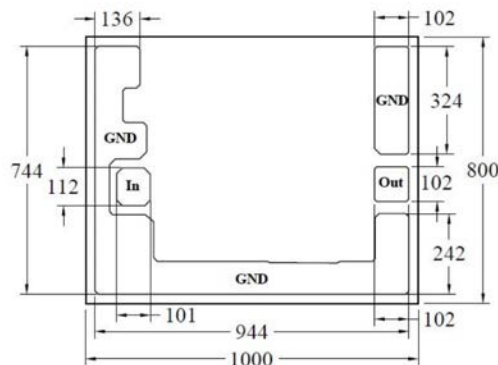
建议PCB布局图



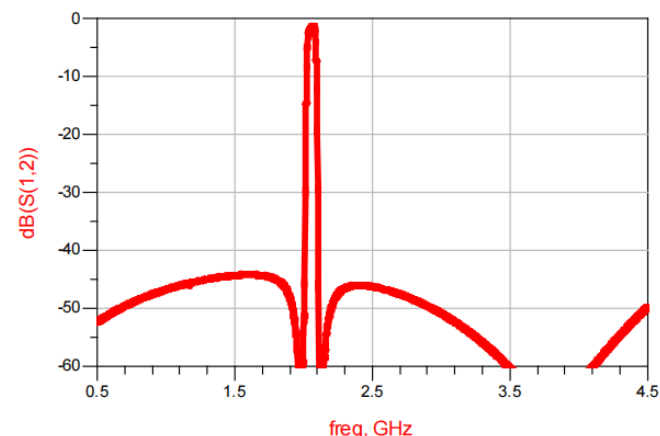
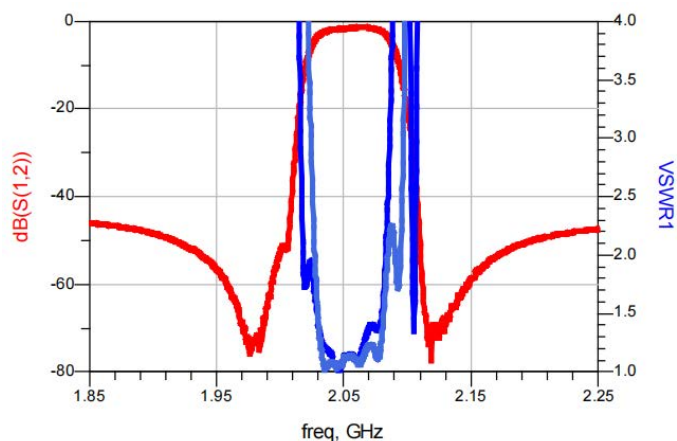
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

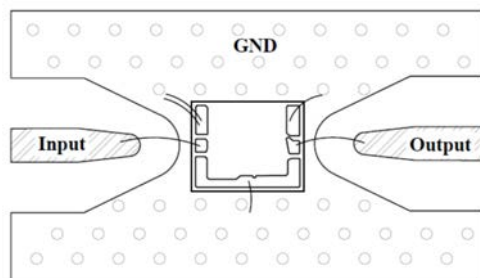
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2100		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	20		MHz
带外抑制	2	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.2	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

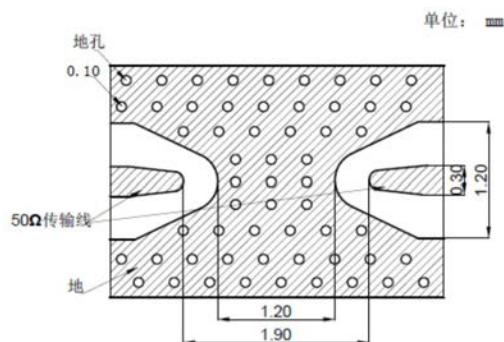
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

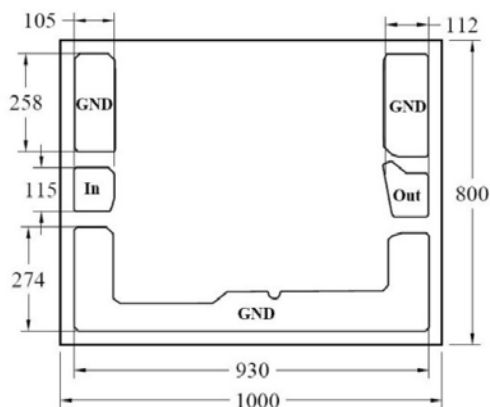
建议PCB布局图



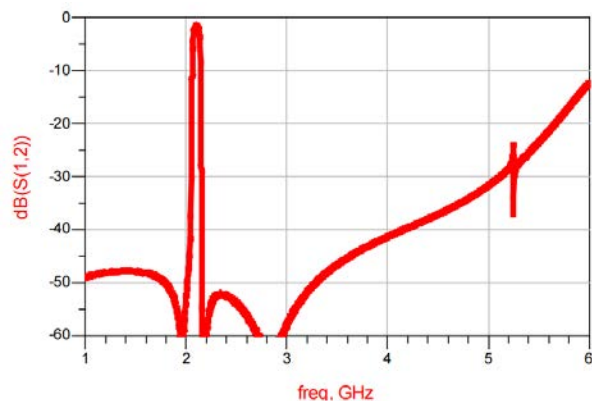
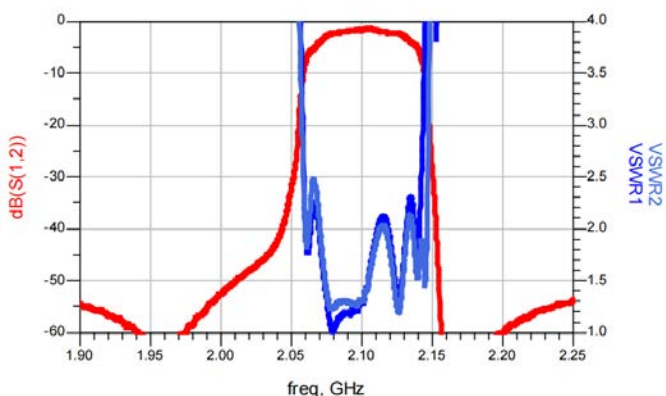
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

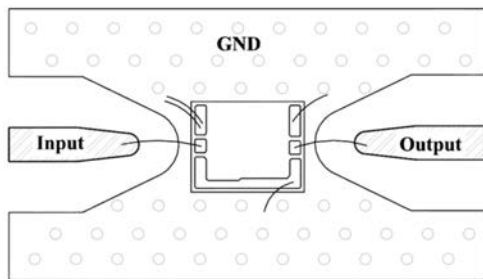
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2100		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2	GHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	2.2	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

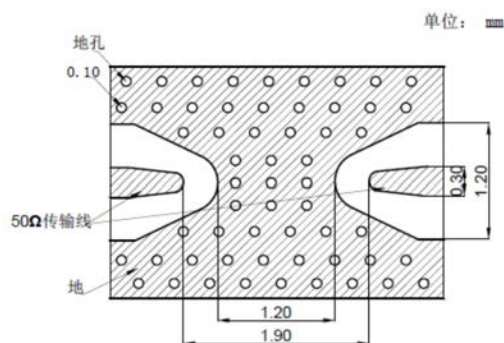
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

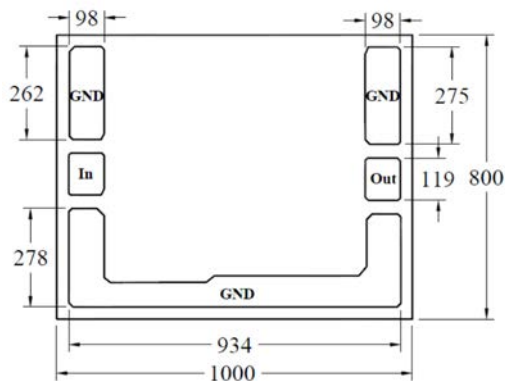
建议PCB布局图



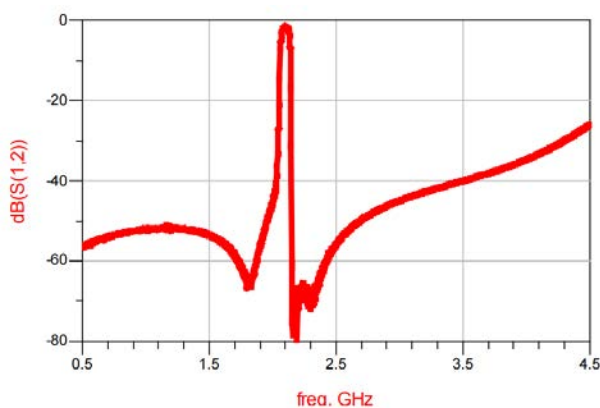
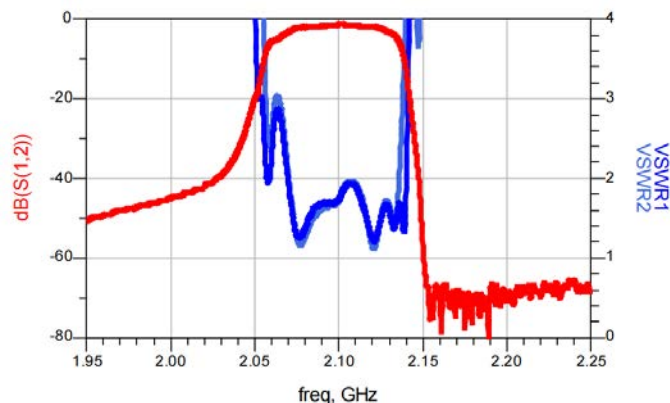
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

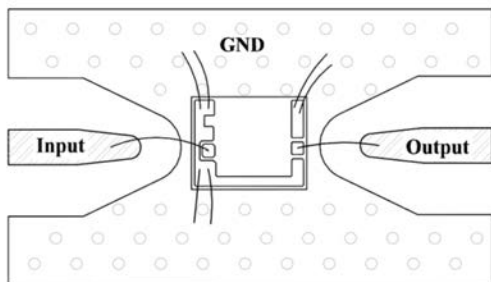
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2102		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	120			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.2	dB
带外抑制	1187-1427	MHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	2247-2487	MHz $\geq$	40	50		dB
带外抑制	1837	MHz $\geq$	45			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 8 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

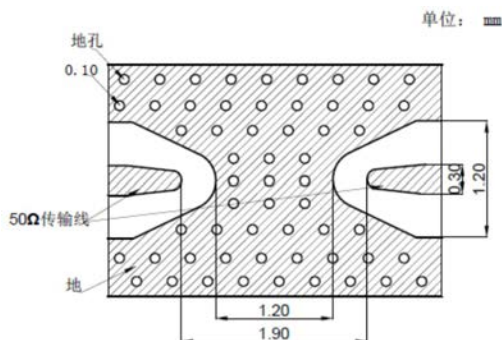
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

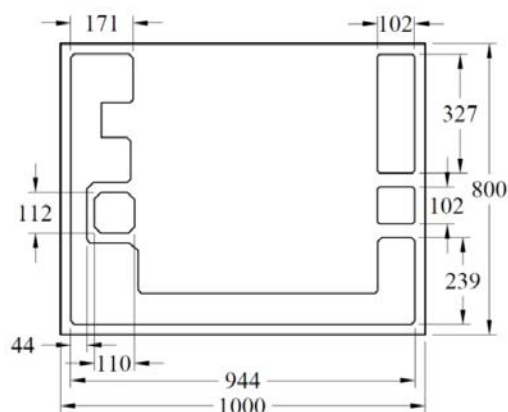
建议PCB布局图



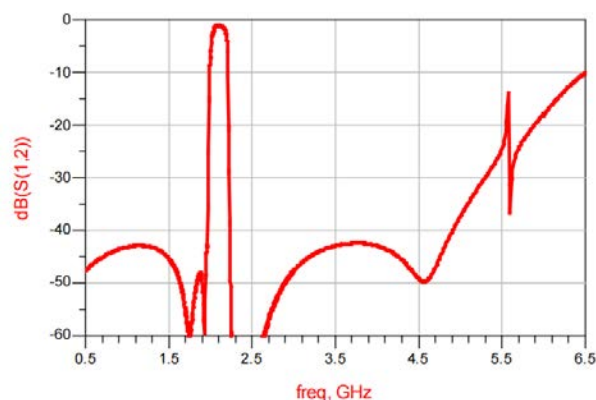
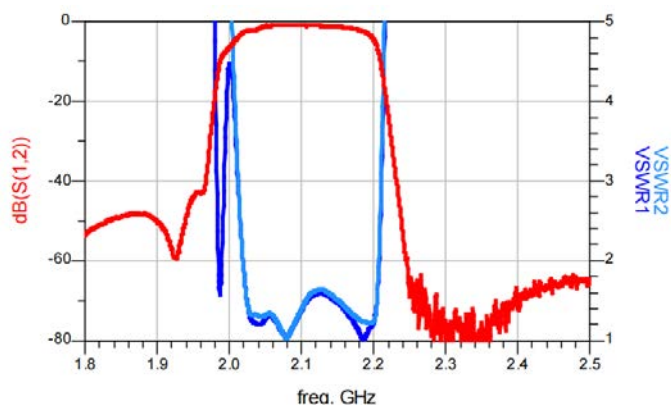
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

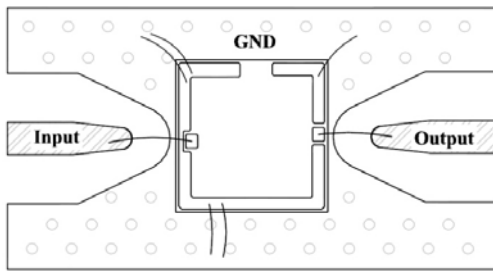
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2149		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	DC-0.76	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	1.9735&2.0615	GHz $\geq$	45	50		dB
带外抑制	1.394-2.049	GHz $\geq$	40	42		dB
带外抑制	2.25-2.905	GHz $\geq$	40	42		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

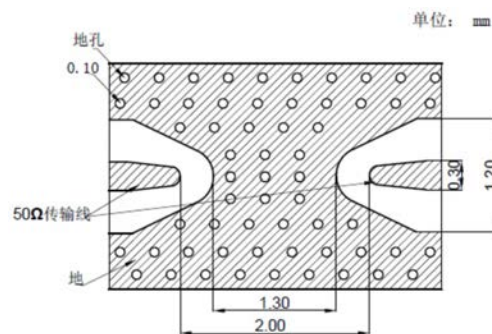
装配示意图



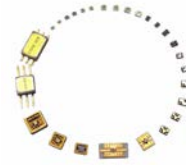
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

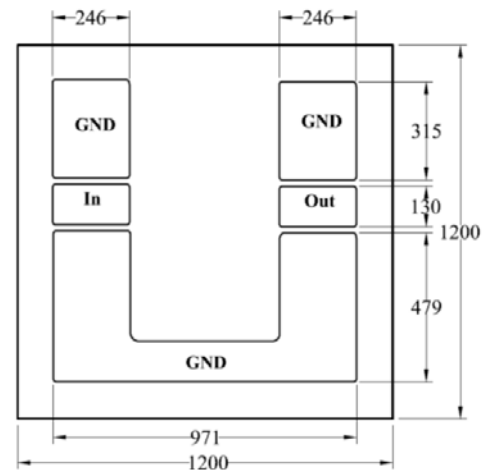
建议PCB布局图



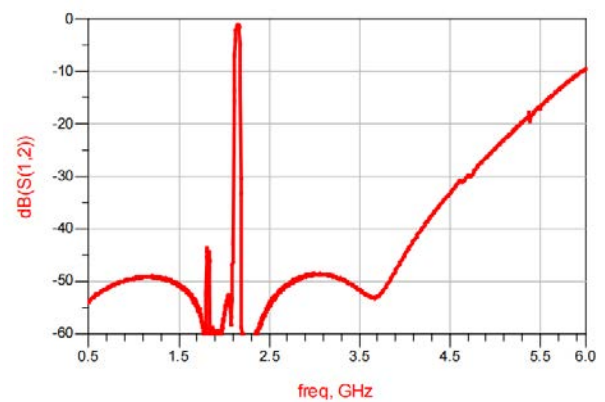
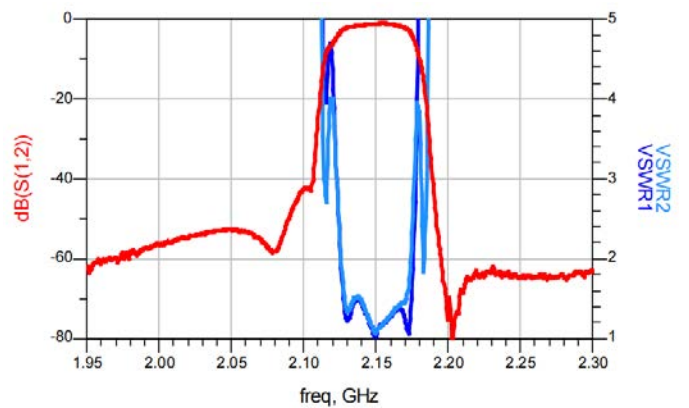
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

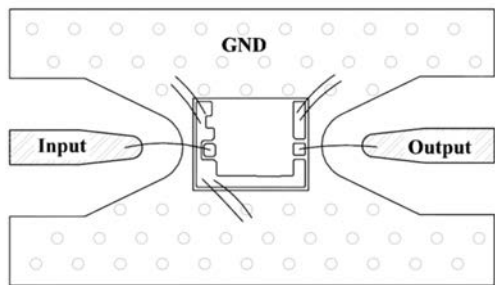
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2150		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.05	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.25	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

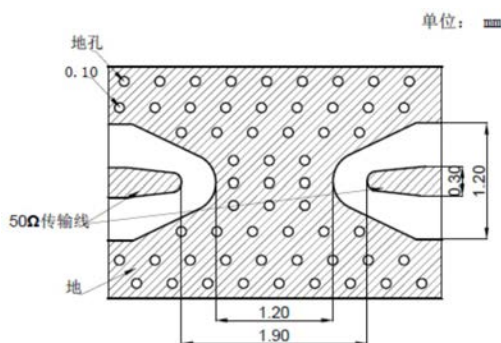
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

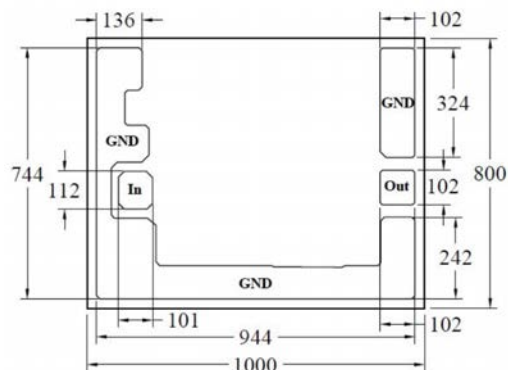
建议PCB布局图



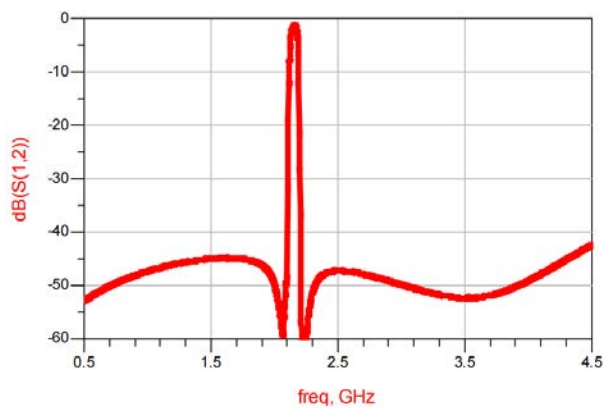
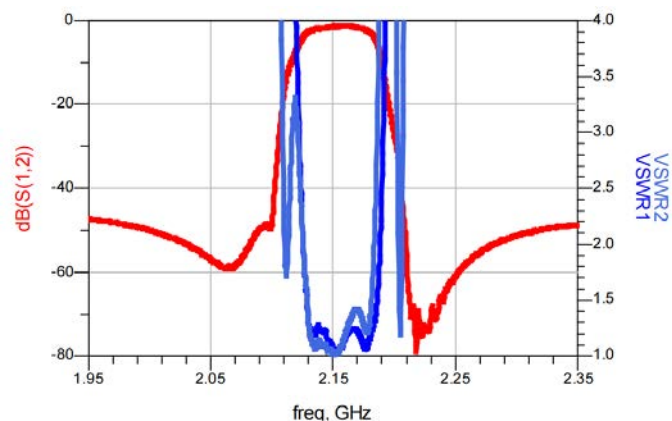
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

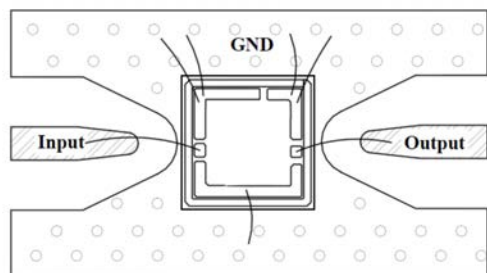
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2185		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	30			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	1.98-2.01	GHz $\geq$	45			dB
带外抑制	2.145	GHz $\geq$	8			dB
带外抑制	2.225	GHz $\geq$	8			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

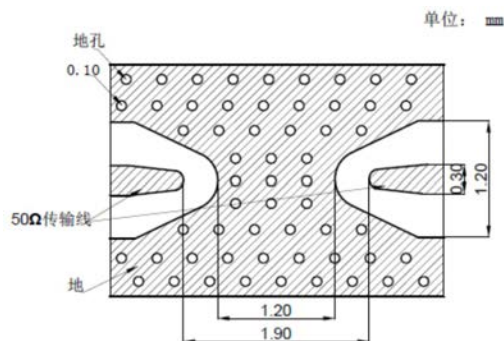
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

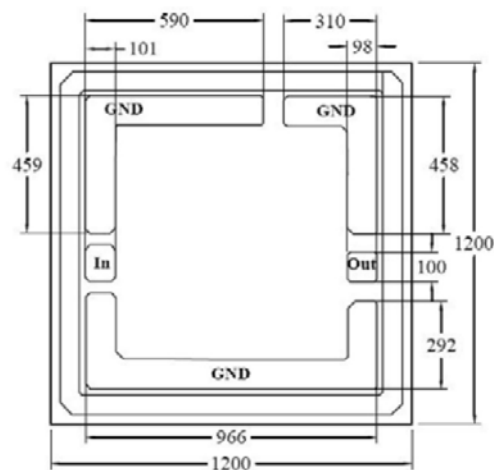
建议PCB布局图



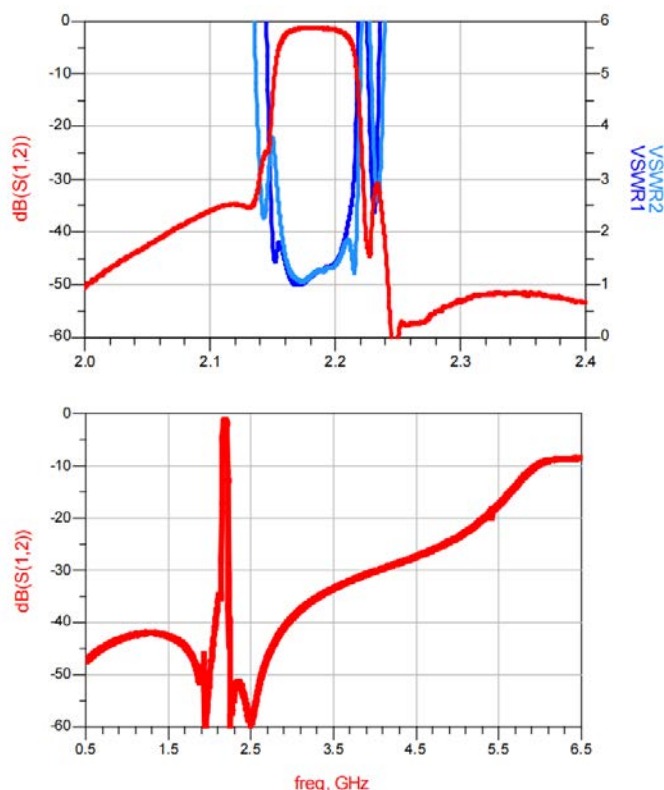
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

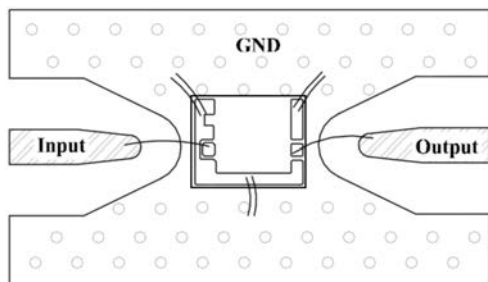
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2200		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	2.1	GHz≥	40	55		dB
带外抑制	2.3	GHz≥	40	55		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

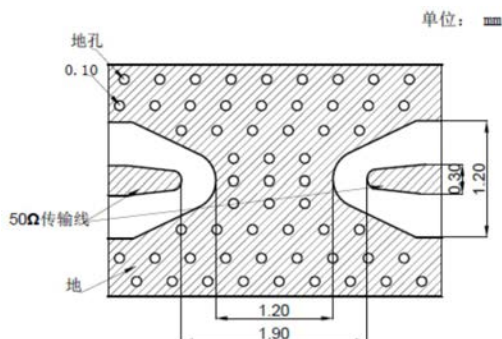
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

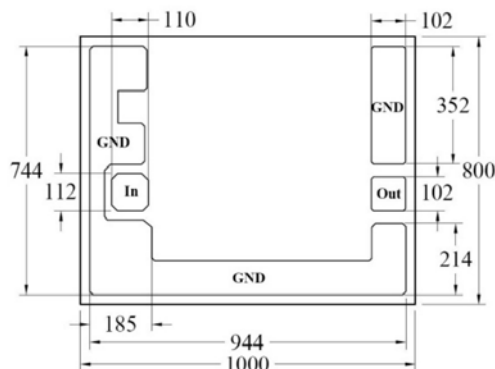
建议PCB布局图



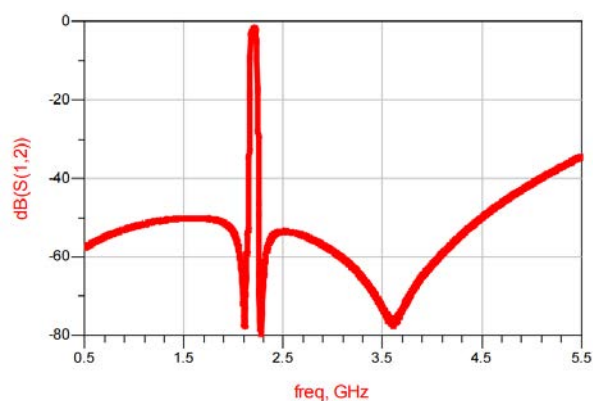
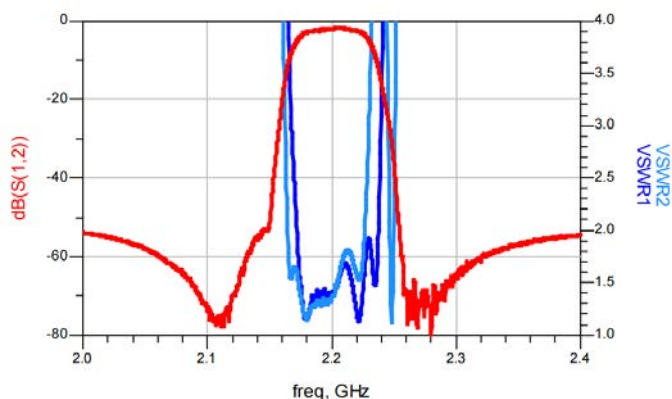
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

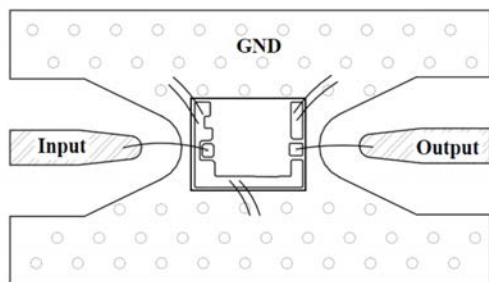
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2250		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.15	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.35	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

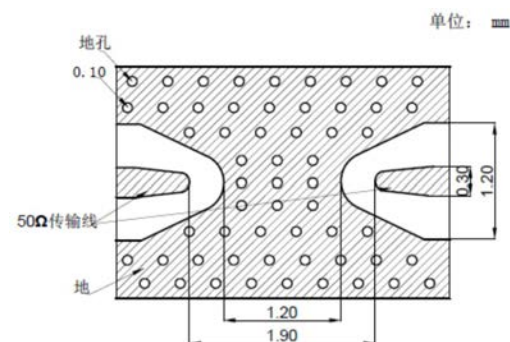
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

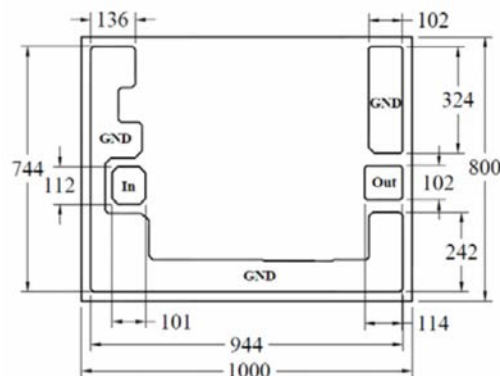
建议PCB布局图



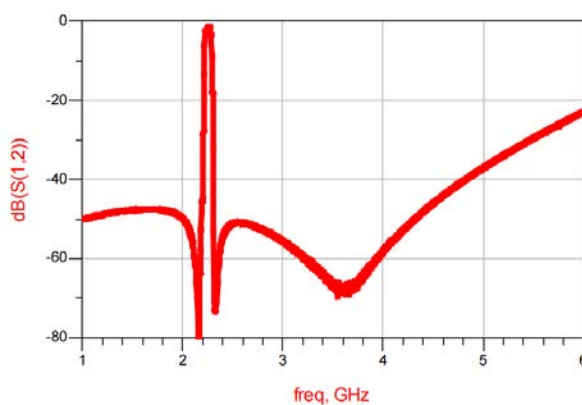
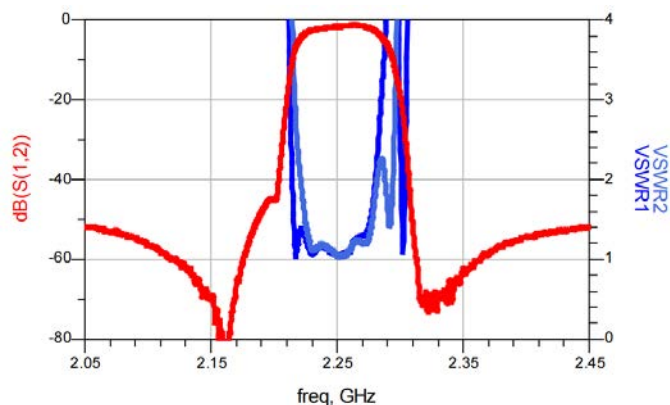
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

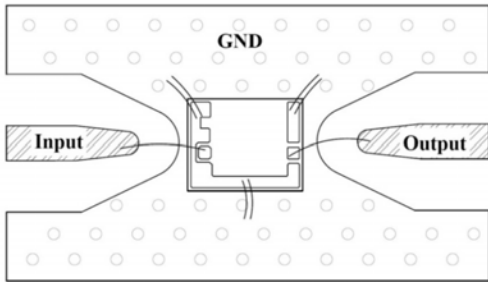
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2300		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.2	GHz≥	40	55		dB
带外抑制	2.4	GHz≥	40	55		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

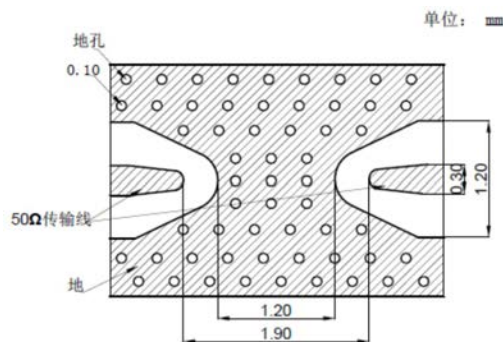
装配示意图



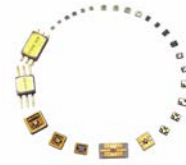
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

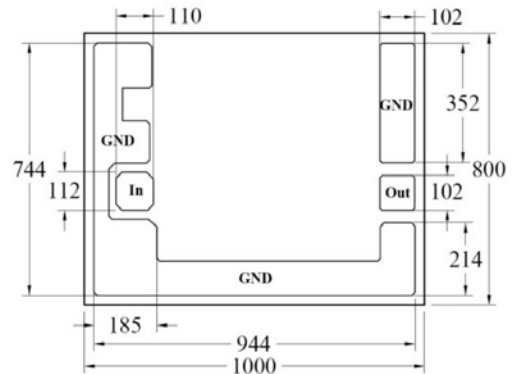
建议PCB布局图



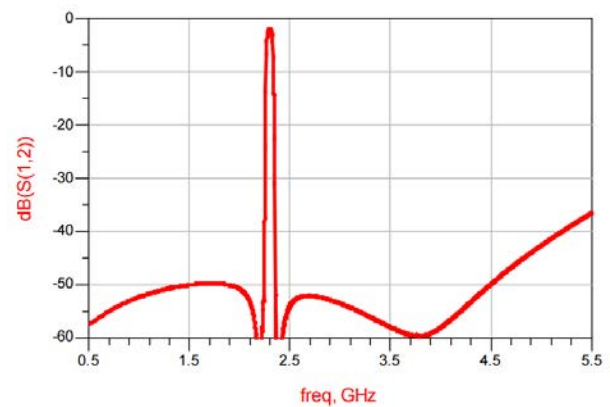
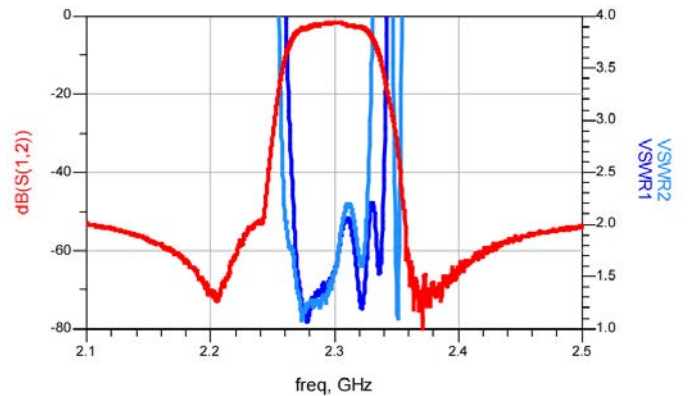
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

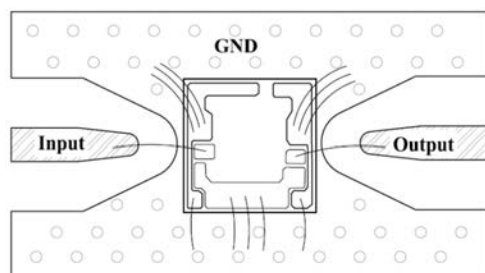
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2300		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	10			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-2.2	GHz≥	35			dB
带外抑制	2.4-5	GHz≥	35			dB
带外抑制	5-8	GHz≥	25			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤12ns
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

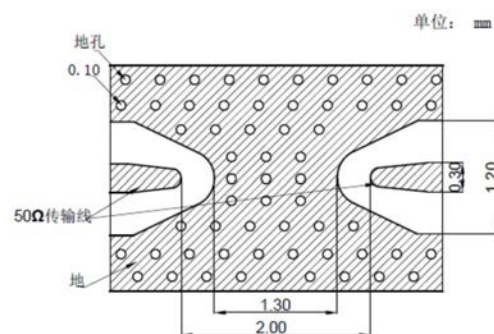
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

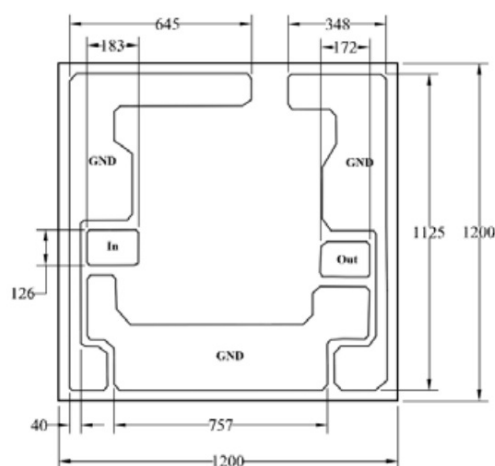
建议PCB布局图



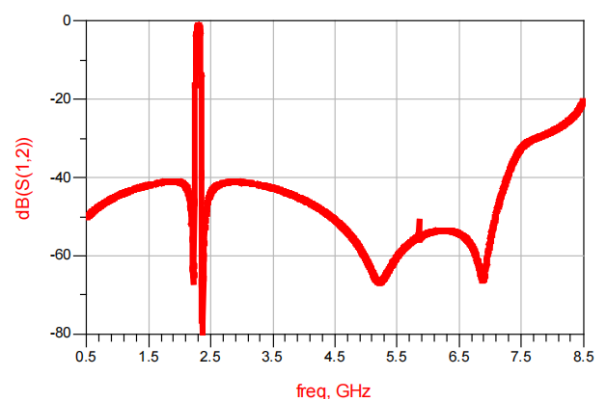
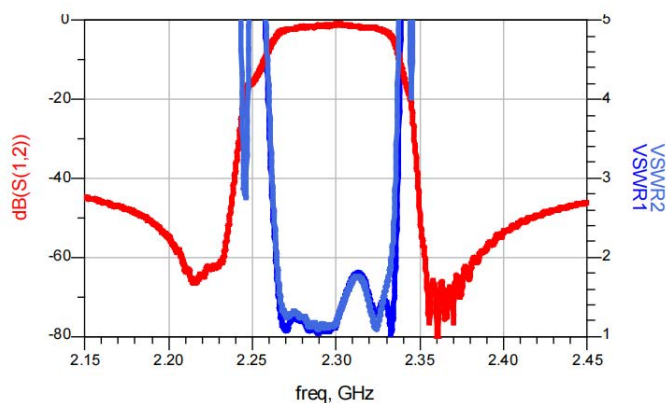
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

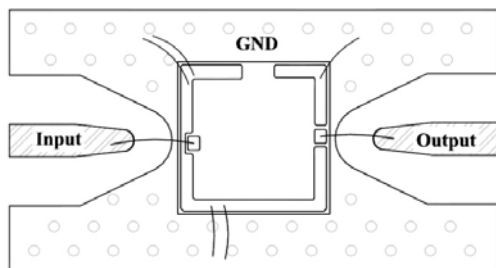
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2350		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.25	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.45	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

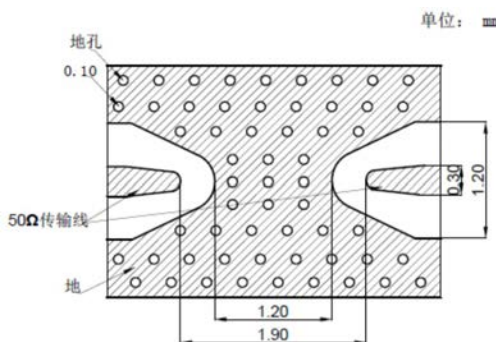
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

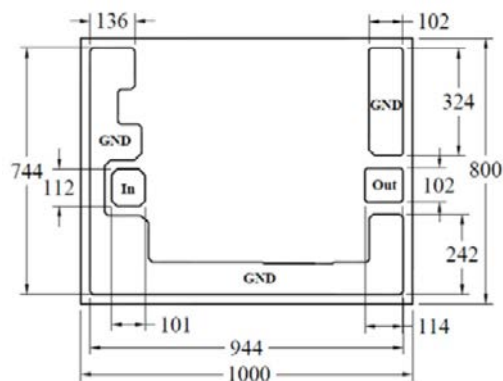
建议PCB布局图



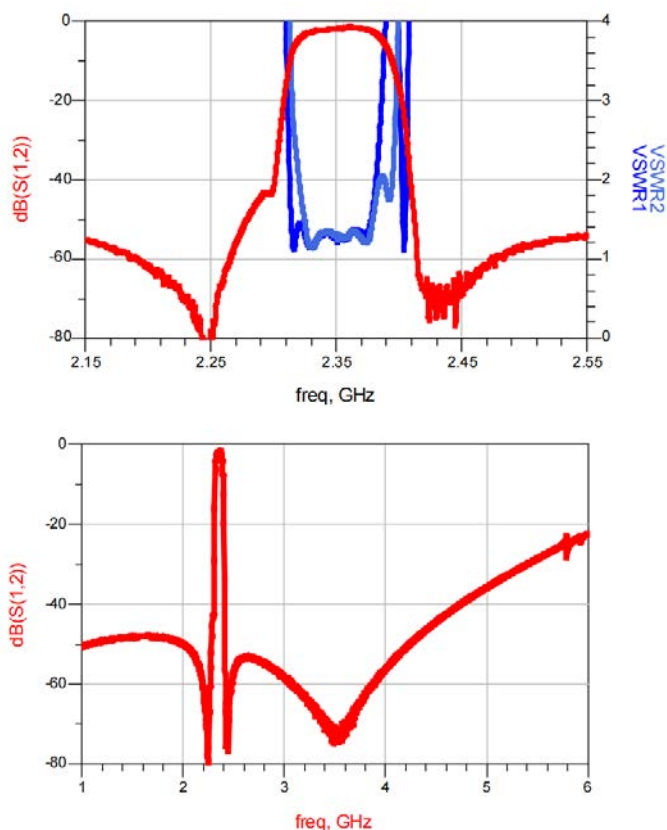
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

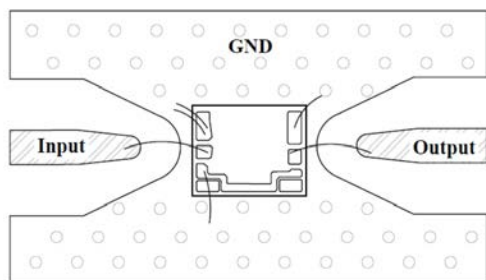
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2400		MHz
中心损耗	/	/		1.8	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	20		MHz
带外抑制	2.3	GHz≥	40	42		dB
带外抑制	2.5	GHz≥	40	50		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

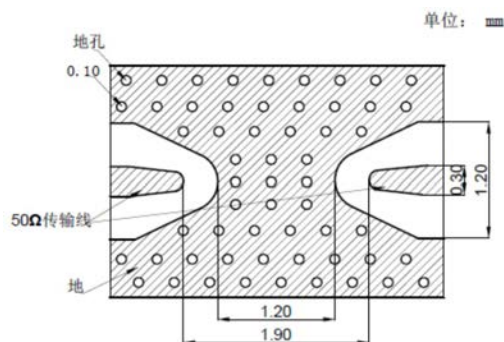
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

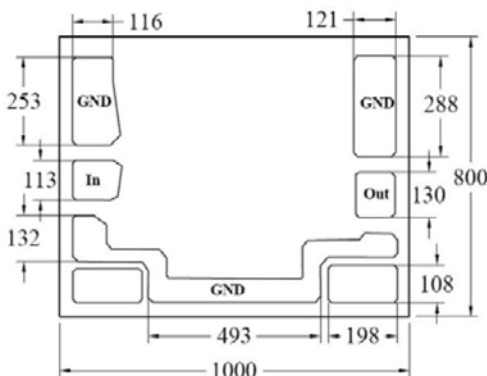
建议PCB布局图



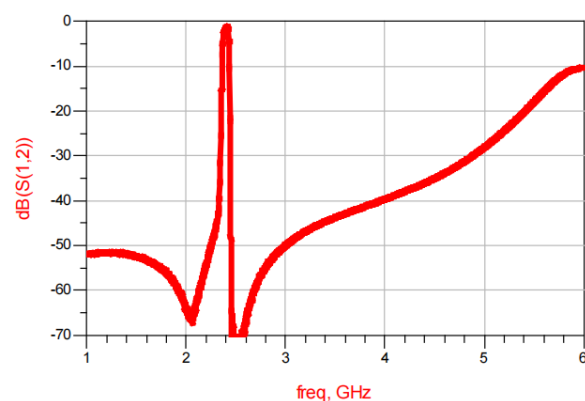
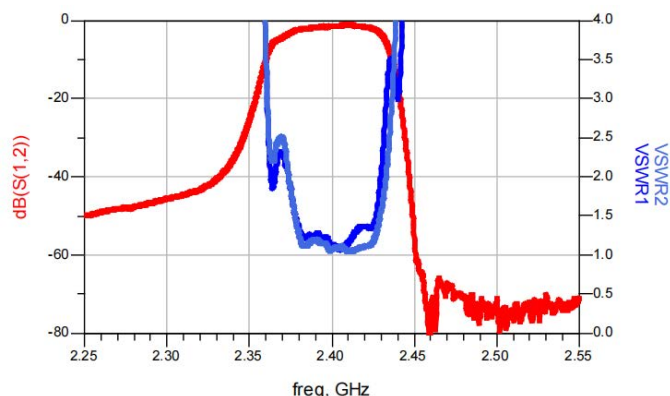
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

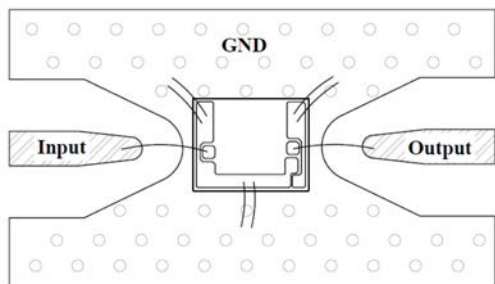
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2450		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.35	GHz≥	40	45		dB
带外抑制	2.55	GHz≥	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

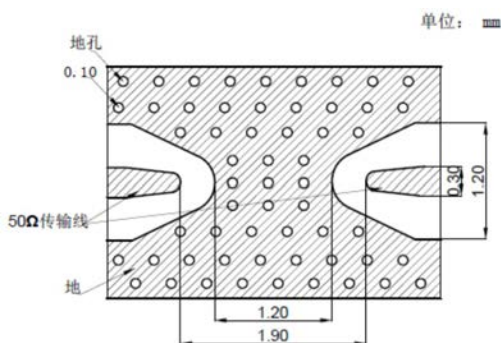
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

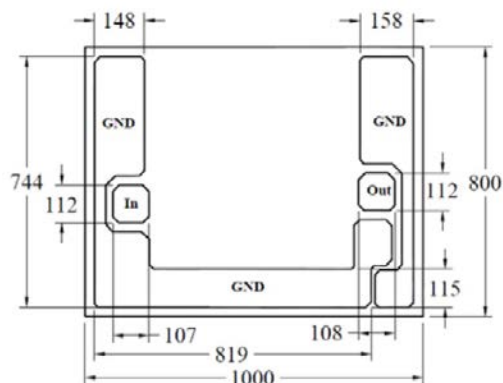
建议PCB布局图



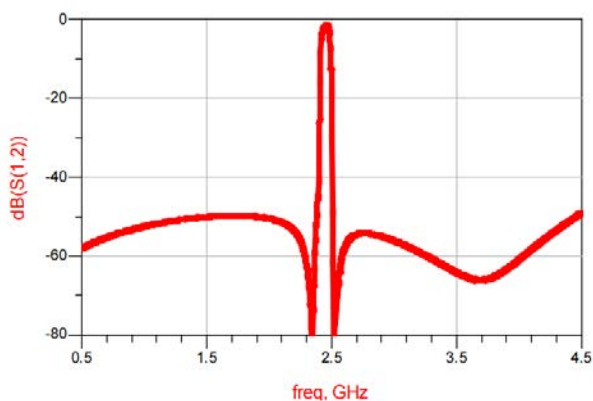
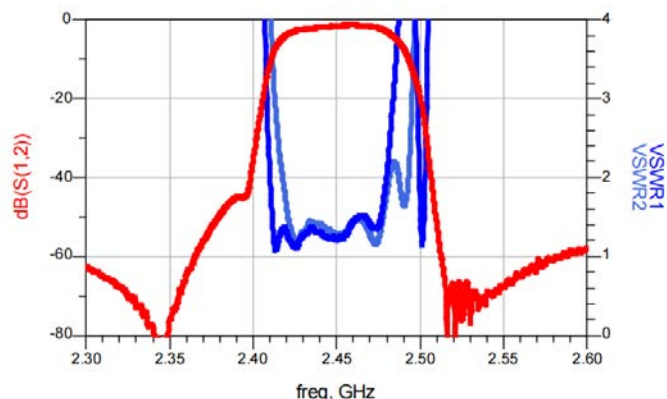
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

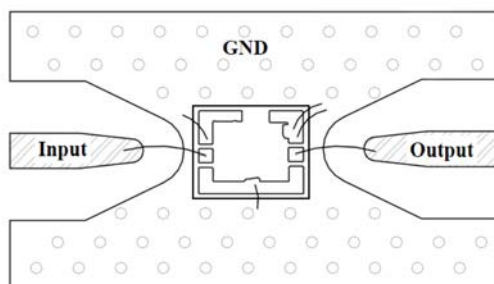
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2460		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20			MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	2.4	GHz $\geq$	38	45		dB
带外抑制	2.34	GHz $\geq$	38	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

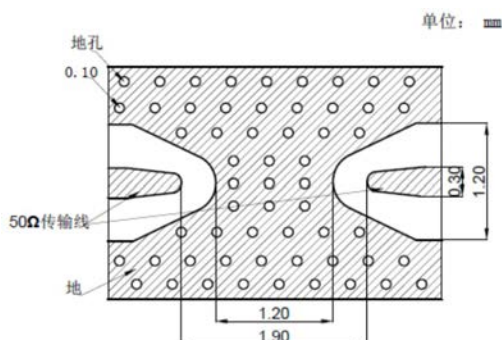
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

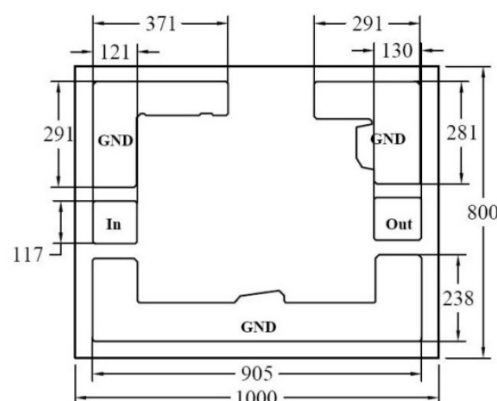
建议PCB布局图



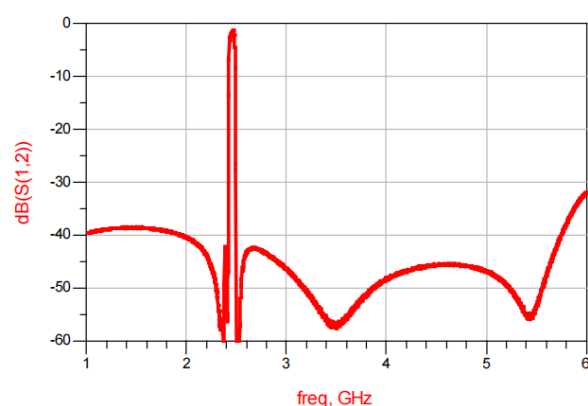
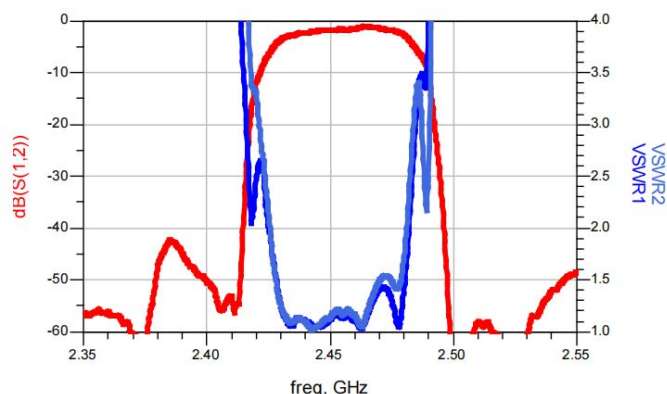
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

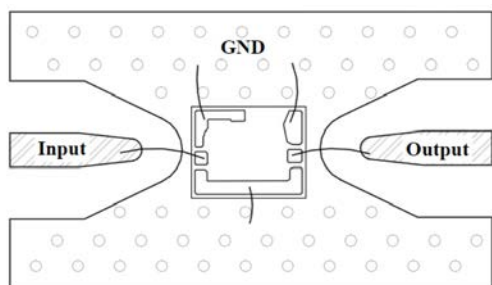
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2483		MHz
中心损耗	/	/		1.8	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	12	20		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	2.433	GHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	2.533	GHz $\geq$	35	40		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

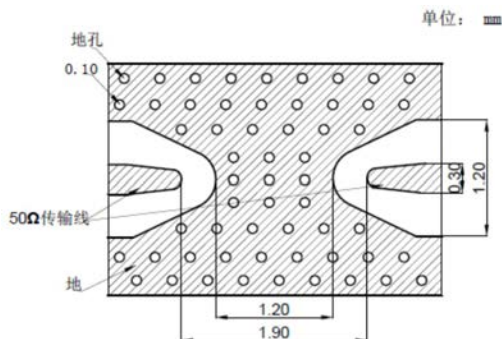
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

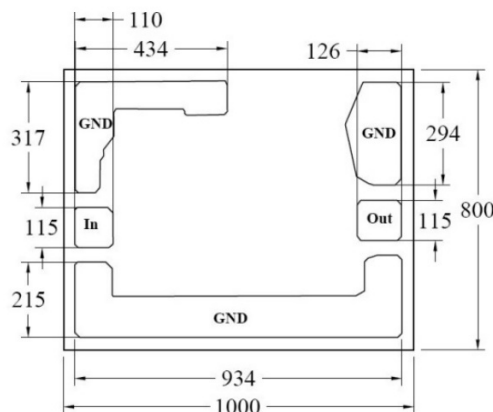
建议PCB布局图



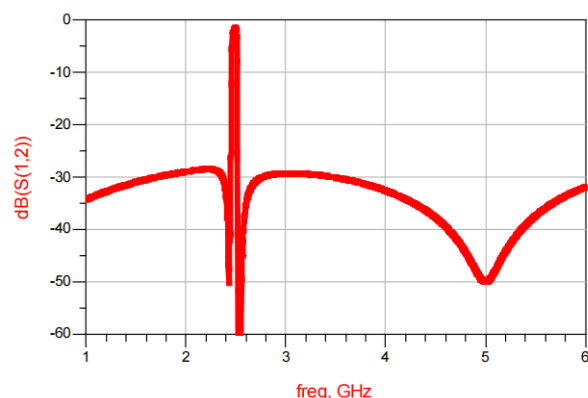
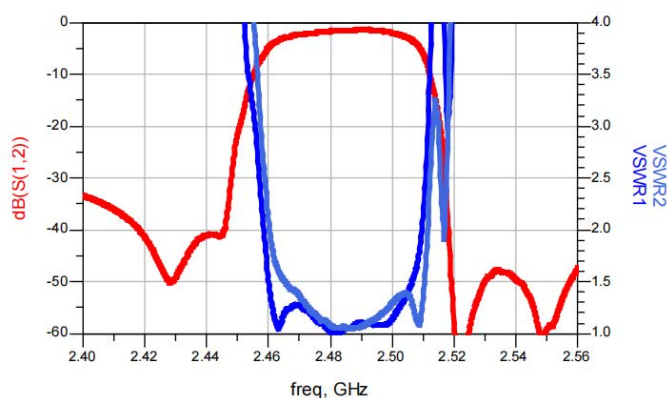
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

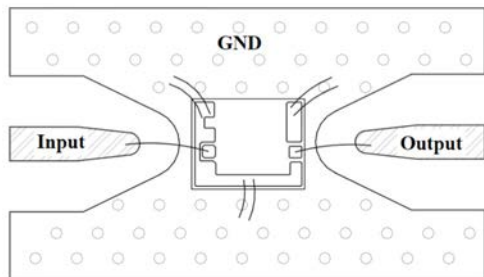
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2500		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.4	GHz $\geq$	40	50		dB
带外抑制	2.6	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/		2.0	2.2	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

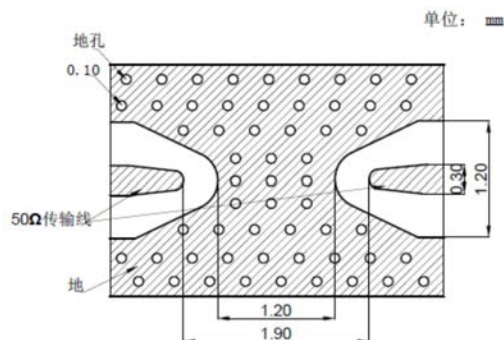
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

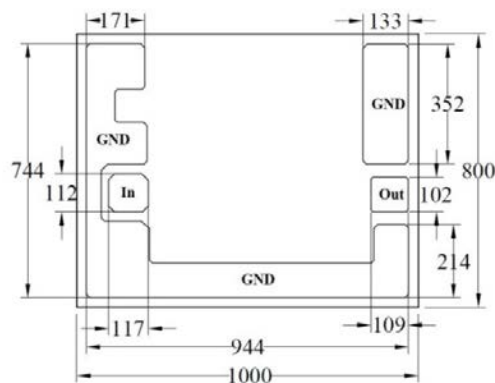
建议PCB布局图



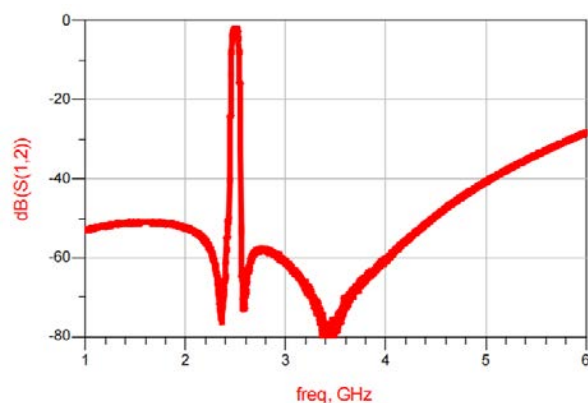
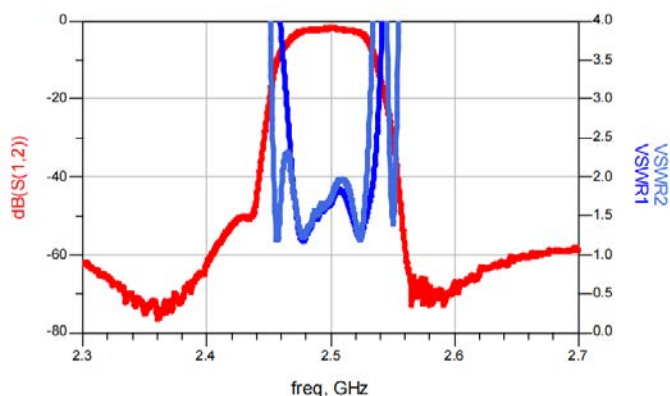
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

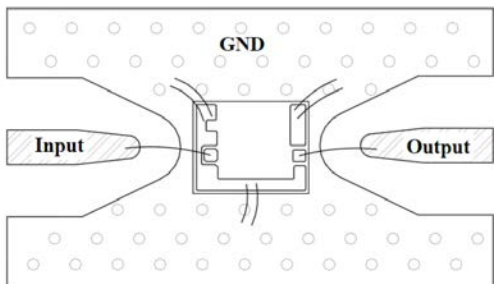
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2600		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.5	GHz $\geq$	40	50		dB
带外抑制	2.7	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/		2.0	2.5	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

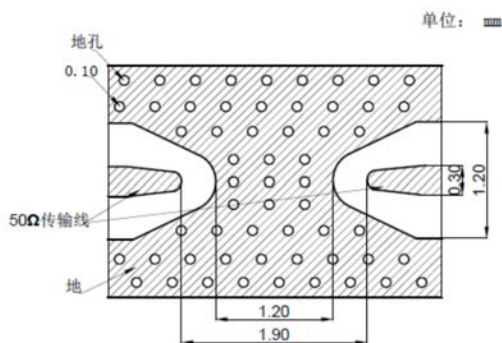
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

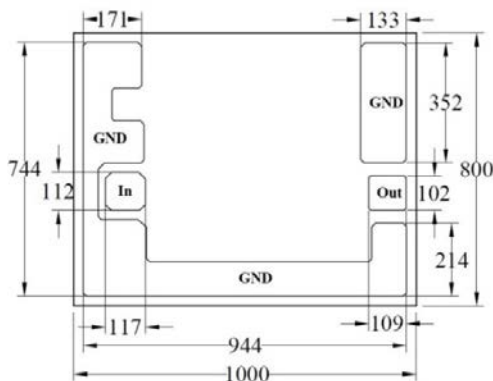
建议PCB布局图



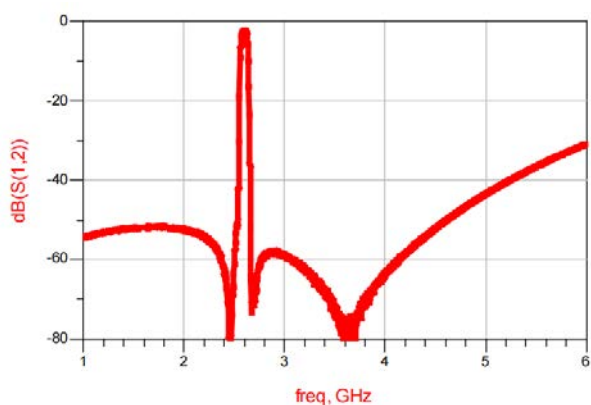
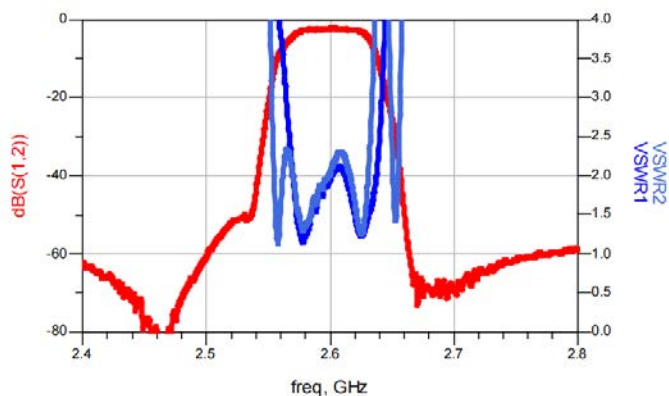
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

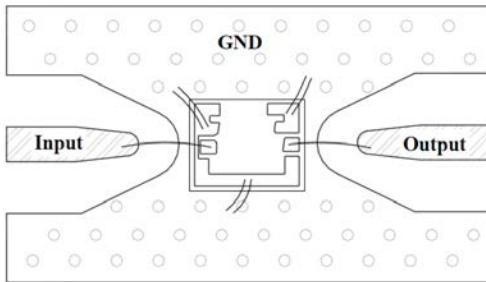
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2700		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	20		MHz
带外抑制	2.62	GHz≥	40	45		dB
带外抑制	2.78	GHz≥	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

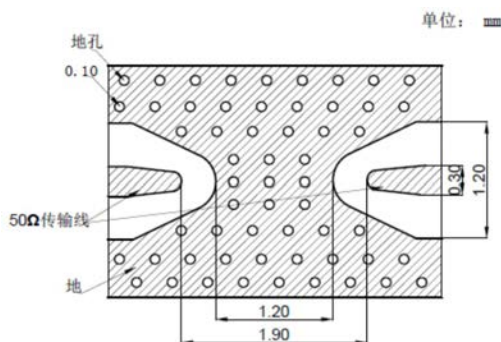
装配示意图



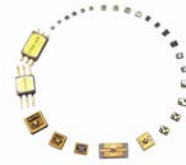
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

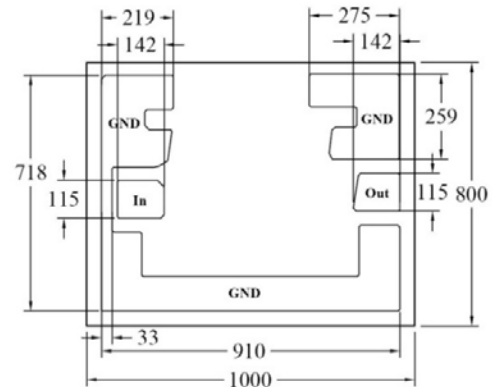
建议PCB布局图



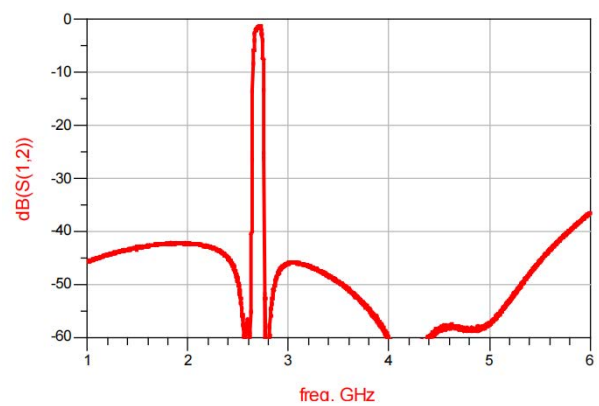
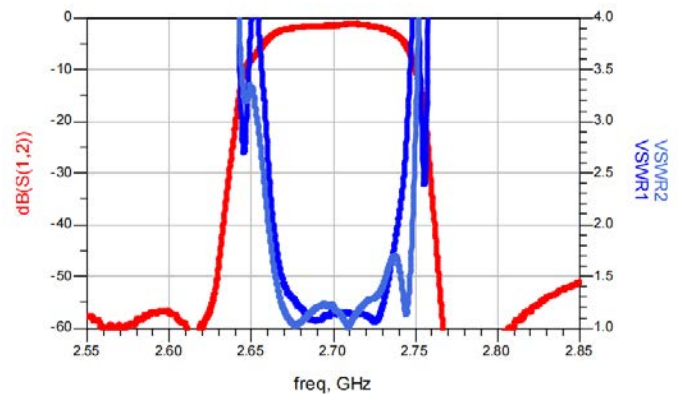
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

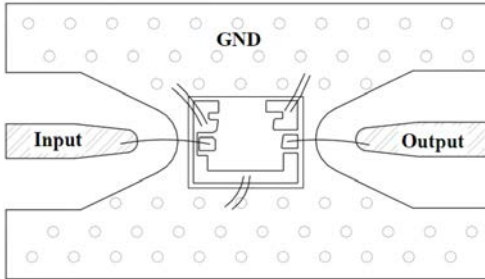
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2800		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.7-2.9	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	2.3-3.3	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

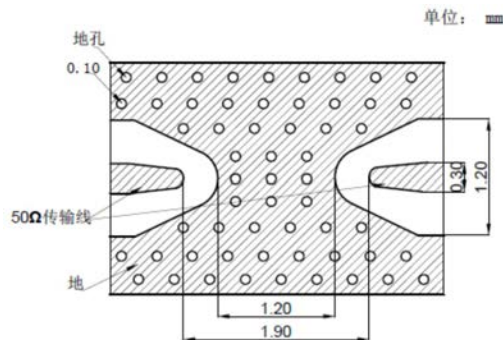
装配示意图



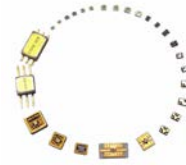
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

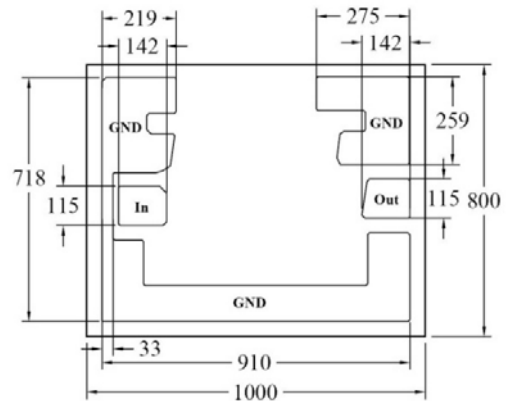
建议PCB布局图



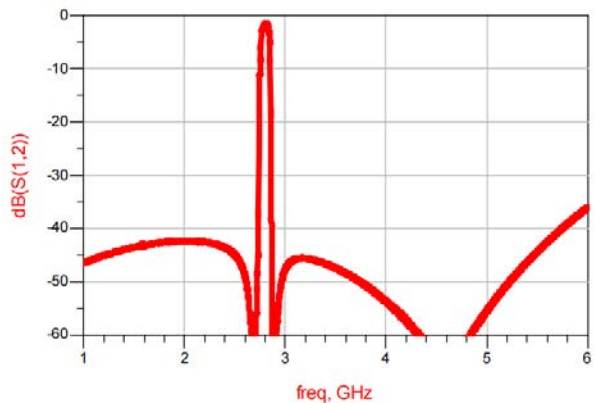
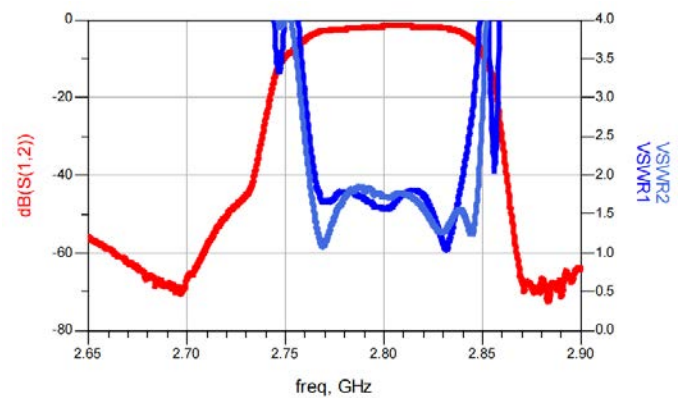
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

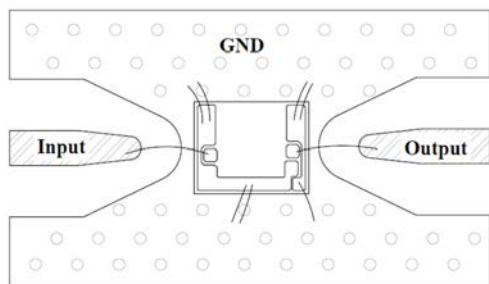
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2900		MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.8	GHz≥	40	45		dB
带外抑制	3	GHz≥	40	45		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

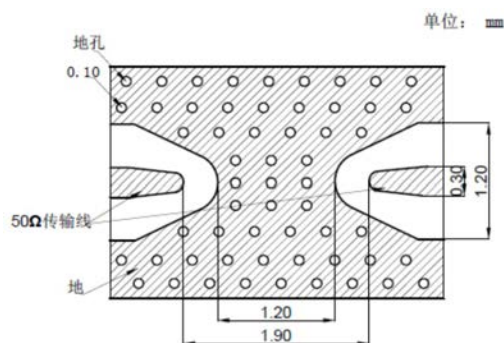
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

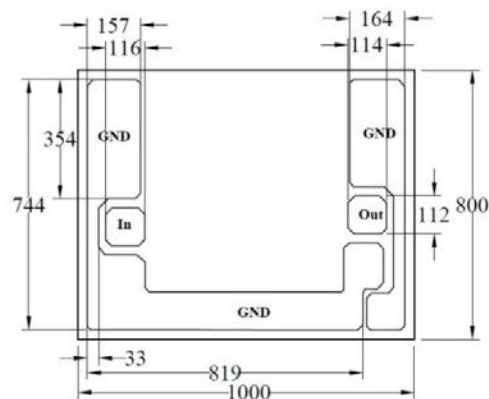
建议PCB布局图



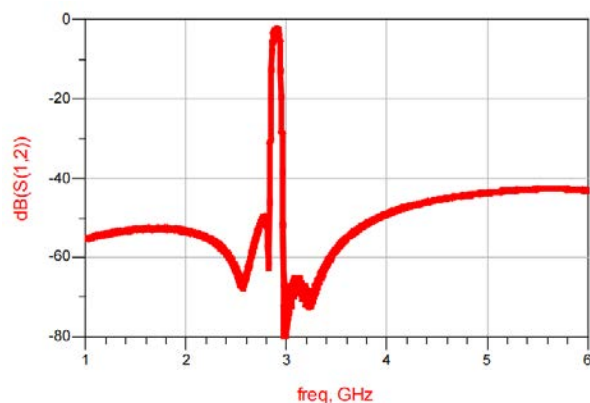
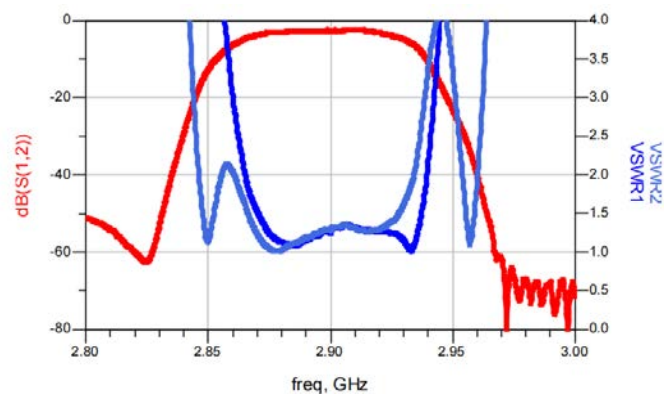
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

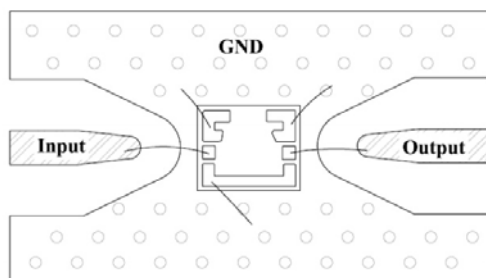
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		2900		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	80	90		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	2.65-2.76	GHz≥	30	35		dB
带外抑制	3.03-3.14	GHz≥	35	40		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤10ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

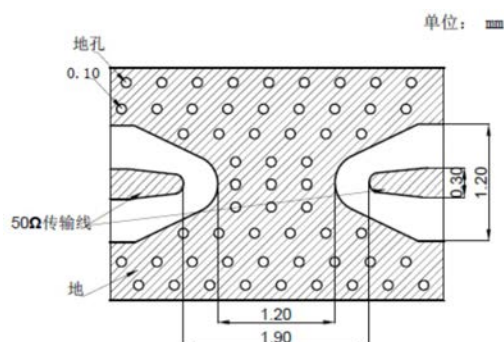
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

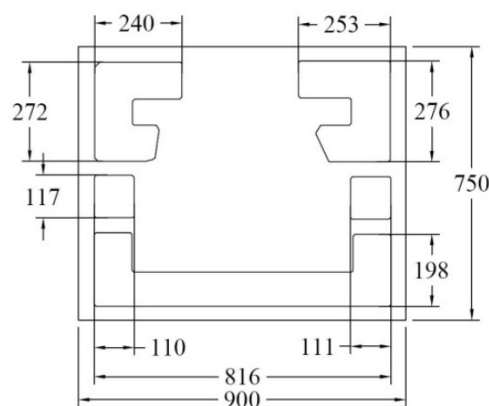
建议PCB布局图



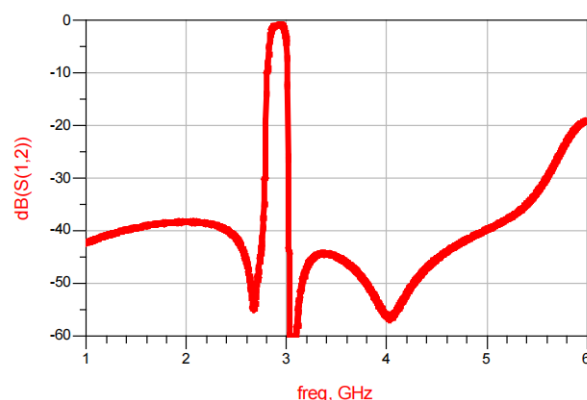
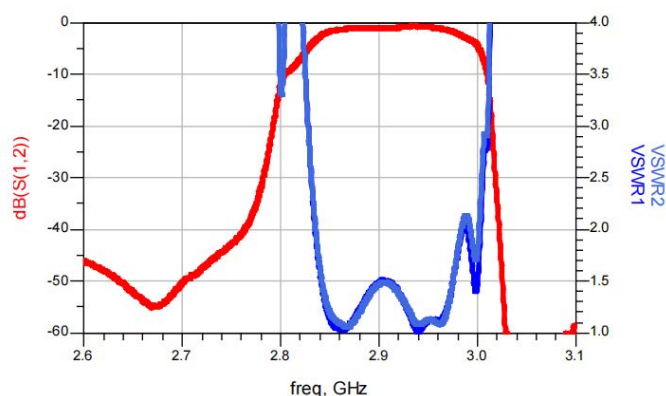
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

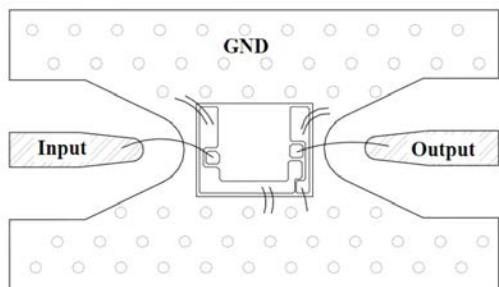
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3000		MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2.9	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	3.1	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 25 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

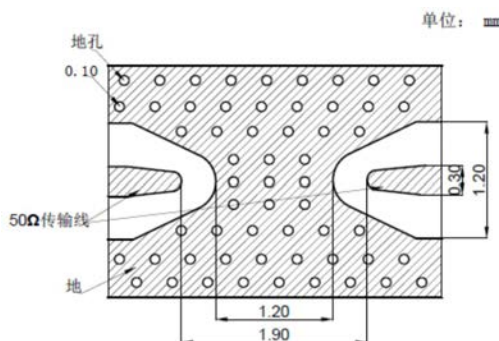
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

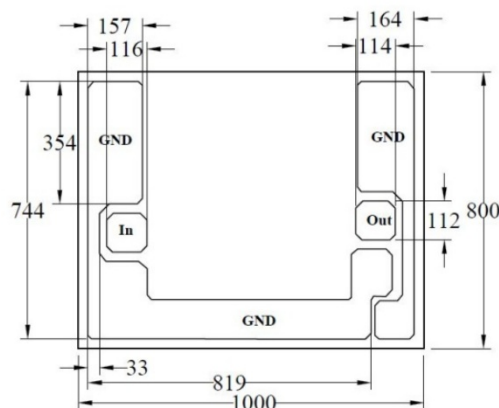
建议PCB布局图



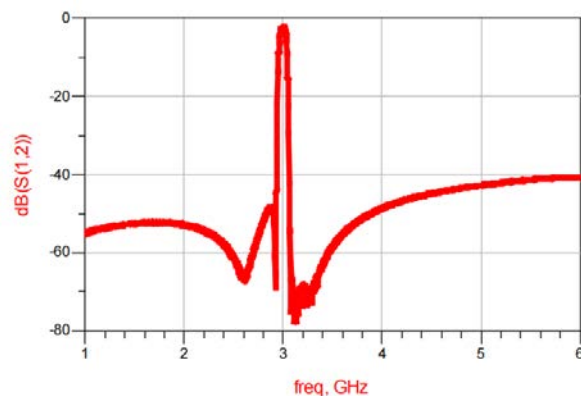
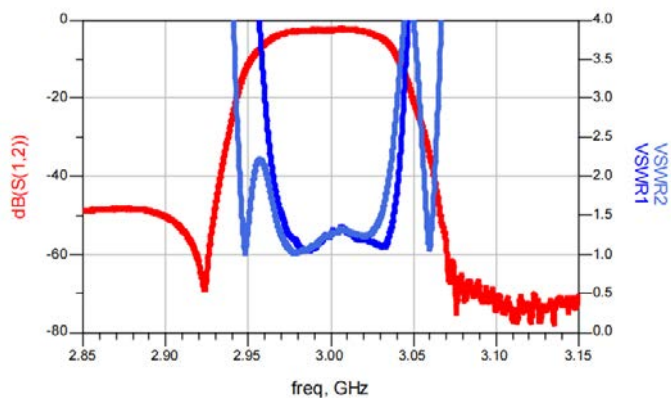
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

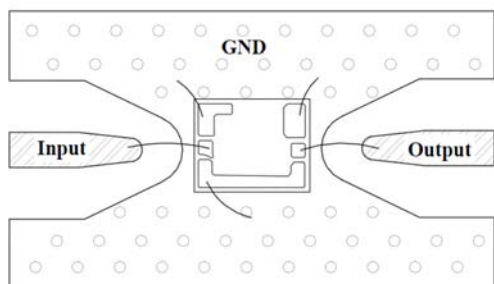
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3060		MHz
中心损耗	/	/		1.8	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	80	90		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	2.86-2.93	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	3.17-3.26	GHz $\geq$	35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 10 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

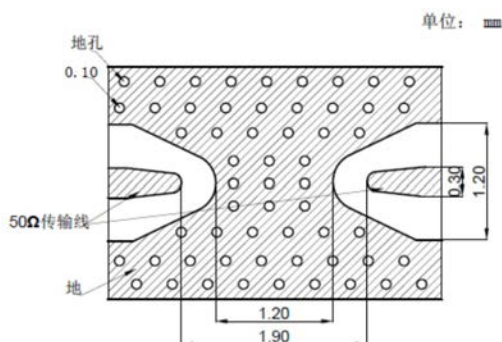
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

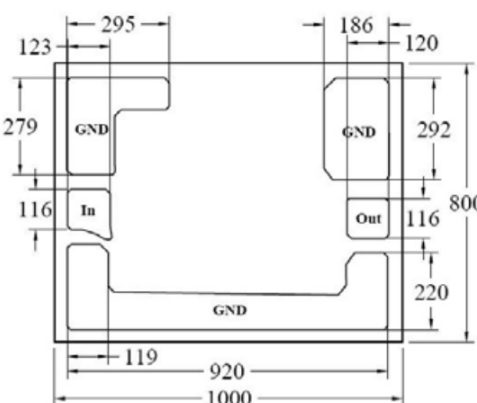
建议PCB布局图



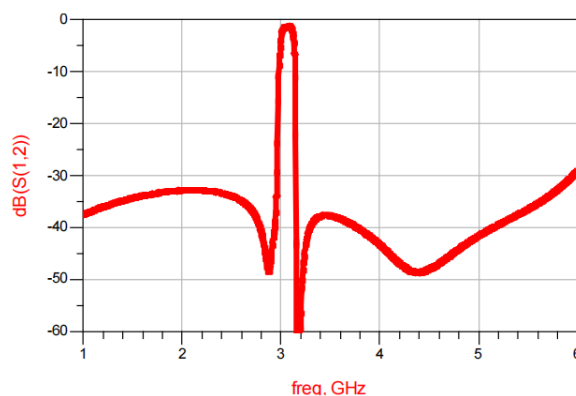
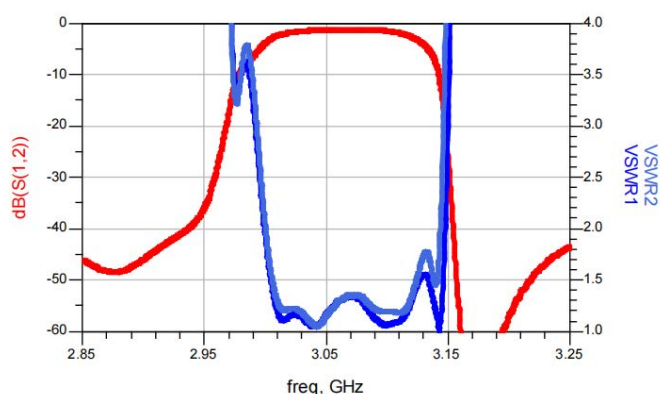
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

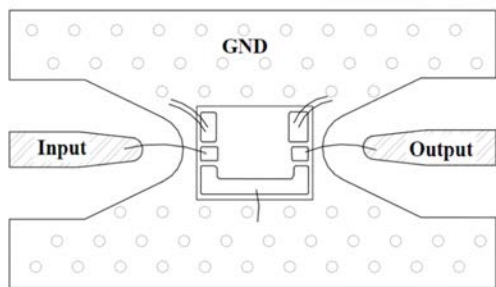
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3100		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	3	GHz $\geq$	40	45		dB
带外抑制	3.2	GHz $\geq$	40	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

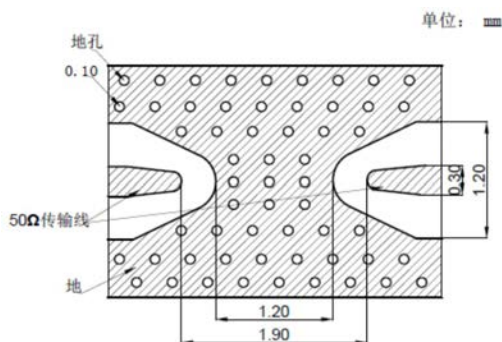
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

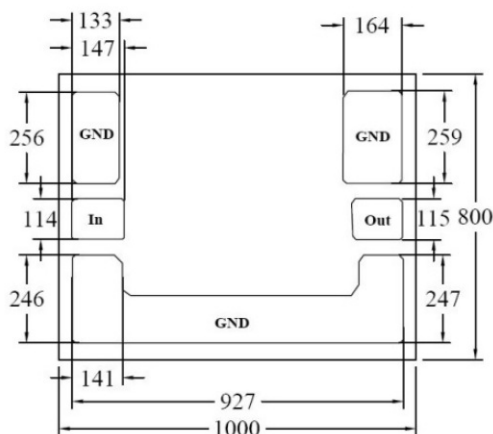
建议PCB布局图



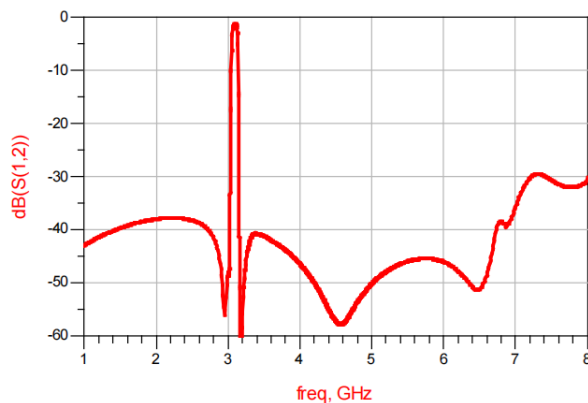
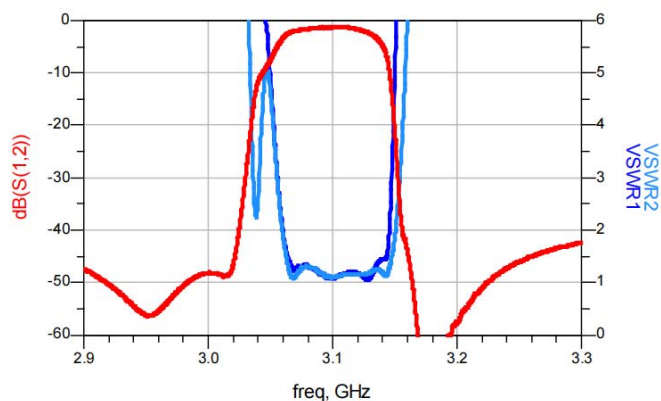
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

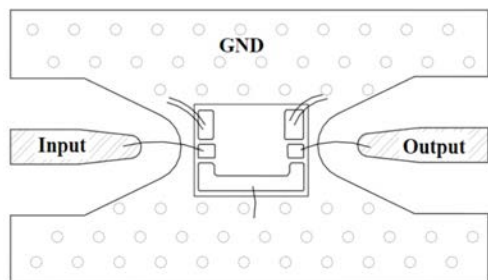
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3200		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	3.1	GHz $\geq$	40	42		dB
带外抑制	3.3	GHz $\geq$	40	50		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

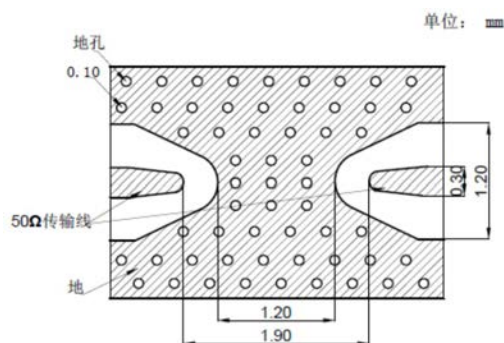
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

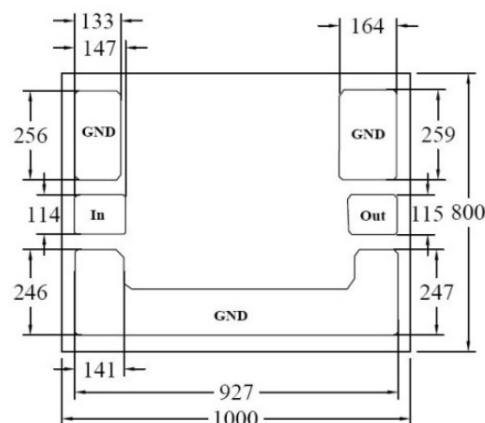
建议PCB布局图



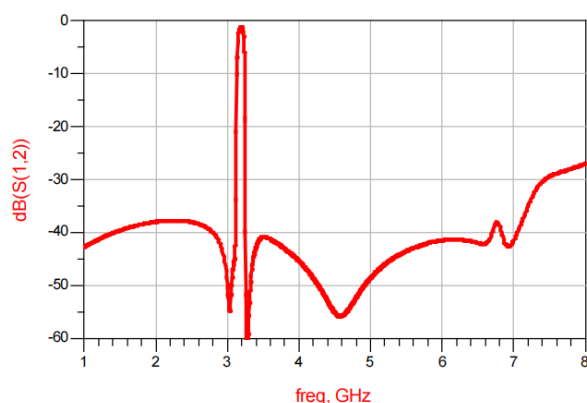
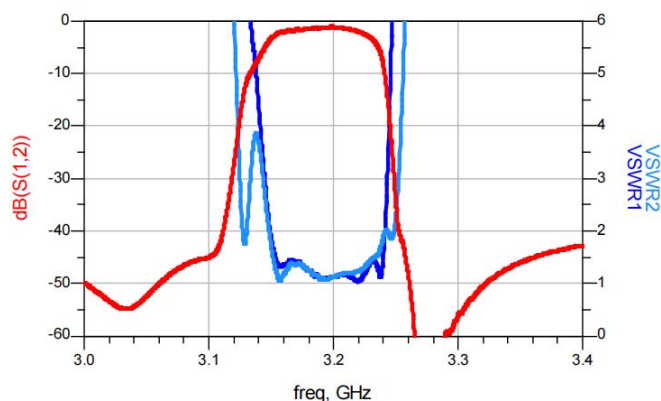
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

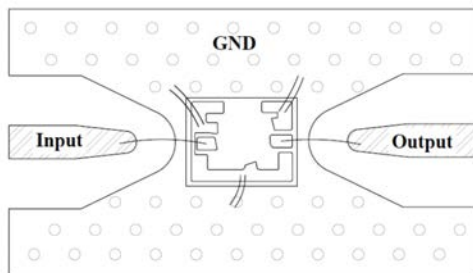
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3300		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	3.2	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	3.4	GHz≥	38	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

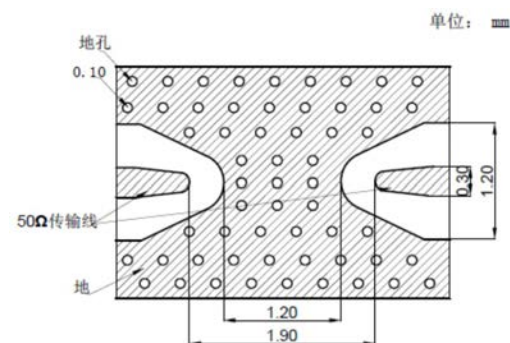
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

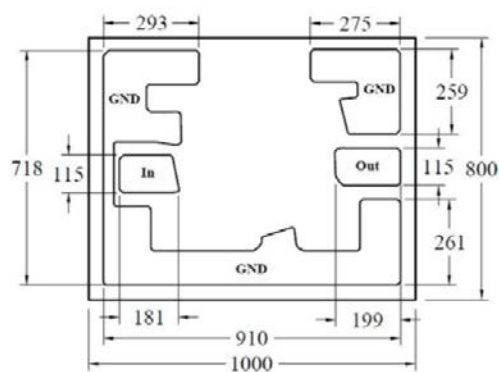
建议PCB布局图



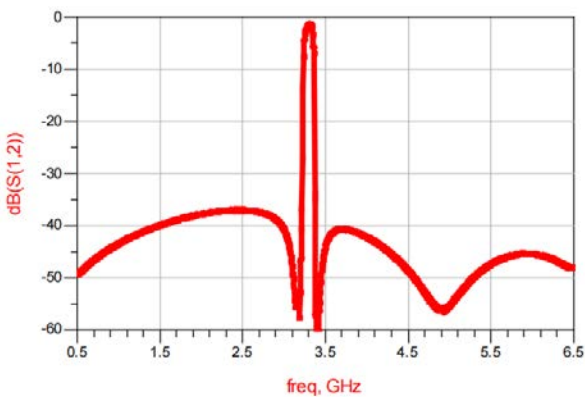
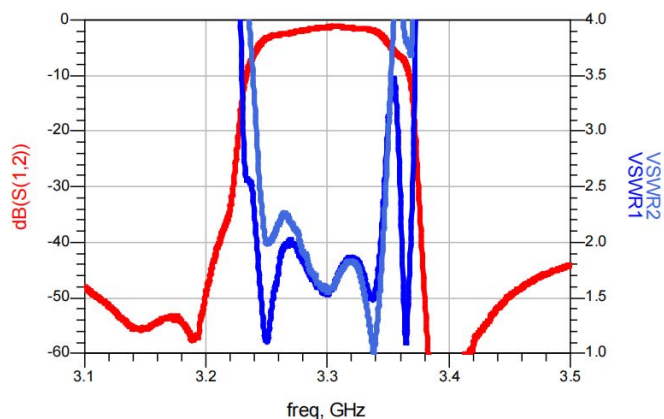
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

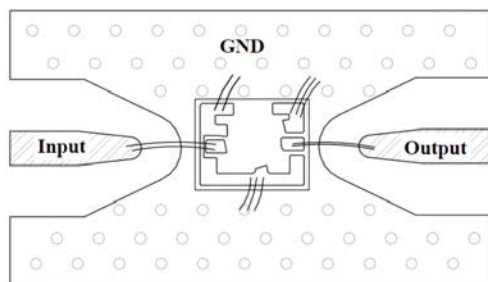
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3400		MHz
中心损耗	/	/		1.5	2.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	40		MHz
带外抑制	3.3	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	3.5	GHz≥	38	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

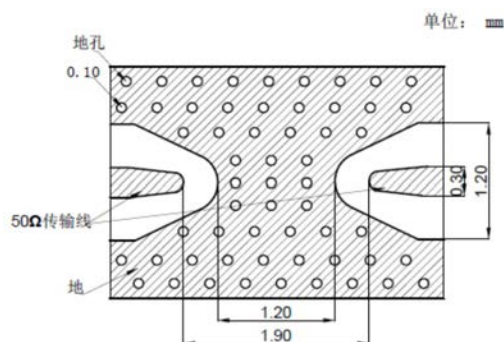
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

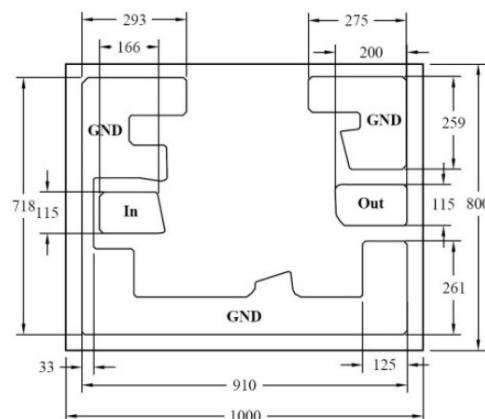
建议PCB布局图



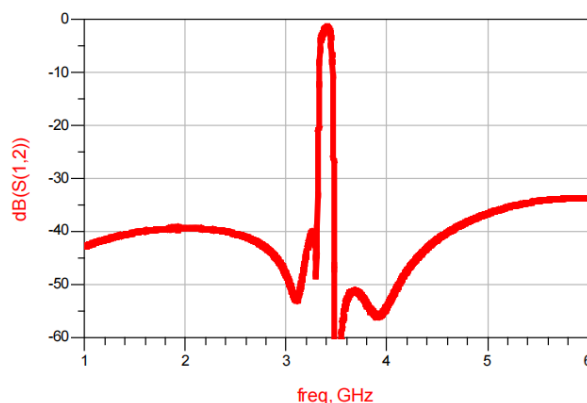
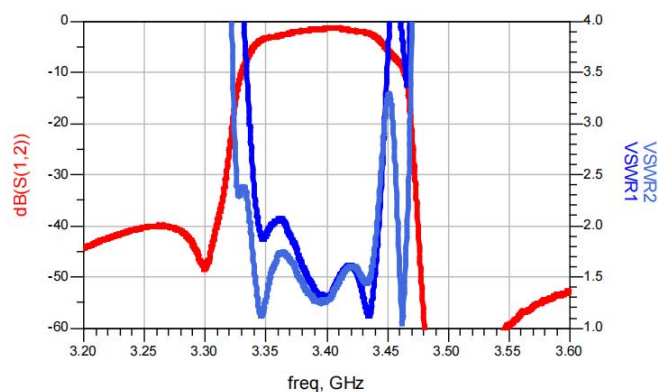
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

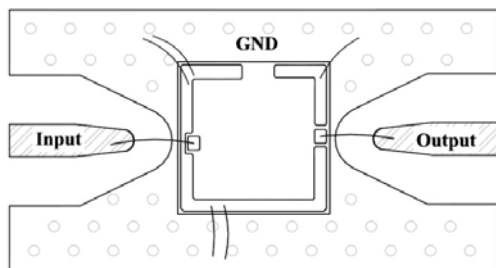
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3500		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	点频	50		MHz
带外抑制	1.4-3.4	GHz $\geq$	30	33		dB
带外抑制	3.6-4.4	GHz $\geq$	35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

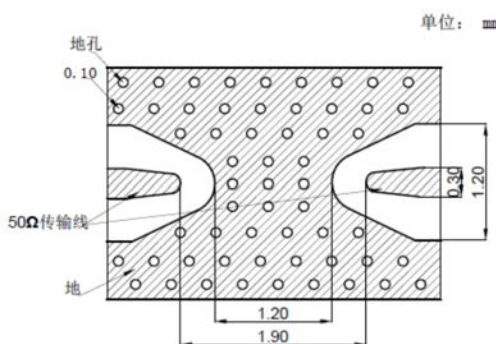
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

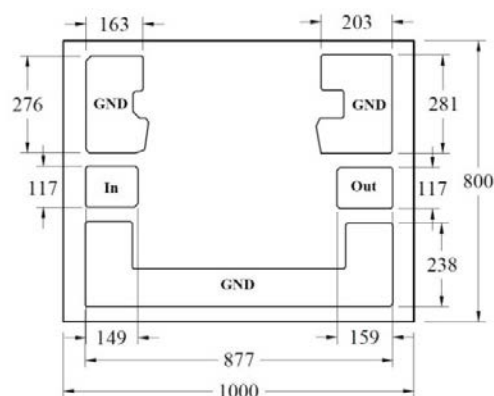
建议PCB布局图



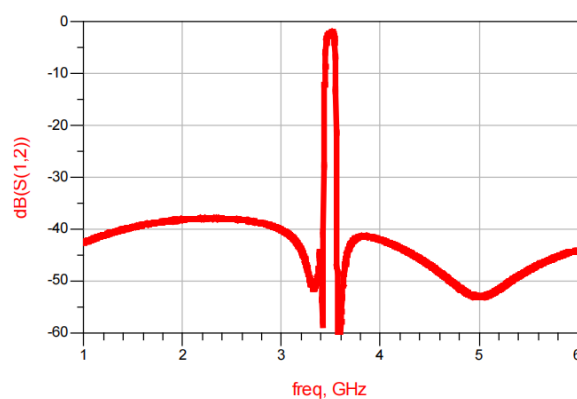
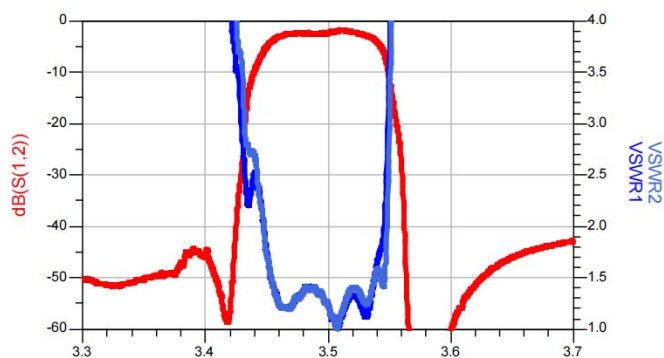
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

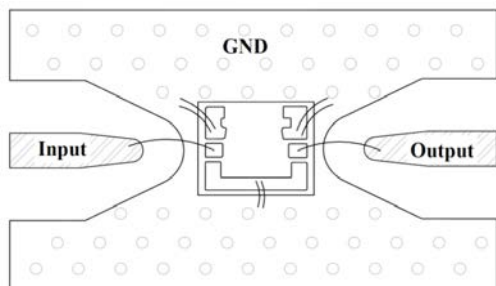
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3600		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	40	50		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	1.5-3.5	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	3.7-4.5	GHz $\geq$	35	38		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

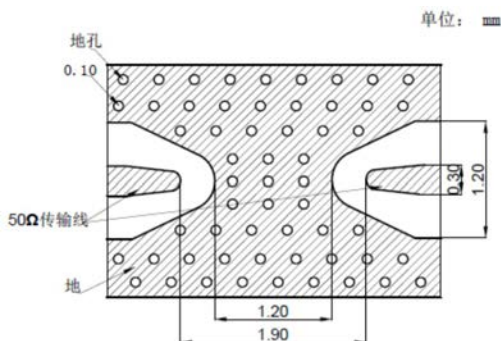
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

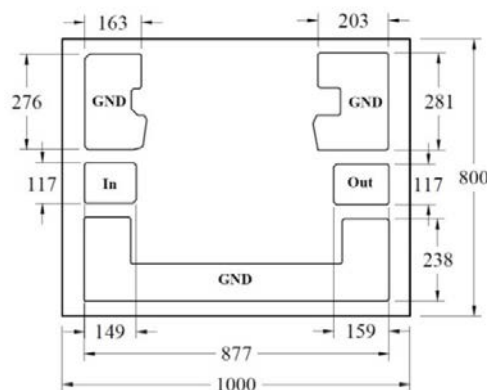
建议PCB布局图



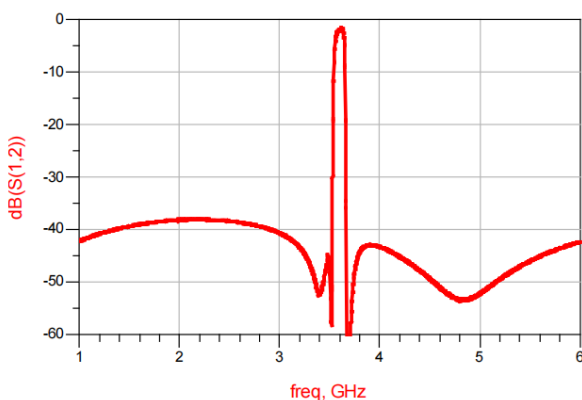
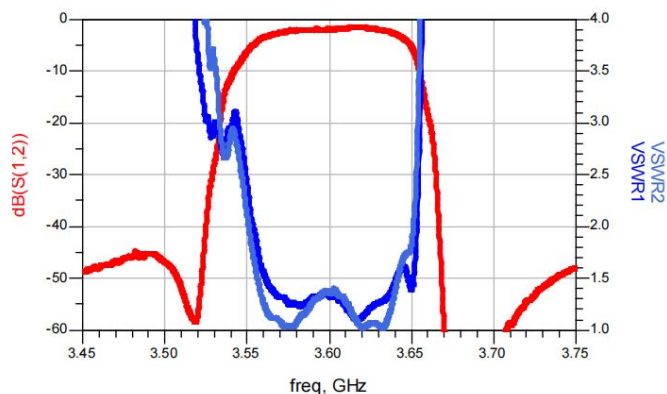
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

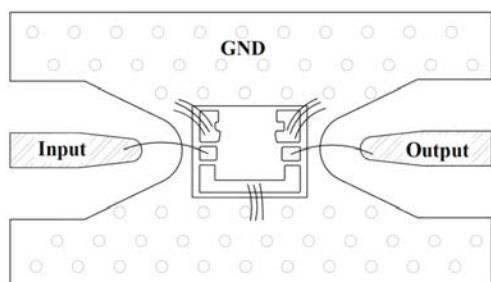
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3650		MHz
中心损耗	/	/			3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	20	30		MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-3.555	GHz $\geq$	30	32		dB
带外抑制	3.73-6.05	GHz $\geq$	35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 15 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

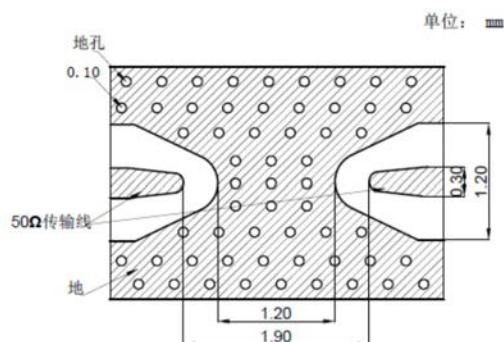
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

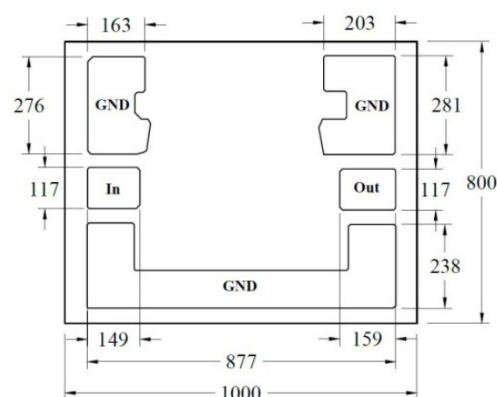
建议PCB布局图



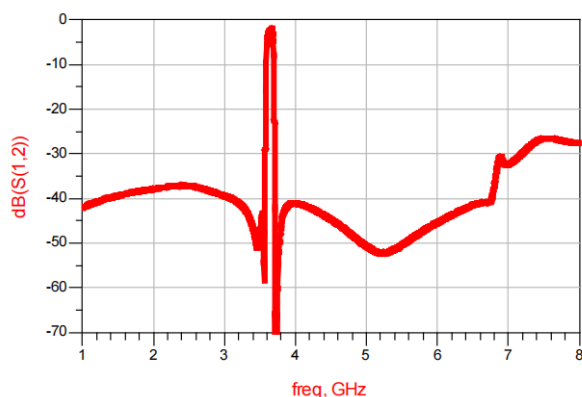
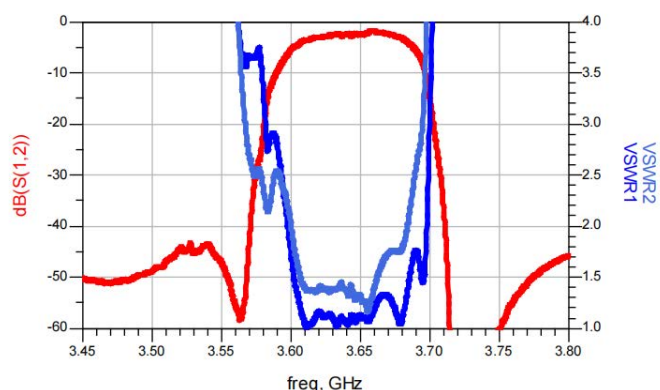
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

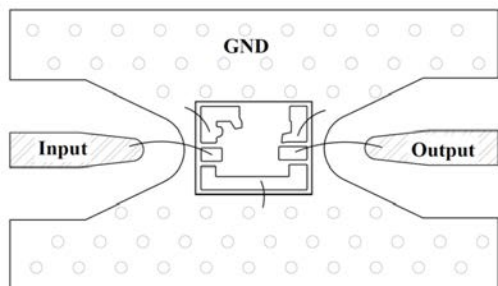
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3670		MHz
中心损耗	/	/		2.0	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	19	25		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	3.6	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	3.74	GHz≥	40	45		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤10ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

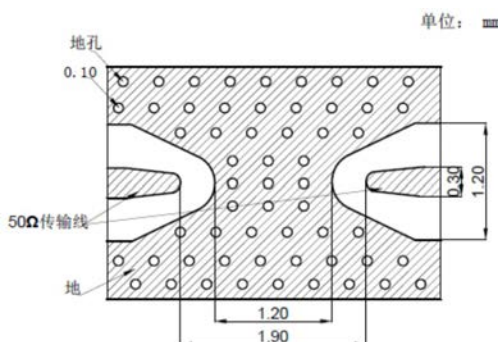
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

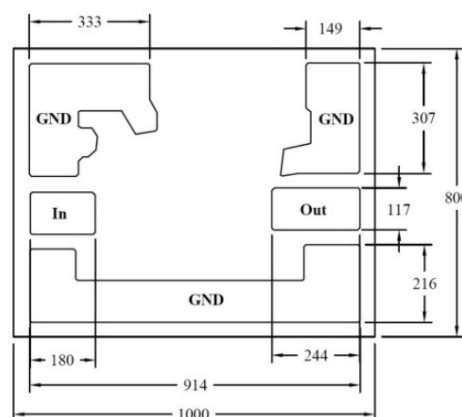
建议PCB布局图



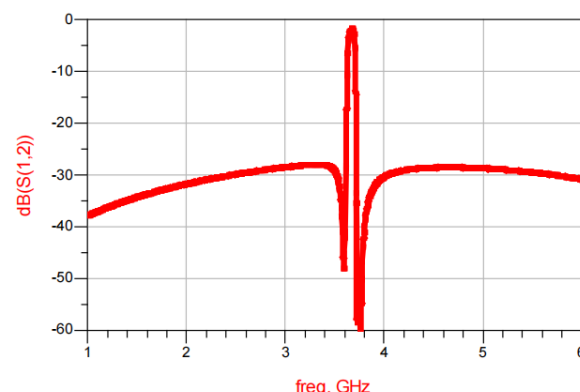
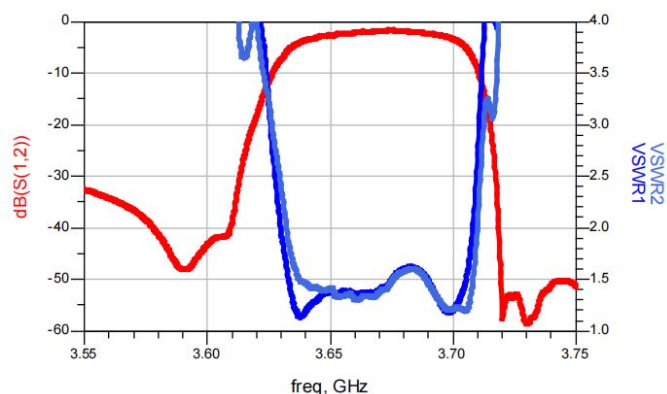
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

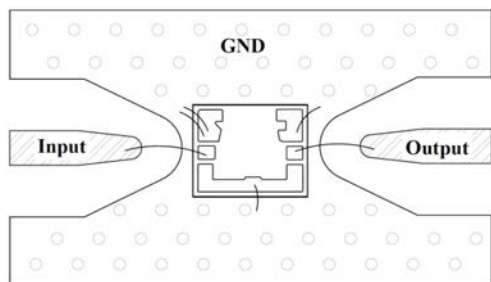
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3670		MHz
中心损耗	/	/		1.8	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	60	70		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	1-3.5	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	3.8-6	GHz $\geq$	35	40		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 10 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

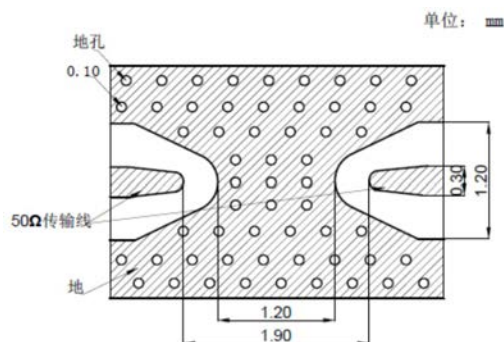
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

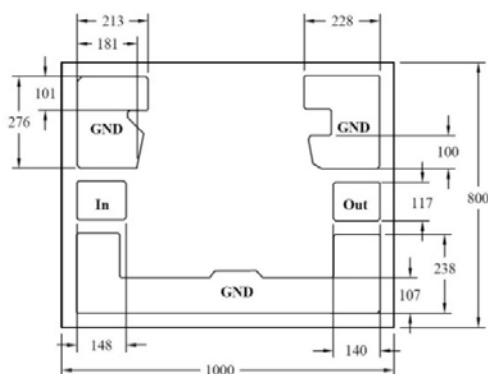
建议PCB布局图



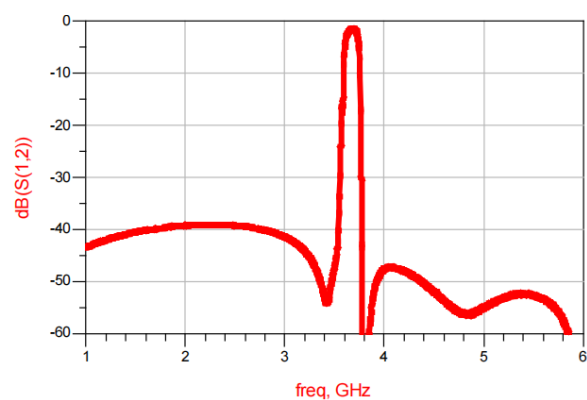
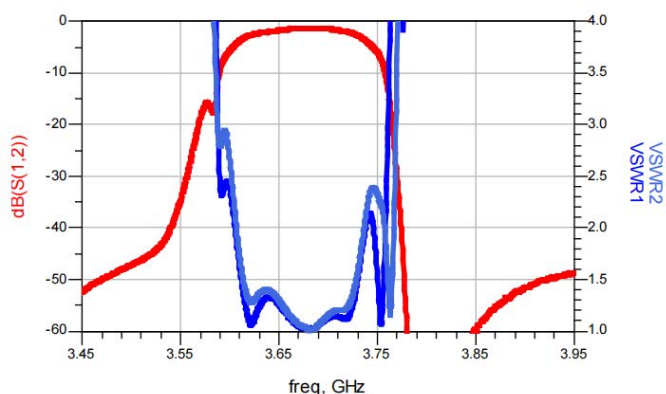
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

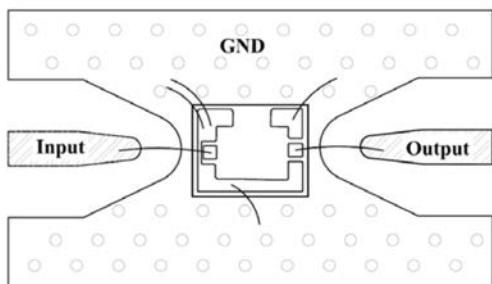
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3780		MHz
中心损耗	/	/		2.0	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	80	90		MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3.6	GHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	3.9-4.5	GHz $\geq$	35	40		dB
带外抑制	3.42		35	40		dB
带外抑制	DC-3.35		25	30		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 12 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

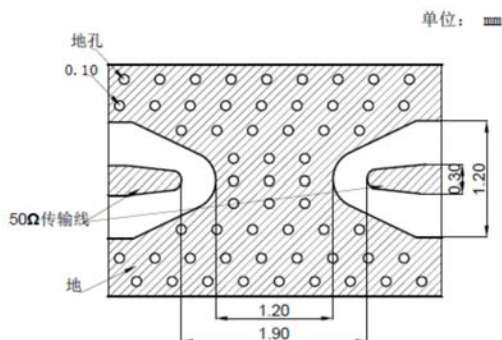
装配示意图



装配及使用说明

1. 芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
2. 芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
3. 芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
4. 芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

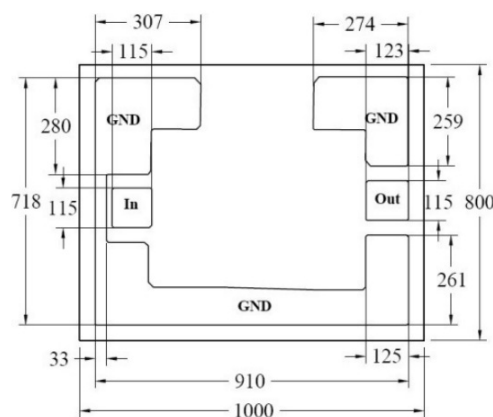
建议PCB布局图



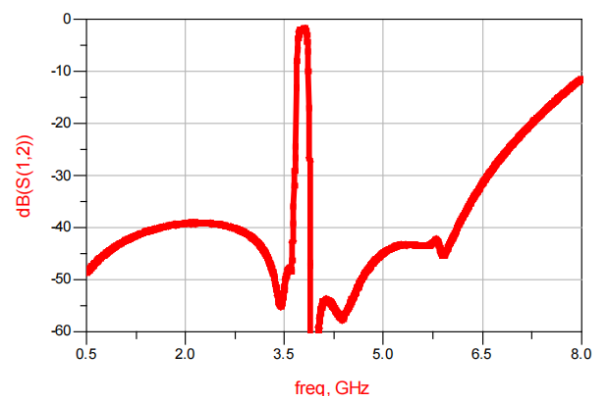
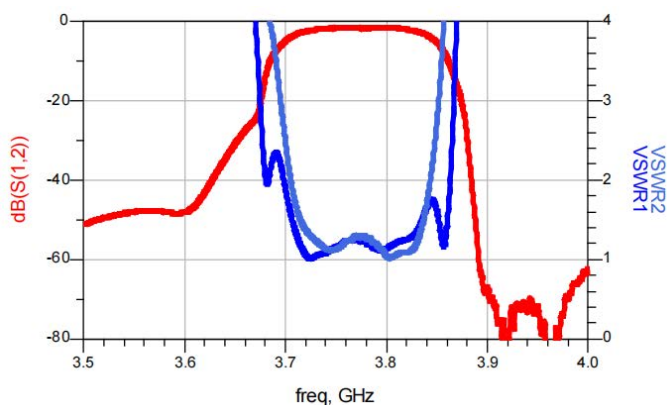
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

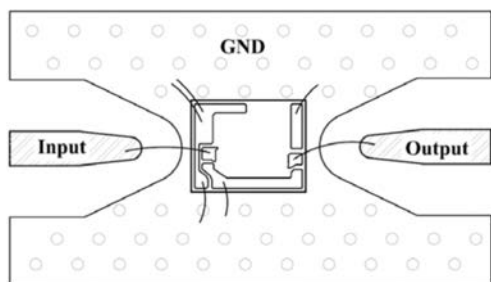
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3800		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	6			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	3.76&3.86	GHz≥	30			dB
带外抑制	8.2	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.6		35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤12ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

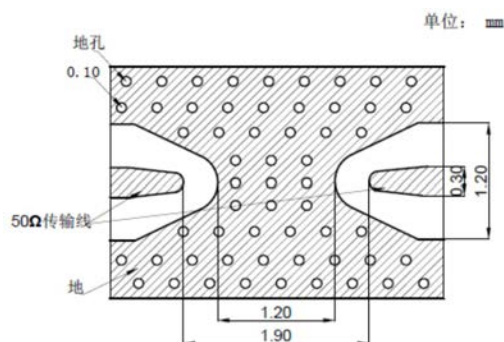
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

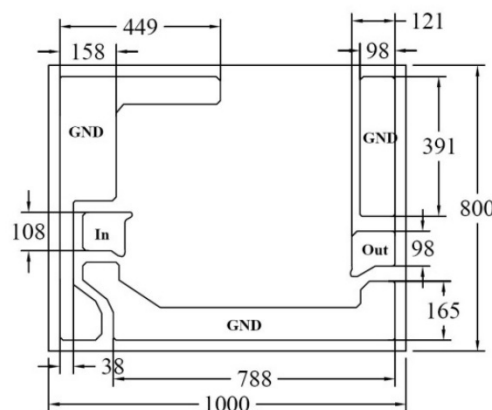
建议PCB布局图



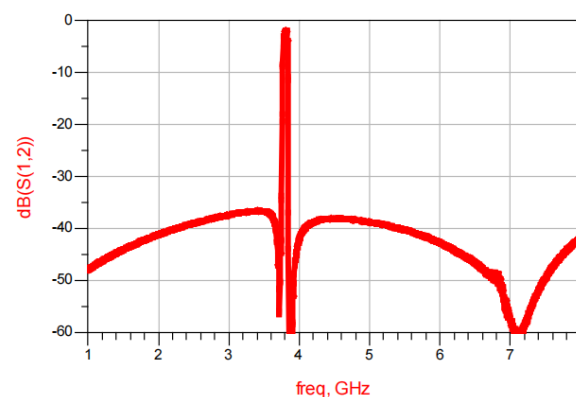
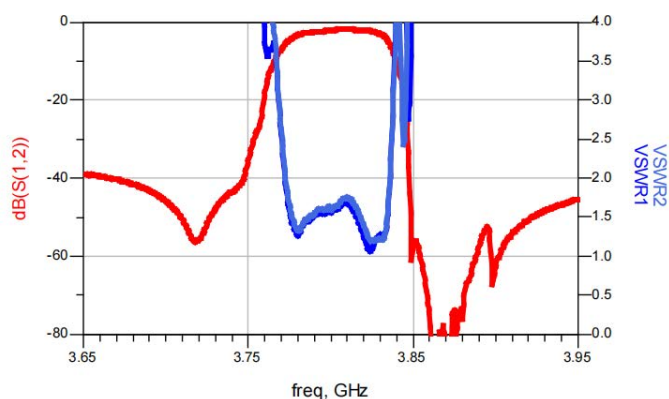
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

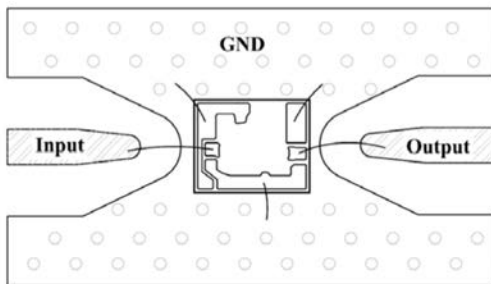
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3900		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/	25			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.5	dB
带外抑制	3.84&3.96	GHz≥	30			dB
带外抑制	7.8	GHz≥	35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤15ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

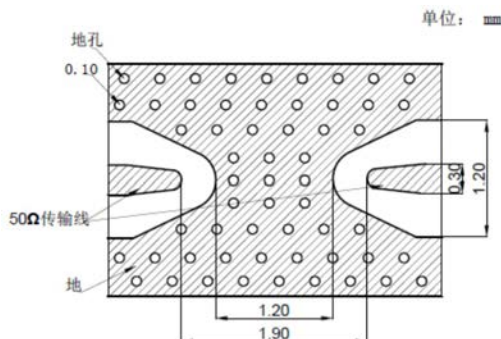
装配示意图



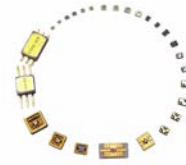
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

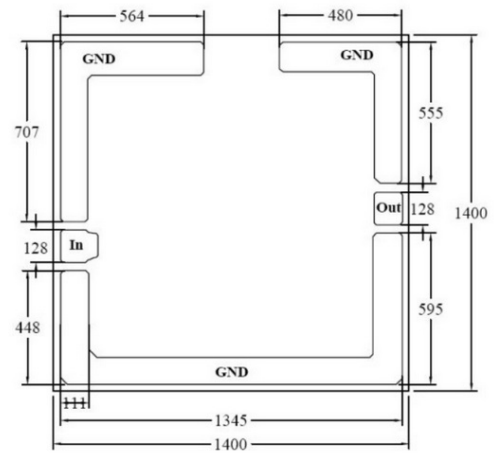
建议PCB布局图



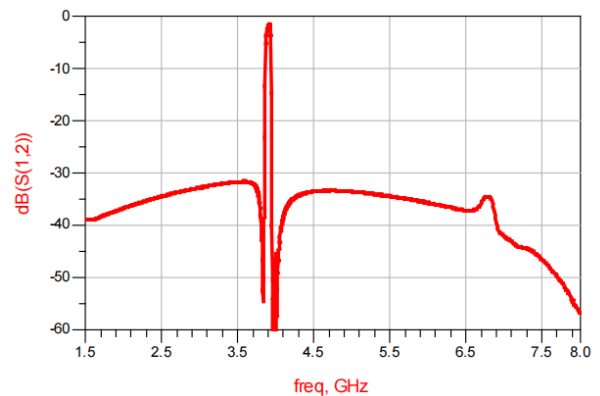
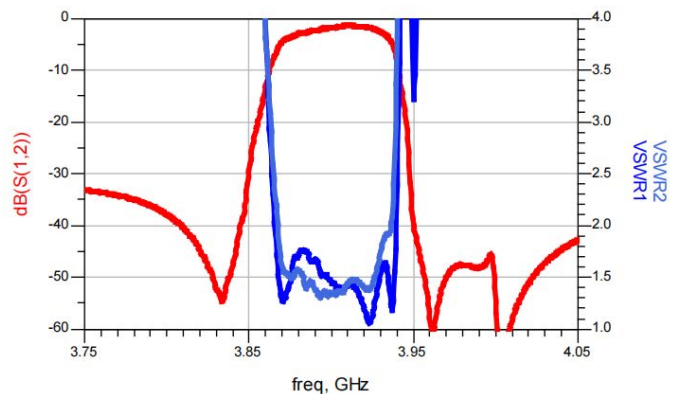
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

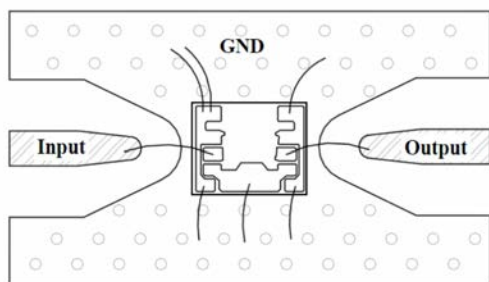
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		3900		MHz
中心损耗	/	/		1.8	2.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	220	280		MHz
带内波动	/	/		0.8	1.0	dB
带外抑制	DC-3.5	GHz≥	30	35		dB
带外抑制	4.3-6	GHz≥	30	35		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤10ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

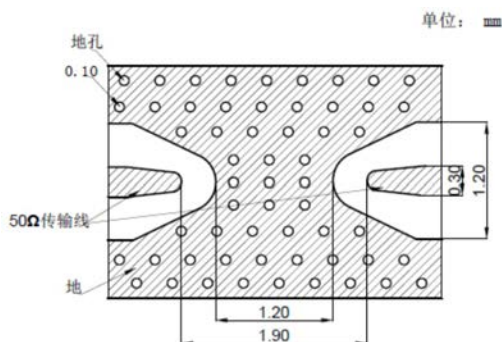
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

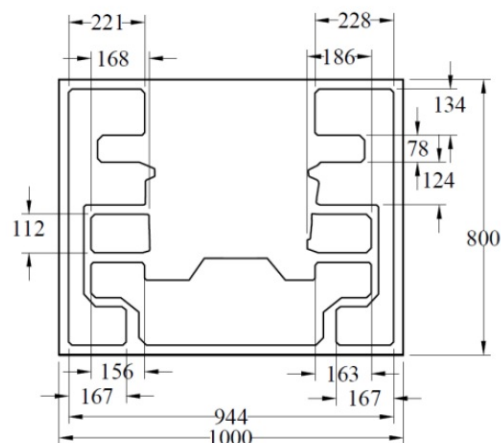
建议PCB布局图



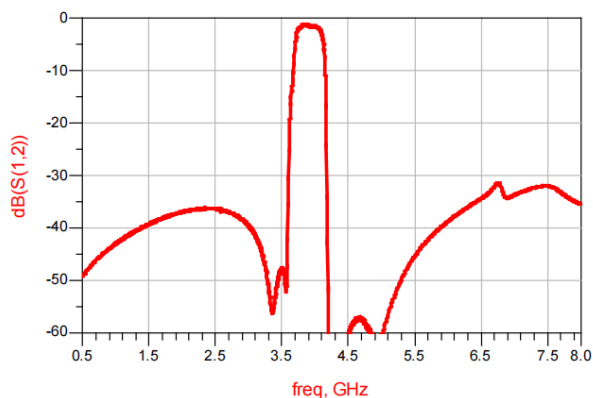
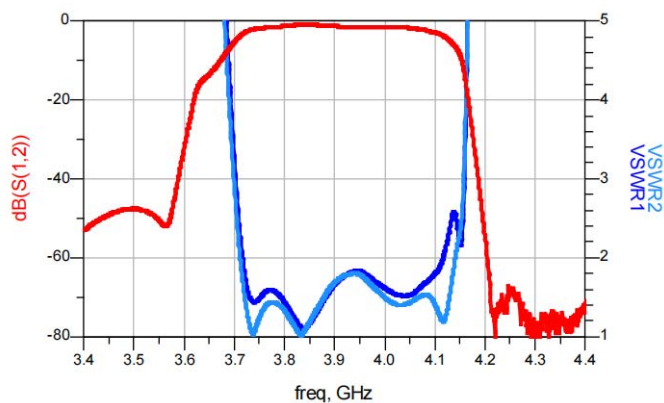
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

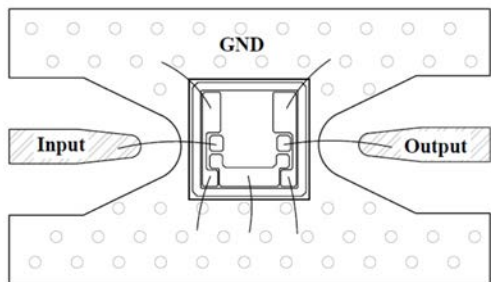
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		4100		MHz
中心损耗	/	/		3.0	3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	6	GHz≥	28	30		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

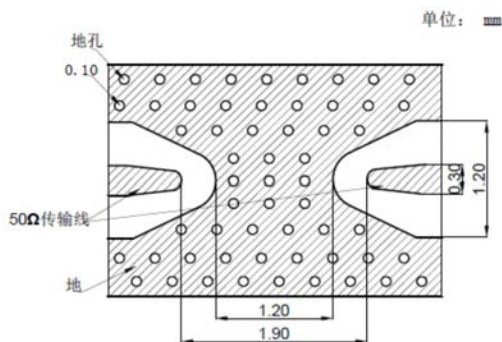
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

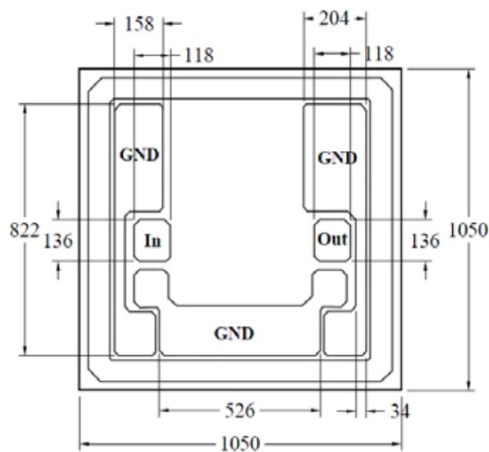
建议PCB布局图



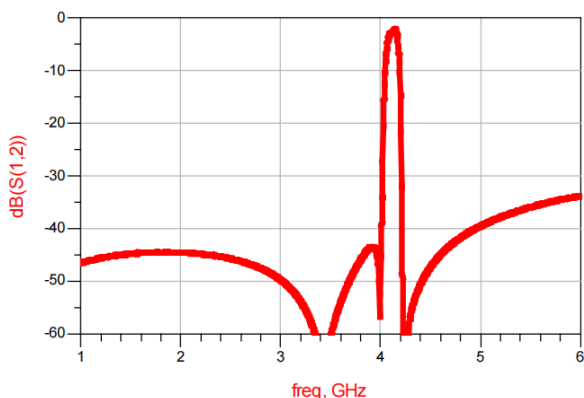
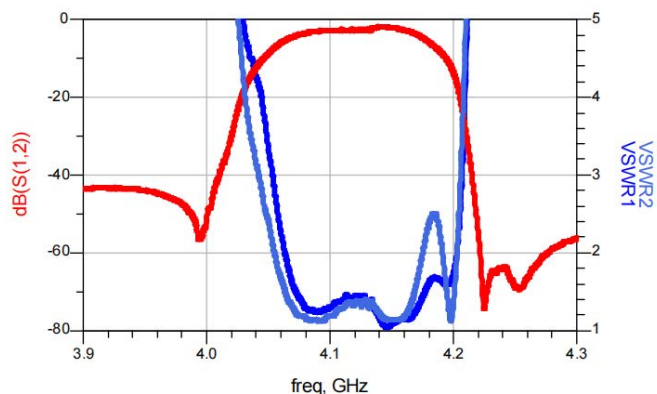
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

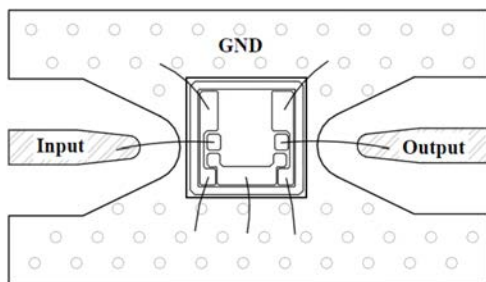
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		4200		MHz
中心损耗	/	/		3.0	3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	2	GHz≥	38	40		dB
带外抑制	6	GHz≥	33	38		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤25ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

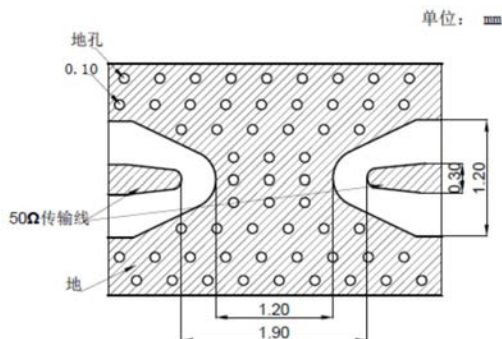
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接(优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

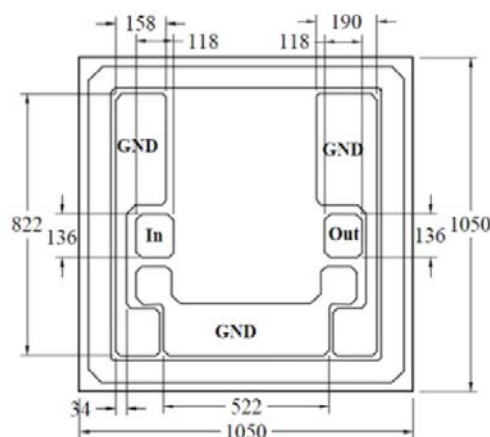
建议PCB布局图



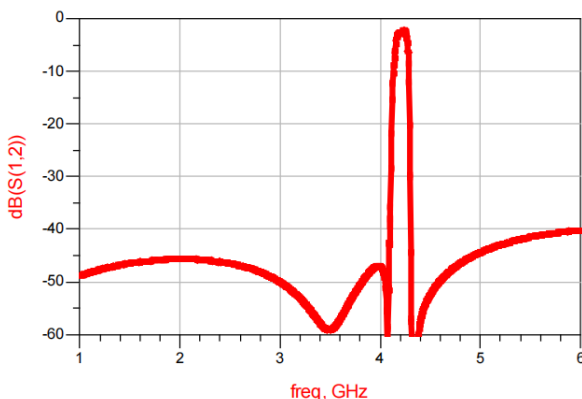
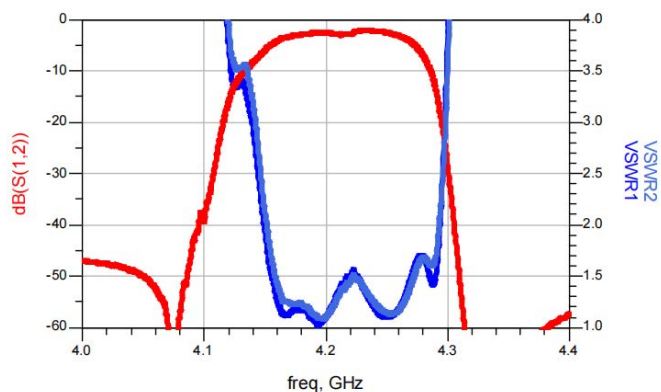
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

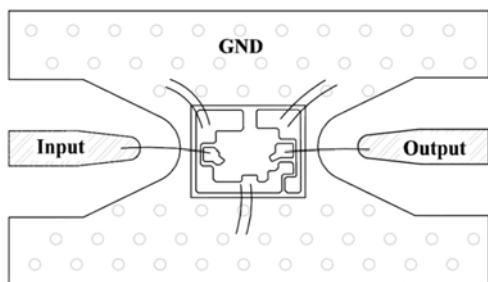
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		4400		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1-4.25	GHz $\geq$	40	42		dB
带外抑制	4.55-6	GHz $\geq$	40	42		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

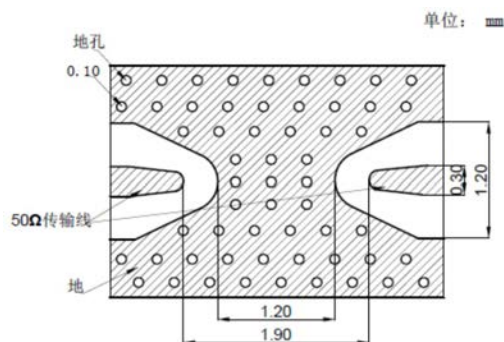
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

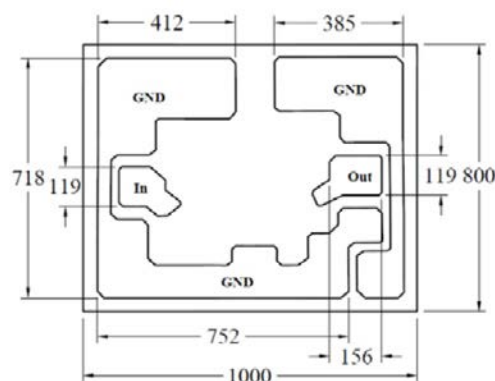
建议PCB布局图



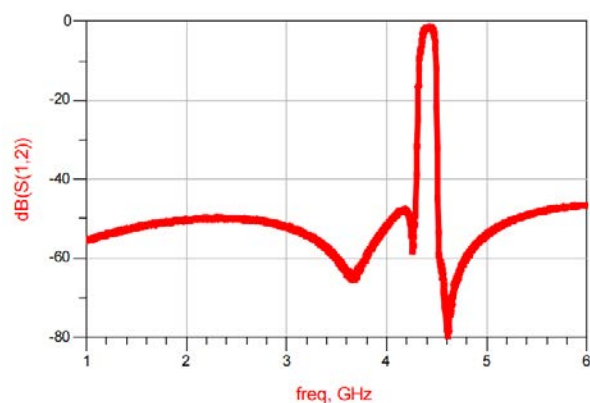
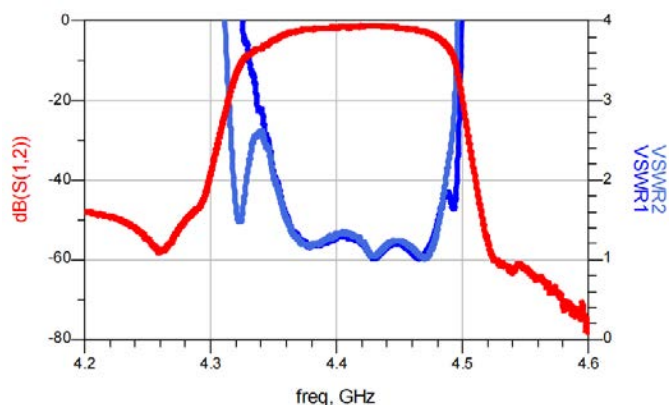
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

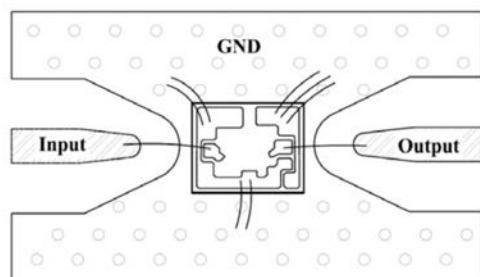
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		4500		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.0	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	1-4.35	GHz $\geq$	38	40		dB
带外抑制	4.65-6	GHz $\geq$	40	42		dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

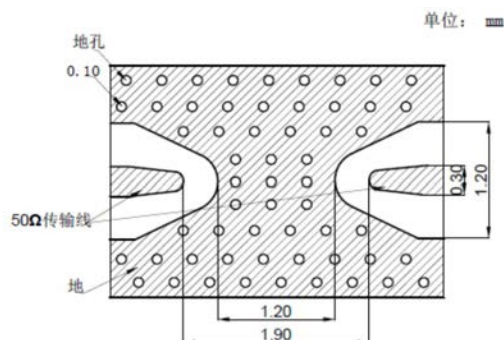
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

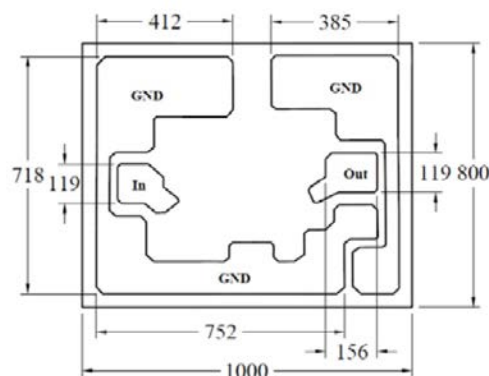
建议PCB布局图



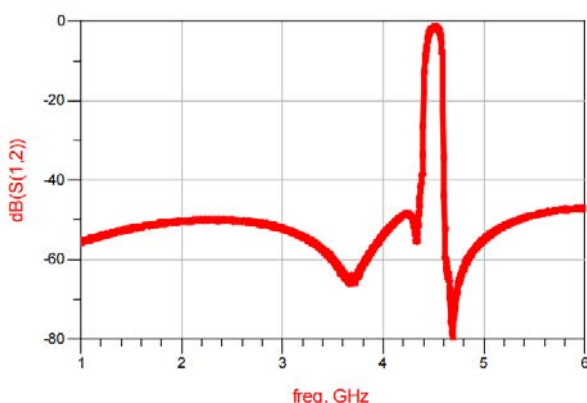
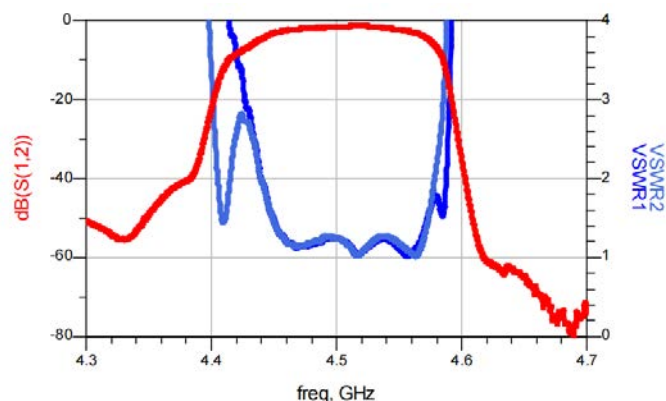
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

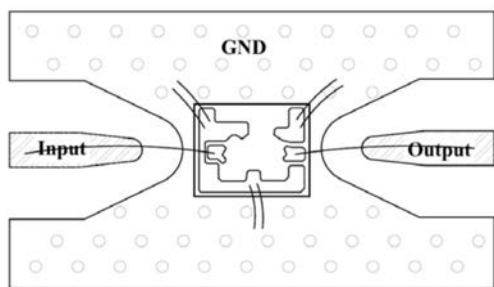
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		5190		MHz
中心损耗	/	/		3.3	3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	140			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.3	dB
带外抑制	DC-4.9	GHz≥	35			dB
带外抑制	5.49	GHz≥	40			dB
带外抑制	5.5-8	GHz≥	35			dB
带外抑制	5.79	GHz≥	40			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤10ns
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

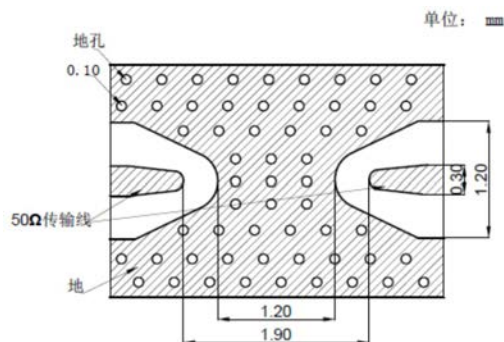
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

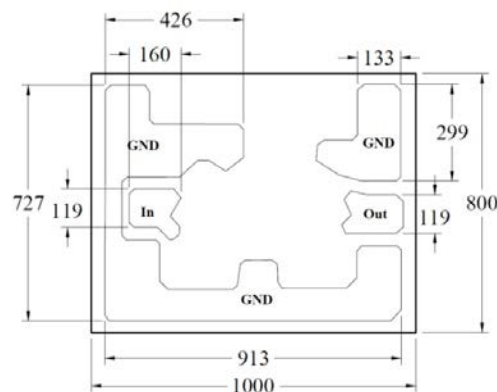
建议PCB布局图



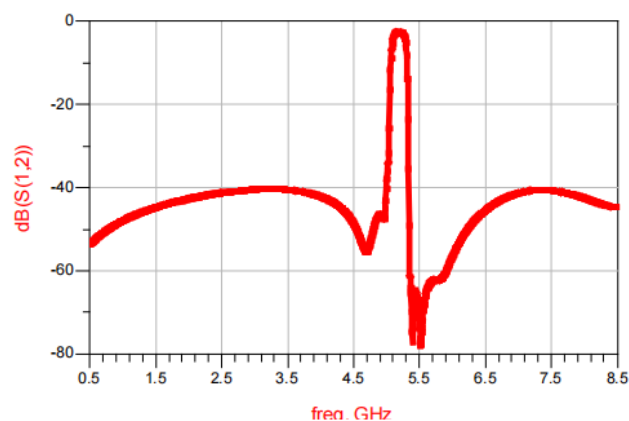
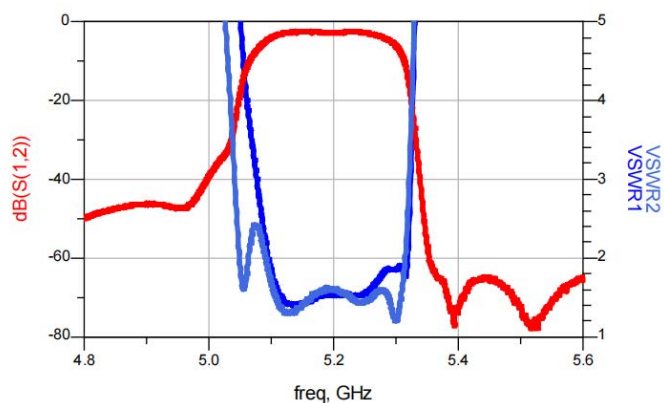
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

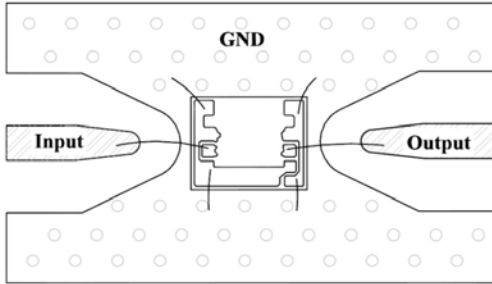
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		5375		MHz
中心损耗	/	/		2.5	3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/		点频		MHz
带外抑制	4975	MHz≥	40			dB
带外抑制	5775	MHz≥	45	55		dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
工作温度	-55~+85°C设计保证
存储温度	-55~+125°C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

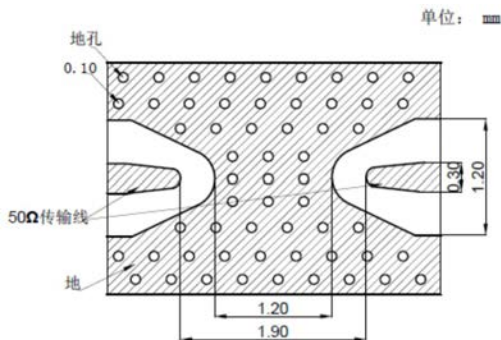
装配示意图



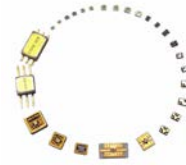
装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

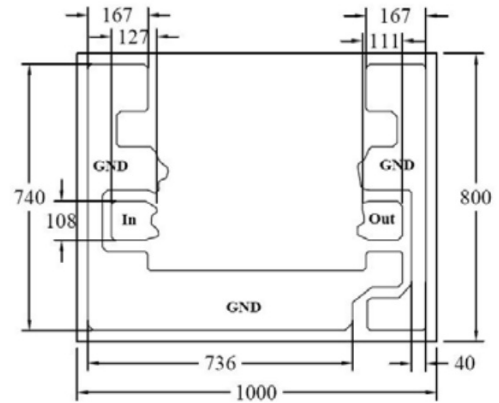
建议PCB布局图



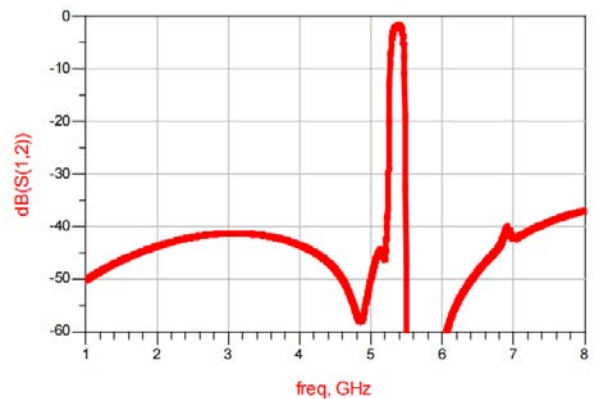
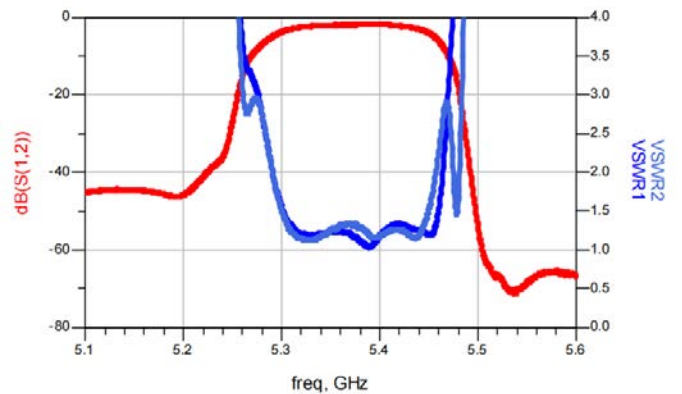
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

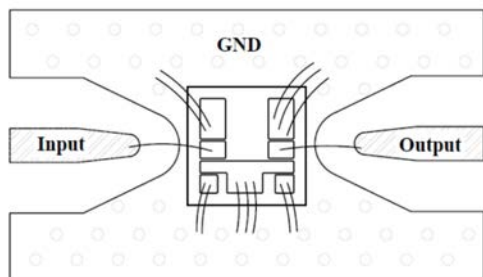
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		5575		MHz
中心损耗	/	/			4.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	350			MHz
带内波动	/	/		1.0	1.5	dB
带外抑制	5-5.15	GHz $\geq$	35			dB
带外抑制	6-6.1	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	6.1-6.5		40			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	≤ 20 ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

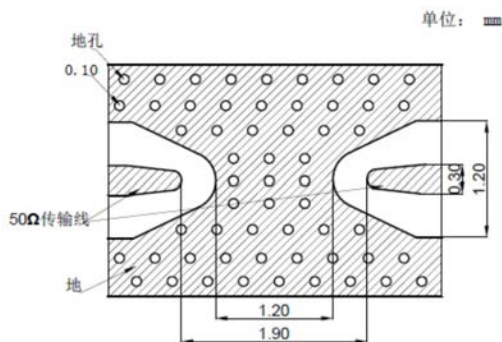
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

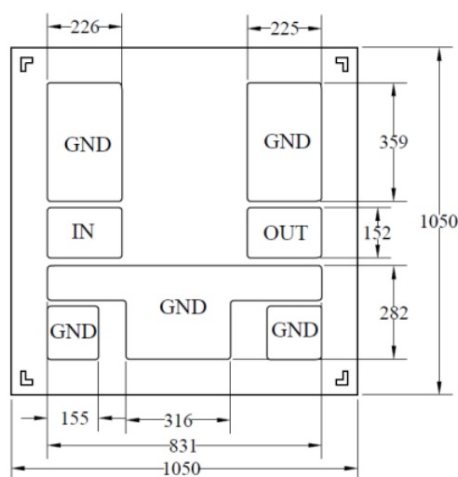
建议PCB布局图



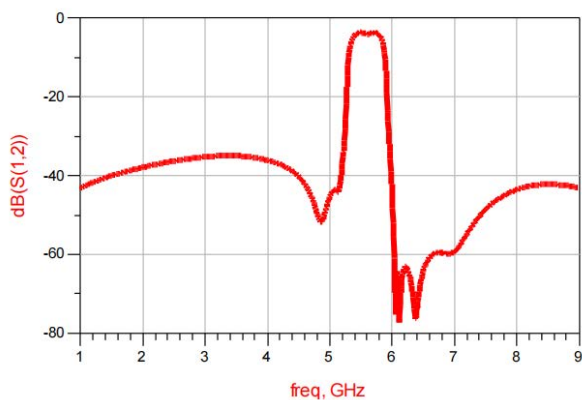
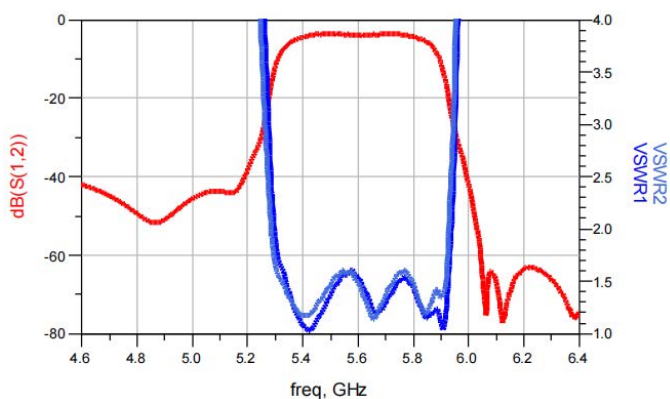
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

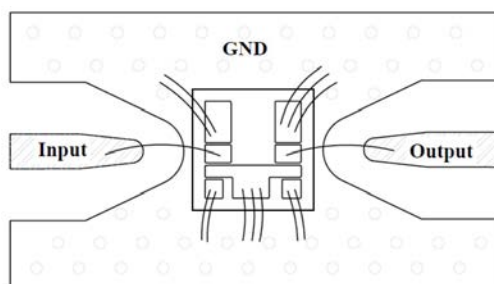
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		5840		MHz
中心损耗	/	/			3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	180			MHz
带内波动	/	/		2.0	3.0	dB
带外抑制	5-5.55	GHz $\geq$	30			dB
带外抑制	6.1-6.5	GHz $\geq$	40			dB
通带驻波	/	/			2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50 Ω
时延波动	$\leq$ 10ns
工作温度	-55~+85 $^{\circ}$ C设计保证
存储温度	-55~+125 $^{\circ}$ C设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

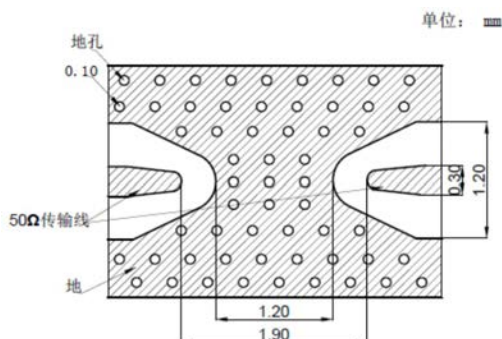
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25 μ m金丝压焊。

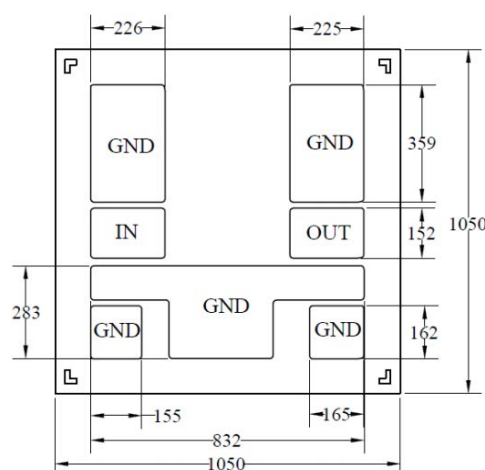
建议PCB布局图



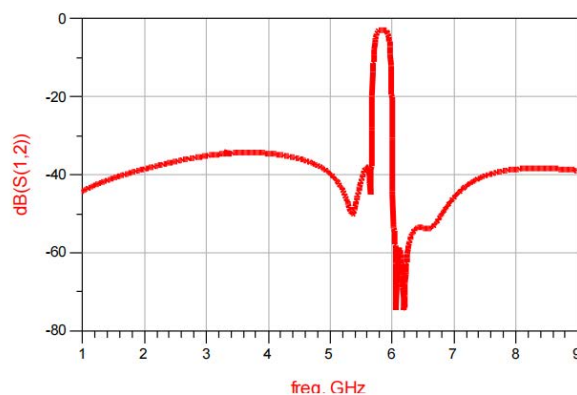
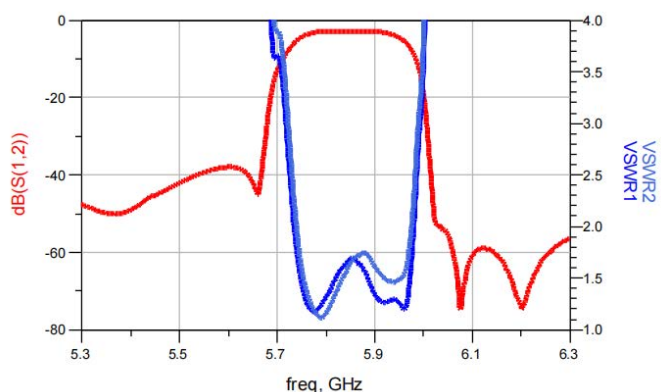
参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图



产品特点

高精度FBAR 加工工艺,

小尺寸, 高性能, 但静电敏感。

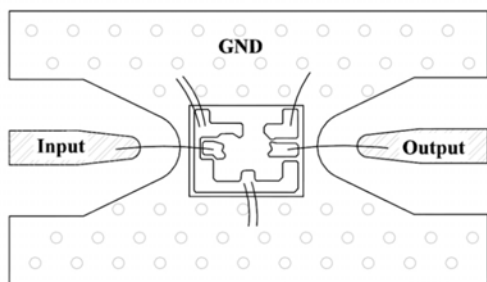
主要参数

参数	频率	/	最小	典型	最大	单位
通带频率	/	/		6490		MHz
中心损耗	/	/		3.0	3.5	dB
-1.0dB 带宽	/	/	140			MHz
带内波动	/	/			1.0	dB
带外抑制	DC-6.2	GHz≥	25			dB
带外抑制	6.79	GHz≥	35			dB
带外抑制	7.09		35			dB
通带驻波	/	/		1.8	2.0	

其它参数

接口形式	微带焊盘
阻抗	50Ω
时延波动	≤8ns
工作温度	-55~+85℃设计保证
存储温度	-55~+125℃设计保证
质量等级	工业级
ROHS	满足
滤波器类别	FBAR

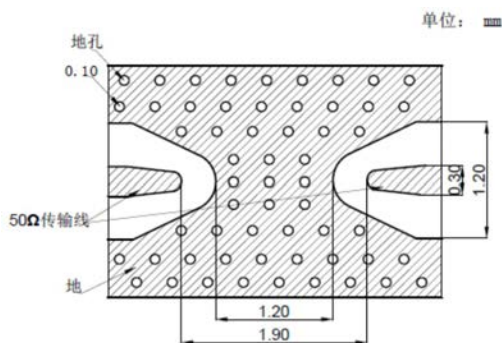
装配示意图



装配及使用说明

- 1、芯片需放置在氮气柜中密封保存, 开封后请在3天内使用, 芯片需在净化环境中装配使用, 芯片端口可互换;
- 2、芯片需使用精密尖头镊子夹取芯片两侧, 避免触碰芯片表面, 芯片底面推荐采用低应力胶粘接 (优选ME8456-DA), 胶量适当, 避免过多污染正面图形;
- 3、芯片粘接完后, 可使用等离子清洗机清洗, 避免超声清洗、液体清洗;
- 4、芯片性能受封装形式、压丝规格、长度、位置影响, 请参照装配示意图并咨询供货商, 推荐使用直径25um金丝压焊。

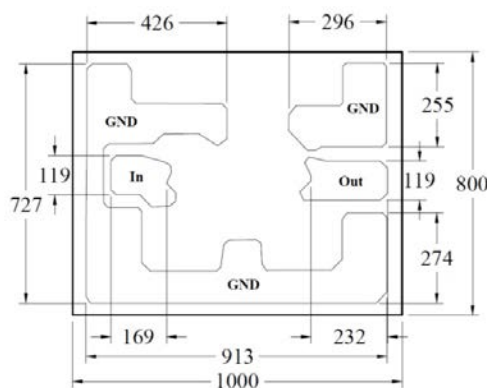
建议PCB布局图



参考实物图



外形结构图 (um)



典型测试曲线图

